# Modulhandbuch Studiengang Master of Science Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik Prüfungsordnung: 961-2011

Wintersemester 2017/18 Stand: 19. Oktober 2017

# Kontaktpersonen:

Studiendekan/in:	UnivProf. Wolfgang Schinköthe Institut für Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik E-Mail: wolfgang.schinkoethe@ikff.uni-stuttgart.de	
Studiengangsmanager/in:	Eberhard Burkard Institut für Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik E-Mail: eberhard.burkard@ikff.uni-stuttgart.de	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 2 von 269

## Inhaltsverzeichnis

Präambel	7
Qualifikationsziele	8
19 Auflagenmodule des Masters	9
11950 Technische Mechanik II + III	10
11960 Technische Mechanik IV	
12180 Numerische Grundlagen	
12210 Einführung in die Elektrotechnik	
13650 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge	17
13740 Konstruktionslehre III / IV - Feinwerktechnik	19
13780 Regelungs- und Steuerungstechnik	21
22830 Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren I	23
38840 Fertigungslehre mit Einführung in die Fabrikorganisation	24
100 Vertiefungsmodule	26
_	
110 Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik	
13540 Grundlagen der Mikrotechnik	28
13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I	
32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik	
120 Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik	
13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik	
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronisc	
Komponenten	
33090 Medizingerätetechnik	
130 Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien	
14060 Grundlagen der Technischen Optik	
14140 Materialbearbeitung mit Lasern	
33420 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung	
33710 Optische Messtechnik und Messverfahren	
140 Gruppe 4: Spezifische Anwendungen	
32220 Grundlagen der Biomedizinischen Technik	
32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme	
33920 Industriepraktikum Maschinenbau	59
200 Spezialisierungsmodule	60
220 Elektronikfertigung	61
221 Kernfächer mit 6 LP	62
14030 Fundamentals of Microelectronics	
32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme	
222 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP	
13540 Grundlagen der Mikrotechnik	
13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I	
13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik	
14030 Fundamentals of Microelectronics	
14230 Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter	
32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme	
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatro	nischer 80
Komponenten	
33710 Optische Messtechnik und Messverfahren	82

33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien	
223 Ergänzungsfächer mit 3 LP	
33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker	
33770 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II	. 88
33290 Praktikum Mikroelektronikfertigung	. 90
230 Feinwerktechnik	. 91
231 Kernfächer mit 6 LP	. 92
13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik	. 93
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer	95
Komponenten	
33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation	
232 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP	
13540 Grundlagen der Mikrotechnik	
13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I	
13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik	
32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme	
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer	108
Komponenten	
33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation	
33710 Optische Messtechnik und Messverfahren	
233 Ergänzungsfächer mit 3 LP	
32880 Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik	
33280 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL	
33300 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik	
33310 Elektronik für Feinwerktechniker	
33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker	
33780 Praktikum Feinwerktechnik	
240 Laser in der Materialbearbeitung	
241 Kernfächer mit 6 LP	
14140 Materialbearbeitung mit Lasern	
29990 Grundlagen der Laserstrahlquellen	
242 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP	
14140 Materialbearbeitung mit Lasern	. 129
29990 Grundlagen der Laserstrahlquellen	
33420 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung	
243 Ergänzungsfächer mit 3 LP	
29980 Einführung in das Optik-Design	
32110 Thermokinetische Beschichtungsverfahren	. 137
32740 Physikalische Prozesse der Lasermaterialbearbeitung	. 139
32760 Diodenlaser	
36120 Scheibenlaser	
46900 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von der Anwendung zur Anlage	
46910 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil II: von der Anlage zum Betrieb	
33800 Praktikum Lasertechnik	
250 Mikrosystemtechnik	
251 Kernfächer mit 6 LP	
13540 Grundlagen der Mikrotechnik	
13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I	. 151
32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik	
32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau	
33690 Mikrofluidik und Mikroaktorik	
33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien	
252 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP	
13540 Grundlagen der Mikrotechnik	. 163
13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I	
13580 Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion	
32220 Grundlagen der Biomedizinischen Technik	
32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017

32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau	175
32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme	177
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer	179
Komponenten	
33690 Mikrofluidik und Mikroaktorik	181
33710 Optische Messtechnik und Messverfahren	183
33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien	185
253 Ergänzungsfächer mit 3 LP	187
32880 Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik	188
33110 Modellierung und Simulation in der Mikrosystemtechnik	190
33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker	191
33530 Mikrofluidik (Übungen)	192
33540 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen)	193
33770 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II	194
33810 Praktikum Mikrosystemtechnik	196
260 Technische Optik	198
261 Kernfächer mit 6 LP	199
14060 Grundlagen der Technischen Optik	200
29950 Optische Informationsverarbeitung	202
33710 Optische Messtechnik und Messverfahren	204
262 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP	206
13540 Grundlagen der Mikrotechnik	207
14060 Grundlagen der Technischen Optik	209
29950 Optische Informationsverarbeitung	211
32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme	213
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer	215
	213
Komponenten	217
33710 Optische Messtechnik und Messverfahren	217
263 Ergänzungsfächer mit 3 LP	
29970 Optik dünner und nanostrukturierter Schichten	220
29980 Einführung in das Optik-Design	221
31870 Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung	223
32760 Diodenlaser	225
33400 Optische Phänomene in Natur und Alltag	226
33460 Praktikum Technische Optik	228
270 Medizingerätekonstruktion	230
271 Kernfächer mit 6 LP	231
13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik	232
14160 Methodische Produktentwicklung	234
14240 Technisches Design	236
33090 Medizingerätetechnik	238
272 Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP	240
13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik	241
14160 Methodische Produktentwicklung	243
14240 Technisches Design	245
14310 Zuverlässigkeitstechnik	247
32320 Interface-Design	249
32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer	251
	201
Komponenten	253
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation	255
273 Ergänzungsfächer mit 3 LP	257
32340 Dynamiksimulation in der Produktentwicklung	258
32380 Value Management	260
33280 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL	262
33300 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik	263
33310 Elektronik für Feinwerktechniker	264
47250 Praktische Übungen Medizingerätetechnik	265

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 5 von 269

400 Schlüsselqualifikationen fachaffin	266
33150 Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren II	267
80210 Masterarbeit Maschinenbau	268
80480 Studienarbeit Maschinenbau	269

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 6 von 269

### Präambel

- 2 Auszug aus der Prüfungsordnung (Besonderer Teil)
- § 1 Die Masterprüfung im Studiengang Maschinenbau / Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik
- (1) Die Masterprüfung besteht aus den in § 2 Abs. 1 dieser Anlage der Prüfungsordnung aufgeführten Modulprüfungen, einem im Allgemeinen Teil dieser Prüfungsordnung geregelten Industriepraktikum und der ebenfalls im Allgemeinen Teil dieser Prüfungsordnung geregelten Studien- und Masterarbeit. Das Lehrangebot erstreckt sich über alle 4 Fachsemester.
- (2) Die Studierenden müssen Pflichtmodule (P, siehe Tabelle §2, Abs. 1) im Umfang von 57 Leistungspunkten und Wahlmodule (W, siehe Tabelle §2, Abs. 1) im Umfang von 63 Leistungspunkten belegen. Die einzelnen Module sind in § 2 Abs. 1 dieser Anlage der Prüfungsordnung geregelt.
- (3) Es sind zwei Spezialisierungsfächer zu wählen. Eine Liste der wählbaren Spezialisierungsfächer wird im Modulhandbuch bekanntgegeben. Innerhalb des Spezialisierungsfaches sind Module im Umfang von je 18 LP zu belegen.
- (4) Im Wahlbereich legt die bzw. der Studierende ihre bzw. seine zu prüfenden Module in einem individuellen Übersichtsplan fest. Der Übersichtsplan besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil des Übersichtsplans besteht aus einer Aufstellung der Module im Bereich der Pflichtmodule mit Wahlmöglichkeit. Der zweite Teil des Übersichtsplans legt die gewählten Spezialisierungsfächer und die darin zu prüfenden Module fest. Der Prüfungsausschuss erlässt darüber hinaus Regeln über die Gestaltung und Genehmigung des Übersichtsplans.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 7 von 269

### Qualifikationsziele

Das Qualifikationsprofil von Absolventen, die den Masterabschluss Maschinenbau / Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik erworben haben, zeichnet sich durch die folgenden zusätzlichen, über die mit dem Bachelor-Abschluss verbundenen hinausgehenden Attribute aus.

- Die Absolventen haben die Ausbildungsziele des Bachelor-Studiums in einem längeren fachlichen Reifeprozess weiter verarbeitet und haben eine größere Sicherheit in der Anwendung und Umsetzung der fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen erworben.
- Die Absolventen haben tiefgehende Fachkenntnisse in zwei ausgewählten Technologiefeldern oder ingenieurwissenschaftlichen Querschnittsthemen erworben.
- Die Absolventen sind fähig, die erworbenen naturwissenschaftlichen, mathematischen und ingenieurwissenschaftlichen Methoden zur Abstraktion, Formulierung und Lösung komplexer Aufgabenstellungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen erfolgreich einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf auch weiterzuentwickeln.
- Die Absolventen können Konzepte und Lösungen zu grundlagenorientierten, zum Teil auch unüblichen Fragestellungen unter breiter Einbeziehung anderer Disziplinen erarbeiten. Sie setzten ihre Kreativität und ihr ingenieurwissenschaftliches Urteilsvermögen ein, um neue und originelle Produkte und Prozesse zu entwickeln.
- Die Absolventen sind insbesondere fähig, benötigte Informationen zu identifizieren, zu finden und zu beschaffen. Sie können analytische, modellhafte und experimentelle Untersuchungen planen und durchführen. Dabei bewerten sie Daten kritisch und ziehen daraus die notwendigen Schlussfolgerungen.
- Die Absolventen verfügen über Tiefe und Breite, um sich sowohl in zukünftige Technologien im eigenen Fachgebiet wie auch in Randgebiete einzuarbeiten und neue aufkommende Technologien zu untersuchen und zu bewerten.
- Die Absolventen haben verschiedene technische und soziale Kompetenzen (Abstraktionsvermögen, systemanalytisches Denken, Team- und Kommunikationsfähigkeit, internationale und interkulturelle Erfahrung usw.) erworben, die gut auf Führungsaufgaben vorbereiten.

Masterabsolventen/innen erwerben die wissenschaftliche Qualifikation für eine Promotion.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 8 von 269

### 19 Auflagenmodule des Masters

Zugeordnete Module: 11950 Technische Mechanik II + III

11960 Technische Mechanik IV12180 Numerische Grundlagen

12210 Einführung in die Elektrotechnik

13650 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge13740 Konstruktionslehre III / IV - Feinwerktechnik

13780 Regelungs- und Steuerungstechnik

22830 Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren I38840 Fertigungslehre mit Einführung in die Fabrikorganisation

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 9 von 269

### Modul: 11950 Technische Mechanik II + III

2. Modulkürzel:	072810002	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. DrIng. Peter Eberha	UnivProf. DrIng. Peter Eberhard	
9. Dozenten:		Peter Eberhard Michael Hanss		
10. Zuordnung zum Cu Studiengang:	rriculum in diesem	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,  → Auflagen		
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	Grundlagen in Technischer Mechanik I		
12. Lernziele:		Die Studierenden haben nach erfolgreichem Besuch des Moduls Technische Mechanik II+III ein grundlegendes Verständnis und Kenntnis der wichtigsten Zusammenhänge in der Elasto-Statik und Dynamik. Sie beherrschen selbständig, sicher, kritisch und kreativ einfache Anwendungen der grundlegendsten mechanischen Methoden der Elasto-Statik und Dynamik.		
13. Inhalt:		<ul> <li>Elasto-Statik: Spannungen und Torsion von Wellen, Technisch einfacher Belastungsfälle</li> </ul>		
		<ul> <li>Kinematik: Punktbewegungen, räumliche Kinematik des starre</li> </ul>		
		<ul> <li>Kinetik: Kinetische Grundbegrif Kinetik der Schwerpunktsbewe Relativbewegungen, Kinetik de Energiesatz, Schwingungen</li> </ul>		
		<ul> <li>Methoden der analytischen Mechanik: Prinzip von d'Alembert, Koordinaten und Zwangsbedingungen, Anwendung des d'Alembertschen Prinzips in der Lagrangeschen Fassung, Lagrangesche Gleichungen</li> </ul>		
14. Literatur:		Vorlesungsmitschrieb		
		Vorlesungs- und Übungsunterle	agen	
		<ul> <li>Gross, D., Hauger, W., Schröd</li> <li>2 - Elastostatik, Berlin: Springe</li> </ul>		
		<ul> <li>Gross, D., Hauger, W., Schröder, J., Wall, W.: Technische Mechanik 3 - Kinetik. Berlin: Springer, 2006</li> </ul>		
		Hibbeler, R.C.: Technische Mechanik 3 - Dynamik. München: Pearson Studium, 2006		
		<ul> <li>Magnus, K., Slany, H.H.: Grundlagen der Techn. Mechanik. Stuttgart: Teubner, 2005</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>119504 Übung Technische Mechanik III</li> <li>119503 Vorlesung Technische Mechanik III</li> <li>119501 Vorlesung Technische Mechanik II</li> </ul>		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 10 von 269

	<ul> <li>119502 Übung Technische Mechanik II</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 84 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 276 h Gesamt: 360 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	11951 Technische Mechanik II + III (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	<ul><li>Beamer</li><li>Tablet-PC/Overhead-Projektor</li><li>Experimente</li></ul>	
20. Angeboten von:	Technische Mechanik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 11 von 269

### Modul: 11960 Technische Mechanik IV

2. Modulkürzel:	072810003	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Peter Ebe	rhard	
9. Dozenten:		Peter Eberhard Michael Hanss		
10. Zuordnung zum Cu Studiengang:	urriculum in diesem	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische</li> <li>Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Auflagen</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Grundlagen in Technischer Mechanikl-III		
12. Lernziele:		Nach erfolgreichem Besuch des Moduls Technische Mechanik IV besitzen die Studierenden ein grundlegendes Verständnis und Kenntnis der wichtigsten Zusammenhänge in der Stoßmechanik, der kontinuierlichen Schwingungslehre, den Energiemethoden der Elasto-Statik und der finiten Elemente Methode. Sie beherrschen somit selbständig, sicher, kritisch und kreativ einfache Anwendungen weiterführender grundlegender mechanischer Methoden der Statik und Dynamik.		
13. Inhalt:		Stoß, rauer Stoß, Lagerstoß  Kontinuierliche Schwingung Transversalschwingungen eir eines Stabes, Torsionsschwir Biegeschwingungen eines Ba eindimensionalen Wellengleic Balkenbiegung, freie Schwing Energiemethoden der Elast Formänderungsenergie eines Prinzip der virtuellen Arbeit/K Menabrea, Maxwellscher Ver der potenziellen Energie Methode der finiten Elemen	ner Saite, Longitudinal-schwingungen ngungen eines Rundstabes, alkens, Eigenlösungen der chung, Eigenlösungen bei gungen kontinuierlicher Systeme o-Statik:  Stabes bzw. Balkens, Arbeitssatz, räfte, Satz von Castigliano, Satz von tauschungssatz, Satz vom Minimum te:  m, Matrixverschiebungsgrößen-	
14. Literatur:		<ul> <li>Vorlesungsmitschrieb</li> <li>Vorlesungs- und Übungsunterlagen</li> <li>Gross, D., Hauger, W., Wriggers, P.: Technische Mechanik 4 - Hydromechanik, Elemente der Höheren Mechanik, Numerische Methoden. Berlin: Springer, 2007</li> <li>Hibbeler, R.C.: Technische Mechanik 1-3. München: Pearson Studium, 2005</li> <li>Magnus, K., Slany, H.H.: Grundlagen der Technischen Mechanik. Stuttgart: Teubner, 2005</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:		<ul><li>119601 Vorlesung Technische Mechanik IV</li><li>119602 Übung Technische Mechanik IV</li></ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 12 von 269

	Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	11961 Technische Mechanik IV (USL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamer,	
	Tablet-PC/Overhead-Projektor,	
	Experimente	
20. Angeboten von:	Technische Mechanik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 13 von 269

## Modul: 12180 Numerische Grundlagen

2. Modulkürzel:	080310505	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	3	7. Sprache:	Deutsch
3. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. Dr. Christian Rohd	le
9. Dozenten:		Bernard Haasdonk Christian Rohde Kunibert Gregor Siebert Dominik Göddeke	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische</li> <li>Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Auflagen</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	Höhere Mathematik 1-3	
12. Lernziele:		Die Studierenden	
		<ul> <li>haben Kenntnisse über die numerischen Mathematik er</li> </ul>	
		<ul> <li>sind in der Lage, die erlernte anzuwenden (z.B. durch red Problemstellungen).</li> </ul>	en Grundlagen selbständig chnergestützte Lösung numerischer
		<ul> <li>besitzen die notwendigen G quantitativer ingenieurwisse</li> </ul>	
13. Inhalt:		und iterativen Methoden, num Gleichungssysteme, Quadratu gewöhnlicher Anfangswertpro	urverfahren, approximative Lösung bleme. d Interpolation, Finite-Differenzen
14. Literatur:		<ul> <li>M. Bollhöfer, V. Mehrmann: 2004.</li> <li>W. Dahmen, A. Reusken: N Naturwissenschaftler, Sprin</li> <li>MATLAB/Simulink-Skript, R</li> </ul>	ger (2006).
		Mathematik Online: • www.mathematik-online.org	J
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul><li>121801 Vorlesung Numerische Grundlagen</li><li>121802 Vortragsübung Numerische Grundlagen</li></ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 31,5 h Selbststudiumszeit / Nacharbe Gesamt: 90 h	eitszeit: 58,5 h
17. Prüfungsnummer/n und -name:		12181 Numerische Grundlag Min., Gewichtung: 1 • Während der Vorlesungszei	gen (USL), Schriftlich oder Mündlich, sit finden Online - Tests statt.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 14 von 269

- In der vorlesungsfreien Zeit findet eine 90 Min. schriftliche Prüfung statt.
- Das Modul wurde bestanden, wenn im Mittel aus 10% Testergebnis und 90% Prüfungsergebnis eine 4.0 oder besser erreicht wurde.

18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamer, Tafel, persönliche Interaktion, ILIAS, ViPLab	
20. Angeboten von:	Angewandte Mathematik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 15 von 269

## Modul: 12210 Einführung in die Elektrotechnik

2. Modulkürzel:	052601001	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	7	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Nejila Pars	spour	
9. Dozenten:		Nejila Parspour		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Auflagen</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:			
12. Lernziele:		Studierende haben Grundkenntnisse der Elektrotechnik. Sie können einfache Anordnungen mathematisch beschreiben und einfache Aufgabenstellungen lösen.		
13. Inhalt:		<ul> <li>Elektrischer Gleichstrom</li> <li>Elektrische und magnetische Felder</li> <li>Wechselstrom</li> <li>Halbleiterelektronik (Diode, Bipolartransistor, Operationsverstärker)</li> <li>Elektrische Maschinen (Gleichstrommaschine, Synchrongenerator, Asynchronmotor)</li> </ul>		
14. Literatur:		<ul> <li>Hermann Linse, Rolf Fischer, Elektrotechnik für Maschinenbauer, Teubner Stuttgart, 12. Auflage 2005</li> <li>Moeller / Fricke / Frohne / Löcherer / Müller, Grundlagen der Elektrotechnik, Teubner Stuttgart, 19. Auflage 2002</li> <li>Jötten / Zürneck, Einführung in die Elektrotechnik I/II, uni-text Braunschweig 1972</li> <li>Ameling, Grundlagen der Elektrotechnik I/II, Bertelsmann Universitätsverlag 1974</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>122101 Vorlesung Einführung in die Elektrotechnik I</li> <li>122105 Elektrotechnisches Praktikum</li> <li>122102 Übungen Einführung in die Elektrotechnik I</li> <li>122103 Vorlesung Einführung in die Elektrotechnik II</li> <li>122104 Übungen Einführung in die Elektrotechnik II</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 98h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 82 h Gesamt: 180 h		
17. Prüfungsnummer/n und -name:		<ul> <li>12211 Einführung in die Elektrotechnik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>12212 Elektrotechnisches Praktikum (USL), , Gewichtung: 1</li> <li>V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich</li> </ul>		
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Beamer, Tafel, ILIAS		
20. Angeboten von:		Elektrische Energiewandlung		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 16 von 269

## Modul: 13650 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge

2. Modulkürzel:	080410503	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortliche	er:	apl. Prof. Dr. Markus Stroppel		
9. Dozenten:				
10. Zuordnung zum Cur Studiengang:	riculum in diesem	M.Sc. Maschinenbau Mikroted Optik, PO 961-2011, → Auflagen	chnik, Gerätetechnik und Technische	
11. Empfohlene Voraus	setzungen:	HM 1 / 2		
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Studierenden</li> <li>verfügen über grundlegende Kenntnisse der Integralrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Fourierreihen.</li> <li>sind in der Lage, die behandelten Methoden selbständig, sicher, kritisch und kreativ anzuwenden.</li> <li>besitzen die mathematische Grundlage für das Verständnis quantitativer Modelle aus den Ingenieurwissenschaften.</li> <li>können sich mit Spezialisten aus dem ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Umfeld über die benutzten mathematischen Methoden verständigen.</li> </ul>		
13. Inhalt:		Integralrechnung für Funktionen von mehreren Veränderlichen: Gebietsintegrale, iterierte Integrale, Transformationssätze, Guldinsche Regeln, Integralsätze von Stokes und Gauß Lineare Differentialgleichungen beliebiger Ordnung und Systeme linearer Differentialgleichungen 1. Ordnung (jeweils mit konstanten Koeffizienten): Fundamentalsystem, spezielle und allgemeine Lösung. Gewöhnliche Differentialgleichungen: Existenz- und Eindeutigkeitssätze, einige integrierbare Typen, lineare Differentialgleichungen beliebiger Ordnung (mit konstanter Koeffizienten), Anwendungen. Aspekte der Fourierreihen und der partiellen Differentialgleichungen: Darstellung von Funktionen durch Fourierreihen, Klassifikation partieller Differentialgleichungen, Beispiele, Lösungsansätze (Separation).		
14. Literatur:		<ul><li>Pearson Studium.</li><li>K. Meyberg, P. Vachenauer</li><li>G. Bärwolff: Höhere Mather</li></ul>	r:Höhere Mathematik für Ingenieure 1, 2. r:Höhere Mathematik 1, 2. Springer. matik. Elsevier. r Veränderlichen, Edition Delkhofen.	
		•	onale Analysis, Edition Delkhofen.	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 17 von 269

	<ul> <li>136503 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (FMT)</li> <li>136501 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (Bau)</li> <li>136504 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (Mach)</li> <li>136505 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (Med)</li> <li>136507 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (UWT)</li> <li>136508 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (Verf)</li> <li>136509 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (Verk)</li> <li>136506 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (Tema)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 84 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 96 h <b>Gesamt: 180 h</b>
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13651 Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich unbenotete Prüfungsvorleistung: schriftliche Hausaufgaben/ Scheinklausuren,</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Beamer, Tafel, persönliche Interaktion
20. Angeboten von:	Institute der Mathematik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 18 von 269

### Modul: 13740 Konstruktionslehre III / IV - Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510001	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	9	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,  → Auflagen		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	<ul> <li>Konstruktionslehre I/II</li> </ul>		
12. Lernziele:		<ul> <li>Kenntnis der Verwendung und Berechnung grundlegender Maschinenelemente,</li> <li>Auswählen und Kombinieren von Maschinenelementen zu komplexen Baugruppen und Geräten,</li> <li>Entwerfen und Konstruieren von Baugruppen und Geräten</li> </ul>		
13. Inhalt:		Mechanische Funktionsgruppen: Wellen, Lager und Führungen (Gleitlager, Wälzlager, Luftlager, Gleitführungen, Wälzführungen, Federführungen, Strömungsführungen), Zahnradgetriebe (Verzahnungsgeometrie, Kenngrößen, Berechnung, Eingriff und Überdeckung, Betriebsverhalten, Profilverschiebung, Getriebetoleranzen, Kutzbachplan), Koppelgetriebe (Freiheitsgrade, Viergelenkkette, kinematische Analyse, Getriebesynthese), Zugmittelgetriebe (Zahnriemengetriebe), Rotations-Translations-Umformer (Zahnstangengetriebe, Riemenund Bandgetriebe, Gleitschraubgetriebe, Wälzschraubbetriebene, Sonderformen), Kupplungen (feste, ausgleichende, schaltbare, selbstschaltende)  Elektromechanische Funktionsgruppen und Aktoren: Elektromagnete, Schrittmotoren, kontinuierliche Rotationsmotoren und Linearmotoren, piezoelektrische Aktoren, magnetostriktive Aktoren, Stelltechnik auf Basis thermischer Effekte  Optische Funktionsgruppen: Blenden, Luken, Pupillen und nötige Querschnitte in optischen Geräten, Konstruktion optischer Funktionsgruppen  Methodik der Geräteentwicklung: Produktplanung, Aufbereiten, Konzipieren, Entwerfen, Ausarbeiten,  CAD-Ausbildung: Einführungskurs 2D-CAD (obligatorisch), Einführungskurs 3D-CAD (fakultativ)		
14. Literatur:		<ul> <li>zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W., Konstruktionzur Vorlesung</li> <li>Nagel, Th.: Konstruktionsel Großerkmannsdorf: Initial V</li> <li>Krause, W., Grundlagen de</li> </ul>	erlag	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	<ul><li>137401 Vorlesung Konstruk</li><li>137402 Übung Konstruktion</li></ul>	tionslehre III - Feinwerktechnik slehre III - Feinwerktechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 19 von 269

	<ul> <li>137403 Vorlesung Konstruktionslehre IV - Feinwerktechnik</li> <li>137404 Übung Konstruktionslehre IV - Feinwerktechnik</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 95 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 265 h Gesamt: 360 h
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13741 Konstruktionslehre III / IV - Feinwerktechnik: Schriftliche Hausaufgabe (USL), Schriftlich, Gewichtung: 1</li> <li>13742 Konstruktionslehre III / IV - Feinwerktechnik (PL), Schriftlich, 180 Min., Gewichtung: 1</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, OHP, Beamer
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 20 von 269

### Modul: 13780 Regelungs- und Steuerungstechnik

2. Modulkürzel:	074810070	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Frank Allg	öwer	
9. Dozenten:		Frank Allgöwer Christian Ebenbauer Oliver Sawodny Armin Lechler Matthias Müller		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,  → Auflagen		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		HM I-III		
12. Lernziele:		Die Studierenden		
		<ul> <li>können lineare dynamische Systeme analysieren,</li> <li>können lineare dynamische Systeme auf deren Struktureigenschaften untersuchen und Aussagen über mögliche Regelungs- und Steuerungskonzepte treffen,</li> <li>können einfache Regelungs- und Steuerungsaufgaben für lineare Systeme lösen.</li> </ul>		
13. Inhalt:		Vorlesung "Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik" : Fourier-Reihe, Fourier-Transformation, Laplace-Transformation,		

Testsignale, Blockdiagramme, Zustandsraumdarstellung

#### Vorlesung "Einf ührung in die Regelungstechnik":

Systemtheoretische Konzepte der Regelungstechnik, Stabilität (Nyquist-, Hurwitz- und Small-Gain-Kriterium,...), Beobachtbarkeit, Steuerbarkeit, Robustheit, Reglerentwurfsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich (PID, Polvorgabe, Vorfilter,...), Beobachterentwurf

#### Vorlesung "Steuerungstechnik mit Antriebstechnik":

Steuerungsarten (mechanisch, fluidisch, Kontaktsteuerung, SPS, Motion Control, Numerische Steuerung, Robotersteuerung, Leitsteuerung): Aufbau, Architektur, Funktionsweise, Programmierung. Darstellung und Lösung steuerungstechnischer Problemstellungen. Grundlagen der in der Automatisierungstechnik verwendeten Antriebssysteme

Bemerkung 1: Es ist einer der beiden folgenden Blöcke zu wählen:

Block 1: Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik und Einführung in die Regelungstechnik

Block 2: Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik und Steuerungstechnik mit Antriebstechnik

### Bemerkung 2 (Prüfungsanmeldung):

• Studierende der *Erneuerbaren Energien* müssen die Prüfung Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik bei Univ.-Prof. Oliver Sawodny ablegen.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 21 von 269

	<ul> <li>Studierende anderer Studiengänge müssen die Prüfung Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik bei UnivProf. Christian Ebenbauer ablegen.</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Vorlesung "Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik"</li> <li>Föllinger, O.: Laplace-, Fourier- und z-Transformation. 7. Aufl., Hüthig Verlag 1999</li> <li>Preuss, W.: Funktionaltranformationen - Fourier-, Laplace- und Z-Transformation. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2002</li> <li>Unbehauen, R.: Systemtheorie 1. Oldenbourg 2002</li> <li>Lunze, J.: Regelungstechnik 1, Springer Verlag 2006</li> </ul>
	<ul> <li>Vorlesung "Einführung in die Regelungstechnik"</li> <li>Lunze, J., Regelungstechnik 1. Springer Verlag, 2004</li> <li>Horn, M. und Dourdoumas, N. Regelungstechnik., Pearson Studium, 2004.</li> </ul>
	<ul> <li>Vorlesung "Steuerungstechnik mit Antriebstechnik"</li> <li>Pritschow, G.: Einführung in die Steuerungstechnik, Carl Hanser Verlag, München, 2006</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>137803 Vorlesung Einführung in die Regelungstechnik</li> <li>137804 Vorlesung Steuerungstechnik mit Antriebstechnik</li> <li>137801 Vorlesung Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik</li> <li>137802 Vorlesung Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik (Erneuerbare Energien, Verfahrenstechnik)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138h Gesamt: 180h
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13781 Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1</li> <li>13782 Einführung in die Regelungstechnik (PL), Schriftlich, 90 Min. Gewichtung: 1</li> <li>13783 Steuerungstechnik mit Antriebstechnik (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1</li> <li>Ermittlung der Modulnote:</li> <li>Block 1:</li> <li>Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik 50%</li> <li>Einführung in die Regelungstechnik 50%</li> <li>Block 2:</li> <li>Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik 50%</li> <li>Steuerungstechnik mit Antriebstechnik 50%</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Systemtheorie und Regelungstechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 22 von 269

## Modul: 22830 Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren I

2. Modulkürzel:	041500005		5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP		6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	3		7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	r:	UnivF	Prof. Dr. Michael Res	ch
9. Dozenten:		Colin (	Glass	
10. Zuordnung zum Cur Studiengang:	riculum in diesem	Optik,	Maschinenbau Mikro PO 961-2011, Juflagen	echnik, Gerätetechnik und Technische
11. Empfohlene Voraus	setzungen:	Grund	kenntnisse des Progr	ammierens (z.B. Matlab)
12. Lernziele:		und • Die durc • Die Wiss	Simulation. Studenten verstehen h Modelle, bis hin zu Studenten sind in der	die Grundkonzepte der Modellierung den Prozess Abbildung der Realität Programmierung und Simulation. Lage basierend auf dem erlernten beiten Modelle zu erstellen und een.
13. Inhalt:		Anal • Grur	yse)	ung (Abstraktion, Vereinfachung, n (Anwendungsgebiete, Methoden, rung)
14. Literatur:		Wird w	ährend der Vorlesun	g angegeben.
15. Lehrveranstaltunger	n und -formen:		01 Vorlesung Simula 02 Übung Simulation	tion und Modellierung I und Modellierung I
16. Abschätzung Arbeits	saufwand:	Selbst	nzzeit: 32 h studium: 58 h nt: 90 h	
17. Prüfungsnummer/n	und -name:	22831	Modellierung, Simu Schriftlich, 90 Min.,	ation und Optimierungsverfahren I (PL), Gewichtung: 1
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		PPT-P	räsentation, Tafelans	chrieb
20. Angeboten von:		Höchs	tleistungsrechnen	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 23 von 269

### Modul: 38840 Fertigungslehre mit Einführung in die Fabrikorganisation

2. Modulkürzel:	072410001	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	3	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortliche	r:	UnivProf. DrIng. Thomas Bauernhansl		
9. Dozenten:		Thomas Bauernhansl		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische</li> <li>Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Auflagen</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		keine		
12. Lernziele:		Der Studierende kann nach Besuch dieses Moduls Prozessketten zur Herstellung typischer Produkte des Maschinenbaus definieren und entsprechenden Fertigungsverfahren zuordnen, bzw. Alternativen bewerten. Er hat die Kenntnisse, dies unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklusses zu evaluieren.		

Der Studierende kennt die Ziele, die Aufgaben und grundlegenden organisatorischen Gestaltungsaspekte eines produzierenden Unternehmens. Er kennt verschiedene Innovationsstrategien, kann die wesentlichen Phasen im Produktenstehungsprozess und die wichtigsten Methoden der Produktentwicklung benennen. Weiterhin ist er in der Lage mehrere Auslöser für die Fabrikplanung aufzuzählen und kennt die Vorgehensweise bei Fabrikplanungsprojekten. Der Student kann den Grundgedanken und die Ziele des Supply Chain Managements beschreiben und kennt die verschiedenen Ebenen und Aufgaben des Supply Chain Managements. Außerdem kann er die Gründe für die Einführung von Lean Management darstellen, die Lean-Grundprinzipien erklären und die Basismethoden und Werkzeuge des Lean Managements beschreiben. Der Student kennt die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung und kann die Charakteristika der Industrie 4.0 darstellen.

#### 13 Inhalt

Die Fertigungslehre vermittelt einen Überblick über das Gebiet der Fertigungstechnik. Es werden die wichtigsten in der industriellen Produktion eingesetzten Verfahren behandelt. Dazu gehören Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten sowie das Ändern von Stoffeigenschaften. Um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Verfahren und Verfahrensgruppen darzustellen, werden vollständige Prozessketten vorgestellt. Durch unterschiedliche Prozessketten werden sämtliche zentrale Verfahren (DIN 8580) abgedeckt. Da sich aus den Prozessketten die Struktur ganzer Industrien und die innerbetriebliche Organisation ergeben, können so die Zusammenhänge zwischen den beiden Vorlesungen Fertigungslehre und Fabrikorganisation dargestellt werden.

Die Fabrikorganisation gibt einen Einblick in die Struktur, Geschäftsprozesse und den Aufbau eines Unternehmens. Neben den Grundlagen produzierender Unternehmen werden die

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 24 von 269

	Themen Innovation undEntwicklung, Fabrikplanung, Supply Chain Management, Lean Management, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Schwerpunkte aus dem Bereich Industrie 4.0 behandelt.
14. Literatur:	Vorlesungsskripte,
	<ul> <li>Einführung in die Fertigungstechnik, Westkämper/Warnecke, Teubner Lehrbuch,</li> </ul>
	<ul> <li>Einführung in die Organisation der Produktion, Westkämper, Springer Lehrbuch</li> </ul>
	<ul> <li>Wandlungsfähige Unternehmensstrukturen: Das Stuttgarter Unternehmensmodell, Westkämper Engelbert, Berlin Springer 2007</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>388403 Freiwillige Übungen Fertigungslehre mit Einführung in die Fabrikorganisation</li> <li>388401 Vorlesung Fertigungslehre</li> <li>388402 Vorlesung Einführung in die Fabrikorganisation</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit Vorlesung Fertigungslehre (2 SWS): 21h Präsenzzeit Vorlesung Einführung in die Fabrikorganisation (1 SWS): 10,5h Präsenzzeit gesamt: 31,5h Selbststudium inkl. freiwilliger Übung: 58,5h GESAMT: 90h
17. Prüfungsnummer/n und -name:	38841 Fertigungslehre mit Einführung in die Fabrikorganisation (BSL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	PowerPoint, Video, Animation, Simulation
20. Angeboten von:	Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 25 von 269

## 100 Vertiefungsmodule

Zugeordnete Module:	110	Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik
---------------------	-----	---

120 Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik

130 Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien

140 Gruppe 4: Spezifische Anwendungen33920 Industriepraktikum Maschinenbau

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 26 von 269

### 110 Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik

Zugeordnete Module: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik

32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 27 von 269

## Modul: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

2. Modulkürzel:	073400001	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zim	mermann	
9. Dozenten:		André Zimmermann Eugen Ermantraut		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Technische Optik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik> Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung> Spezialisierungsmodule		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		Die Studierenden sind in der L Konstruktion und Fertigung vo	Grundlagen der Konstruktion ischen Bauteilen und Systemen. age, die Besonderheiten der n mikrotechnischen Bauteilen und cklung und Produktion zu erkennen	
13. Inhalt:		<ul> <li>CVD-Technik, Thermische (</li> <li>Lithographie und Maskenter</li> <li>Ätztechniken zur Strukturier IE, Plasmaätzen)</li> <li>Reinraumtechnik</li> </ul>	chnik ten dünner Schichten (PVD- und Oxidation) chnik ung (Nasschemisches Ätzen, RIE,	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 28 von 269

	<ul> <li>Mikrotechnische Bauteile aus Kunststoff (z.B. Mikrospritzguss)</li> <li>Mikrobearbeitung von Metallen (z.B. spanende Mikrobearbeitung)</li> <li>Messmethoden der Mikrotechnik</li> <li>Prozessketten der Mikrotechnik</li> </ul>	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>135401 Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> <li>135402 Freiwillige Übung zur Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13541 Grundlagen der Mikrotechnik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overhead-Projektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 29 von 269

## Modul: 13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

2. Modulkürzel:	072420001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Hermann Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		<ul> <li>haben die Studierenden die Verfahren zur Herstellung v als auch der Nano- und Mik</li> <li>können die Studierenden ei</li> </ul>	ano- und Mikrosystemtechnik I wichtigsten Technologien und on Bauelementen der Mikroelektronik rosystemtechnik kennen gelernt, nzelne technologische Prozesse age Prozessabläufe selbstständig zu
		<ul> <li>Erworbene Kompetenzen:</li> <li>Die Studierenden</li> <li>können die wichtigsten Materialien der Nano- und Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben,</li> <li>können die wichtigsten Verfahren der Mikroelektronik sowie derNano- und Mikrosystemtechnik benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Herstellung von mikrotechnischen Bauelementen,</li> <li>haben ein Gefühl für den Aufwand einzelner Verfahren entwickeln können,</li> <li>sind mit den technologischen Grenzen der Verfahren vertraut und können diese bewerten,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technologischer und wirtschaftlicher Randbedingungen, die optimalen</li> </ul>	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 30 von 269

Prozessverfahren auszuwählen und einen kompletten

18. Grundlage für :	
	Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
17. Prüfungsnummer/n und -name:	Gesamt: 180 h  13561 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I (PL),
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	135601 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I
	<ul> <li>http://www.ett.bme.hu/memsedu</li> <li>Lernmaterialien:</li> <li>Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS</li> </ul>
	Online-Vorlesungen: • http://www.sensedu.com
14. Literatur:	<ul> <li>Korvink, J. G., Paul O., MEMS - A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006</li> <li>Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg, 2006</li> <li>Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> </ul>
13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt den Studierenden die Grundlagen, um die komplexen Prozessabläufe bei der Herstellung von modernen Bauelementen der Mikroelektronik sowieder Nano- und Mikrosystemtechnik zu verstehen. Nach einer Einführung in die Thematik werden zunächst die wichtigsten Materialien - insbesondere Silizium - vorgestellt. Anschließend werdendie bedeutendsten Prozesse zur Herstellung von mikroelektronischen und mikrosystemtechnischen Bauelementen und Systemen behandelt. Insbesondere werden die Grundlagenzur Dünnschichttechnik, zur Lithographie und zu den Ätzverfahren vermittelt. Abschließend werden als Vertiefung die Prozessabläufe der Oberflächen- und Bulkmikromechanik kurz vorgestellt und erläutert. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente, wie elektronische Schaltungen oder Mikrosysteme, hergestellt werden können.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 31 von 269

### Modul: 32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	072420002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Hermann Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,  → Zusatzmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik> Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Im Modul Mikrosystemtechnik	

#### 12. Lernziele:

- haben die Studierenden einen Überblick über die bedeutendsten Märkte und Bauelemente bzw. Systeme der Mikrosystemtechnik (MST) kennen gelernt
- · wissen die Studierenden, wie sich einzelne physikalische Größen bei einer Miniaturisierung verhalten bzw. ändern und wie diese Skalierung genutzt werden kann, um Mikrosensoren und mikroaktorische Antriebe zu realisieren
- können die Studierenden die bedeutendsten Sensoren und Systeme der Mikrosystemtechnik nach vorgegebene Spezifikationen entwerfen und auslegen.

### Erworbene Kompetenzen:

### Die Studierenden

- haben ein Gefühl für die Märkte der MST und können die wichtigsten Produkte der Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben
- besitzen die Grundlagen, um Auswirkungen einer Miniaturisierung auf physikalische Größen, wie mechanische Spannungen, elektrische, piezoelektrische und magnetische Kräfte, Zeitkonstanten und Frequenzen, thermische Phänomene, Reibungseffekte und das Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen beurteilen zu können
- kennen die physikalischen Grundlagen zu den bedeutendsten Wandlungsprinzipien bzw. Messeffekten der MST

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 32 von 269

- beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Realisierung von mikrosystemtechnischen Sensoren einschließlich der teilweise in den Sensoren erforderlichen mikroaktorischen Antriebe
- können anhand vorgegebener Spezifikationen einen Mikrosensor einschließlich der elektrischen Auswerteschaltung auslegen und entwerfen.

#### 13. Inhalt:

Die Vorlesung Mikrosystemtechnik vermittelt den Studierenden die Grundlagen, und das Basiswissen zur Gestaltung und Entwicklung von mikrotechnischen Funktionselementen, Sensoren und Systemen. Anhand der Skalierung von physikalischen Gesetzen und Größen werden die Grundlagen vermittelt, die zur Auslegung und Berechnung von Bauelementen und Systemen der Mikrosystemtechnik benötigt werden. Es werden die Grundlagen zur Auslegung von schwingungsfähigen Systemen, wie sie in Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren erforderlich sind, vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die in der MST bedeutendsten Wandlungsprinzipien und die Beschreibung anisotroper Effekte. Die gewonnenen Kenntnisse werden anschließend eingesetzt, um den Aufbau und die Funktionsweise der wirtschaftlich bedeutenden Mikrosensoren zu erläutern. Ausführlich wird auf die Mikrosensoren zur Messung von Abständen bzw. Wegen, Drücken, Beschleunigungen, Drehraten, magnetischen und thermischen Größen sowie Durchflüssen, Winkel und Neigungen eingegangen. Da Mikrosensoren heute in der Regel ein elektrisches Ausgangssignal liefern, werden auch für die Sensorsignalauswertung wichtige elektronische Schaltungen behandelt.

#### 14. Literatur:

- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009
- HSU Tai-Ran, MEMS and Microsystems, Wiley, 2008
- Korvink, J. G., Paul O., MEMS A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006
- Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005
- Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik,
- Mescheder U., Mikrosystemtechnik, Teubner Stuttgart Leipzig , 2000
- Pagel L., Mikrosysteme, J. Schlembach Fachverlag, 2001
   Online-Vorlesungen:
- http://www.sensedu.com
- http://www.ett.bme.hu/memsedu

Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS Übungen zur Vorlesung

#### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 322301 Vorlesung Mikrosystemtechnik

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden

#### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

Min., Gewichtung: 1

Grundlagen der Mikrosystemtechnik (PL), Schriftlich, 120

### 18. Grundlage für ...:

Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen)

#### 19. Medienform:

Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 33 von 269

32231

20. Angeboten von:

Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 34 von 269

## Modul: 32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau

2. Modulkürzel:	073400003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. André Zimmermann	
9. Dozenten:		André Zimmermann Tobias Vieten	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
11. Empfohlene Voraussetzungen:  12. Lernziele:		Das Modul "Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau" bildet zusammen mit dem Modul "Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien" den Kern der Ausbildung in der Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik für Mikrosysteme. Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über wesentliche Fragestellungen bei der Entwicklung der Aufbau- und Verbindungstechnik von Sensoren und Systemen aus verschiedenen mikrotechnischen Komponenten.  Die Studierenden sollen:  • die Vielfalt und Verschiedenheit der Aufbauten von Mikrosystemen und der Technologien der Aufbau- und Verbindungstechnik kennenlernen,  • erkennen, wie das Einsatzgebiet von Sensoren und Systemen die Anforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik bestimmt und welche Anforderungen zu erfüllen sind,  • die Einflüsse der Aufbau- und Verbindungstechnik auf die Eigenschaften der Sensoren und Systeme erkennen,  • die Auswirkungen der Aufbau- und Verbindungstechniken auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kosten kennenlernen,  • die von der Stückzahl abhängigen spezifischen Vorgehensweisen bei der Aufbau- und Verbindungstechnik von Sensoren und Systemen kennenlernen.	
		Ein besonderes Augenmerk wird auf die Erfordernisse kompletter Sensoren oder Systeme über den ganzen Lebenszyklus gelegt.	
13. Inhalt:	<del></del>	Einführung, Übersicht zu Aufba Einteilung der Sensoren und M	auten von Mikrosystemen, likrosysteme nach Anforderungen

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 35 von 269

	und Spezifikationen für verschiedene Branchen, Übersicht zu mikrotechnischen Bauelementen für Sensoren, Grundzüge zur Systemarchitektur, Übersicht über Aufbaustrategien und Montageprozesse, grundlegende Eigenschaften der eingesetzten Werkstoffe, umwelt- und betriebsbedingte Beanspruchungen und Stress in verschiedenen Anwendungen, wesentliche Ausfallmechanismen bei mikrotechnischen Bauelementen und Aufbauten, Qualität und Zuverlässigkeit von Sensoren und Mikrosystemen, Funktionsprüfung und Kalibrierung, Besonderheiten von speziellen Sensorsystemen für verschiedene Branchen, Aspekte der Fertigung von Sensoren und Mikrosystemen bei kleinen und großen Stückzahlen. Die jeweiligen Lehrinhalte werden anhand von einschlägigen Beispielen diskutiert und veranschaulicht. Die Lehrinhalte werden durch Übungen vertieft. In einem praktischen Teil wird der Bezug der Lehrinhalte zur industriellen Praxis dargestellt.	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 322401 Vorlesung (inkl. Übungen)	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32241 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 36 von 269

### 120 Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik

Zugeordnete Module: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33090 Medizingerätetechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 37 von 269

# Modul: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Sch	inköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 5. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt;</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	setzungen:	Abgeschlossene Grundlagenausk	oildung in Konstruktionslehre
12. Lernziele:		Fähigkeiten zur Analyse und Löst feinwerktechnischen Aufgabenste Berücksichtigung des Gesamtsys Berücksichtigung von Präzision, z Umgebungs- und Toleranzeinflüs und Systemen	ellungen im Gerätebau unter tems, insbesondere unter Zuverlässigkeit, Sicherheit,
13. Inhalt:		Entwicklung und Konstruktion feir Systeme mit Betonung des enger konstruktiver Gestaltung und zuge Methodik der Geräteentwicklung, Lösungsfindung, Genauigkeit und Geräten, Präzisionsgerätetechnik Aufbau genauer Geräte und Masc Toleranzanalyse, Zuverlässigkeit (zuverlässigkeits- und sicherheits Beziehungen zwischen Gerät und in der Gerätetechnik. Beispielhaft	n Zusammenhangs zwischen ehöriger Fertigungstechnologie. Ansätze zur kreativen I Fehlerverhalten in (Anforderungen und chinen), Toleranzrechnung, und Sicherheit von Geräten gerechte Konstruktion), I Umwelt, Lärmminderung

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 38 von 269

	Übungen und in den Praktika "Einführung in die 3D-Messtechnik", "Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests"
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Grundlagen der Feinwerktechnik - Konstruktion und Fertigung. Skript zur Vorlesung</li> <li>Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. München Wien: Carl Hanser 2000</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>139701 Vorlesung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik, 3 SWS</li> <li>139702 Übung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (inklusive Praktikum, Einführung in die 3D-Meßtechnik, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests), 1,0 SWS (2x1,5 h)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:138 h Gesamt: 180 h
<ul> <li>17. Prüfungsnummer/n und -name:</li> <li>13971 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feir Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewicht</li> <li>• bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündlich Minuten</li> <li>• bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 lie</li> </ul>	
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	<ul><li>Tafel</li><li>OHP</li><li>Beamer</li></ul>
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 39 von 269

# Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Sc	hinköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>     Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Zusatzmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Technische Optik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagenaus	sbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		Die Studierenden kennen die Gr- technologie (Werkstoffe, Verfah Magnetisierung). Die Studierend Antriebe (rotatorische und linear berechnen, gestalten und ausleg können elektrodynamische Antri Gleichstromkleinstmotoren) vere und auslegen. Die Studierenden magnetostriktive und andere unk	en können elektromagnetische e Schrittmotoren) vereinfacht gen. Die Studierenden ebe (rotatorische und lineare sinfacht berechnen, gestalten kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerpun	nische Antriebe unterschiedlicher kten: Verkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 40 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 41 von 269

### Modul: 33090 Medizingerätetechnik

2. Modulkürzel:	072511001	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. rer. nat. habil.	Peter Pott	
9. Dozenten:		Hans-Otto Maier Klaus Frank		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausbildung in einem Bachelor der Medizintechnik oder des Maschinenbaus		
12. Lernziele:		Fähigkeiten zum Verständnis und zur Analyse komplexer Anforderungen an Medizingeräte und daraus abgeleiteter Konzeption entsprechender Gerätesysteme		
13. Inhalt:		<ul> <li>Medizingerätetechnik I: An Hand von Krankheitsbildern werden Bedeutung und Grenzen der Medizingerätetechnik aufgezeigt. Die Vorlesung folgt dazu dem Patienten von der Einlieferung bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus: <ul> <li>Ambulanz (Bildgebung, Wundversorgung, Atemunterstützung, Monitoring)</li> <li>Im OP (Patientenlagerung, Licht, Operationsbesteck, Sterilisierbarkeit, Mechanische Assistenzsysteme, Optische Bildgebung)</li> <li>In der Intensivstation, Im Patientenzimmer, Labormedizin</li> <li>Medizintechnik im Alltag (Geräte für die häusliche Anwendung, Prothesen, Telemedizin) Krankenhaustechnik (Kommunikation, Energie- und Medienversorgung, Entsorgung und Reinigung)</li> </ul></li></ul>		
		Medizingerätetechnik II:		

#### Medizingerätetechnik II:

Entwicklungsmethodik und Ablauf der Entwicklung von Medizingeräten unter der Reglementierung der Zulassung von Medizingerätetechniken in Europa und USA. Beispiele von Medizingeräteentwicklungen (z. B Infusionspumpe).

- Definition Medizinprodukte, rechtliche und normative Grundlagen
- Einteilung Medizinprodukte, Klassifizierung, Risikoklassen
- Gesetzliche Regelungen, Zulassungsgrundsätze, EU USA -Japan - China

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 42 von 269

	<ul> <li>Entwicklungsgrundlagen, Lasten-/Pflichtenheft, Konstruktion, Verifikation, Qualitätssicherung</li> <li>Serienproduktion, vom Prototyp zur Serie, Life Cycle Management, Qualitätssicherung</li> </ul>
14. Literatur:	Skripte als PDF der Vorlesungspräsentationen
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	330901 Medizingerätetechnik
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit 42 Std., Selbststudium 138 Std., Summe 180 Std.
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33091 Medizingerätetechnik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Medizingerätetechnik I und Medizingerätetechnik II als zwei getrennte Teilprüfungen
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overheadprojektor, Beamer, Präsentation
20. Angeboten von:	Medizingerätetechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 43 von 269

### 130 Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien

Zugeordnete Module: 14060 Grundlagen der Technischen Optik

14140 Materialbearbeitung mit Lasern

33420 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 44 von 269

# Modul: 14060 Grundlagen der Technischen Optik

2. Modulkürzel:	073100001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oster	า
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Erich Steinbeißer Christof Pruß Alexander Bielke	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	HM 1 - HM 3, Experimentalphysik	
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Studierenden</li> <li>erkennen die Möglichkeiten und Grenzen der abbildenden Optik auf Basis des mathematischen Modells der Kollineation</li> <li>sind in der Lage, grundlegende optische Systeme zu klassifizieren und im Rahmen der Gaußschen Optik zu berechnen</li> <li>verstehen die Grundzüge der Herleitung der optischen Phänomene "Interferenz" und "Beugung" aus den Maxwell-Gleichungen</li> <li>können die Grenzen der optischen Auflösung definieren</li> <li>können grundlegende optische Systeme (wie z.B. Mikroskop, Messfernrohr und Interferometer) einsetzen und bewerten</li> </ul>	
13. Inhalt:		<ul> <li>optische Grundgesetze der In Dispersion,</li> <li>Kollineare (Gaußsche) Optike</li> <li>optische Bauelemente und Interesionen</li> <li>Wellenoptik: Grundlagen der Abbildungsfehler,</li> <li>Strahlung und Lichttechnik</li> <li>Lust auf Praktikum?</li> <li>Zur beispielhaften Anwendung bieten wir fakultativ ein kleines Herrn Steinbeißer wenden.</li> </ul>	k, nstrumente, r Beugung und Auflösung,
14. Literatur:		Formelsammlung,	en der Vorlesung, Übungsblätter, en mit ausführlichen Lösungen,

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 45 von 269

	<ul> <li>Fleisch: A Student's Guide to Maxwell's Equation, 2011</li> <li>Fleisch: A Student's Guide to Waves, 2015</li> <li>Gross: Handbook of Optical Systems Vol. 1, Fundamentals of Technical Optics, 2005</li> <li>Haferkorn: Optik, Wiley, 2002</li> <li>Hecht: Optik, Oldenbourg, 2014</li> <li>Kühlke: Optik, Harri Deutsch, 2011</li> <li>Naumann, Schröder, Löffler-Mang: Handbuch Bauelemente der Optik, 2014</li> <li>Pedrotti: Optik für Ingenieure, Springer, 2007</li> <li>Schröder: Technische Optik, Vogel, 2007</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>140601 Vorlesung Grundlagen der Technischen Optik</li> <li>140602 Übung Grundlagen der Technischen Optik</li> <li>140603 Praktikum Grundlagen der Technischen Optik</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitszeit: 138h = 180
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>14061 Grundlagen der Technischen Optik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Powerpoint-Vorlesung mit zahlreichen Demonstrations-Versuchen, Übung: Notebook + Beamer, OH-Projektor, Tafel, kleine "Hands-on" Versuche gehen durch die Reihen
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 46 von 269

# Modul: 14140 Materialbearbeitung mit Lasern

2. Modulkürzel:	073010001	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Thomas Graf	:	
9. Dozenten:		Thomas Graf		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	issetzungen:	Schulkenntnisse in Mathema	atik und Physik.	
12. Lernziele:		insbesondere beim Schweiß Oberflächenveredeln und Ui Wissen, welche Strahl-, Mat sich wie auf die Prozesse au	ichkeiten des Strahlwerkzeuges Laser Ben, Schneiden, Bohren, Strukturieren, rformen kennen und verstehen. Perial- und Umgebungseigenschaften uswirken. Bearbeitungsprozesse enz bewerten und verbessern können.	
13. Inhalt:		<ul> <li>Komponenten und Systen Strahlführung, Werkstückl</li> <li>Wechselwirkung Laserstra</li> <li>physikalische und technol Schneiden, Bohren und A</li> </ul>	Polarisation, etc.) auf die Fertigung, ne zur Strahlformung und handhabung, ahl-Werkstück ogische Grundlagen zum btragen, Schweißen und rozeßkontrolle, Sicherheitsaspekte,	
14. Literatur:		Buch: Helmut Hügel und Fertigung, Springer Viewer ISBN 978-3-8348-1817-1		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	141401 Vorlesung mit inte Lasern	grierter Übung Materialbearbeitung mit	
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 42h + Nacharb	eitszeit: 138h = 180h	
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	14141 Materialbearbeitung Gewichtung: 1	mit Lasern (PL), Schriftlich, 120 Min.,	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:				

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 47 von 269

20. Angeboten von:

Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 48 von 269

# Modul: 33420 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung

2. Modulkürzel:	073000003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Thomas Graf		
9. Dozenten:		Rudolf Weber Andreas Letsch		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:			
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Voraussetzungen für sinnvolle und effiziente Laser-Anwendungen in der Materialbearbeitung kennen und verstehen.</li> <li>Begreifen der für den Anlagenbau entscheidendenLaserprozessgrößen.</li> <li>Wissen wie diese durch geeignete Auslegung der Anlagen erfüllt werden können.</li> <li>Anlagen bezüglich technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten und verbessern können.</li> </ul>		
13. Inhalt:		<ul> <li>Die wichtigsten Anwendungen des Lasers in der Materialbearbeitung</li> <li>Anlagenkonzepte vom Roboterschweißen bis zur Laserfusion</li> <li>Auslegung der Anlage von den mechanische Komponenten und Strahlführungssystemen bis zur Achsendynamik</li> <li>Peripherie von der Steuerung bis zu Sicherheitsaspekten</li> <li>Kommerzielle Aspekte von der Stückkostenrechnung bis zur Anlagenamortisation</li> </ul>		
14. Literatur:		Folien der Vorlesungen		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>334201 Vorlesung Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung Teil I: von der Anwendung zur Anlage</li> <li>334202 Vorlesung Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung Teil II: von der Anlage zum Betrieb</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	Anwendung zur Anlag  1 • 33422 Anlagetechnik für die Anlage zum Betrieb (F Die Prüfung des Moduls Anlag Fertigungbesteht aus den zwe		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 49 von 269

	[33422] Tell 2: von der Anlage zum Betrieb, Gewichtung 0,5 Nach Möglichkeit werden die beiden Teilprüfungen am selben Termin durchgeführt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 50 von 269

### Modul: 33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

2. Modulkürzel:	073100002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Osten	
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Klaus Körner Erich Steinbeißer	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		<ul> <li>verstehen die Unterschiede zwischen wellenoptischer und geometrisch-optischer Beschreibung,</li> <li>sind in der Lage, die in Wellenfeldern enthaltene Information zu beschreiben,</li> <li>können Messungen kritisch mittels Fehleranalyse bewerten,</li> <li>kennen die Rolle und Wirkungsweise der wichtigsten Komponenten und sind in der Lage, optische Mess-Systeme aus einzelnen Komponenten zusammenzustellen und zu bewerten,</li> <li>sind in der Lage, Methoden zur Vermessung von optischen und technischen Oberflächen sowie deren Oberflächenveränderungen zielgerichtet einzusetzen.</li> </ul>	
13. Inhalt:		Grundlagen der geometrisch - optische Komponenten - optische Systeme Grundlagen der Wellenoptik: - Wellentypen - Interferenz und Kohärenz	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 51 von 269

	- Beugung und Auflösungsvermögen Holografie Speckle Klassifikation und Charakterisierung von Oberflächen Messfehler Grundprinzipien und Klassifikation optischer Messtechniken Messmethoden auf Basis der geometrischen Optik: - Strukturierte Beleuchtung - Moire - Messmikroskope und Messfernrohre Messmethoden auf Basis der Wellenoptik: - interferometrische Messtechniken - Interferenzmikroskopie - holografische Interferometrie - Speckle-Messtechniken - Laufzeittechniken
14. Literatur:	Manuskript der Vorlesung, Pedrotti, F., et al: Optik für Ingenieure. Springer Verlag, Berlin 2007, Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Verlag, München 2014, Malacara, D.: Optical shop testing 2007, Cathey, T.: Optical Information Processing and Holography 1974, Erf, R.: Speckle metrology 1978.
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>337101 Vorlesung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> <li>337102 Übung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33711 Optische Messtechnik und Messverfahren (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 52 von 269

### 140 Gruppe 4: Spezifische Anwendungen

Zugeordnete Module: 32220 Grundlagen der Biomedizinischen Technik

32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 53 von 269

# Modul: 32220 Grundlagen der Biomedizinischen Technik

2. Modulkürzel:	040900001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Joachim Nagel	
9. Dozenten:		Joachim Nagel Johannes Port	
10. Zuordnung zum Co Studiengang:	urriculum in diesem	Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> B Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer/Ergänzungsfä Technik> Spezialisierun M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Gruppe 4: Spezifische Ar M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Zusatzmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semes	nnik, Gerätetechnik und Technische ter icher mit 6 LP> Biomedizinische ngsmodule nnik, Gerätetechnik und Technische ter wendungen> Vertiefungsmodule nnik, Gerätetechnik und Technische ter nwendungen ich nik, Gerätetechnik und Technische ter nnik, Gerätetechnik und Technische ter
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		<ul> <li>besitzen fundamentale Kenn und von der Physiologie der Funktionen</li> <li>können die Verfahren bewert in der biomedizinischen Teck</li> <li>verfügen über einen wesentli biomedizinischer Begriffe</li> <li>besitzen sowohl grundlegend Fach- und Methodenwissen medizinische Kenntnisse</li> <li>sind in der Lage, eine Verbin Biologie einerseits und den li andererseits herzustellen som molekularen Ebene bis hin zierforschen und neue Materia</li> </ul>	rundlagen und theoretischen wichtiger biomedizinischer se gängiger bildgebender Verfahren tnisse der funktionellen Stimulation zu ersetzenden natürlichen ten und deren Einsatzmöglichkeiten nik beurteilen ichen Grundwortschatz des theoretisches und praktisches als auch biologische und dung zwischen der Medizin und ngenieurund Naturwissenschaften wie neue Kenntnisse von der u gesamten Organsystemen zu dien, Systeme, Verfahren und dem Ziel der Prävention, Diagnose

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 54 von 269

der Patientenversorgung, der Rehabilitation und der Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme.

#### 13. Inhalt:

In dem Modul werden folgende Inhalte vermittelt:

- die besonderen Probleme bei der Messung physiologischer Kenngrößen
- die grundlegenden Eigenschaften biologischer Gewebe
- die Besonderheiten der Elektroden und damit die entsprechenden einzuhaltenden Maßnahmen bei der Ableitung der Signale
- die physikalischen Grundlagen wichtiger mechanoelektrischer, photoelektrischer, elektrochemischer und thermoelektrischer Wandler
- die wesentlichen Prinzipien und die biomedizinisch spezifischen Besonderheiten der Signalerfassung, Signalverarbeitung, Signalverstärkung und Signalübertragung
- allgemeine Eigenschaften des kardiovaskulären und respiratorischen Systems
- Messverfahren kardiovaskulärer Kenngrößen, wie Elektrokardiogramm, Impedanzkardiogramm, Impedanzplethysmogramm, Blutdruckmessung, Blutflussmessung, etc.
- Messverfahren respiratorischer Kenngrößen, wie Impedanzpneumographie, Pneumotachographie, Spirometrie, Ganzkörperplethysmographie, etc.
- Messverfahren biochemischer Kenngrößen, wie pH-Wert-Messung, Ionenkonzentrationsmessung, Sauerstoffmessung, etc.
- Messverfahren neurologischer Kenngrößen, wie das Elektroenzephalogramm, Elektroneurogramm, Evozierte Potentiale, etc.
- Messverfahren visueller Kenngröße, wie das Elektrookulogramm, das Elektroretinogramm, etc., - wichtige physikalische, akustische Kenngrößen
- Messverfahren akustischer Kenngrößen, wie das Audiogramm, otoakustisch evozierte Potentiale, Elektrocochleogramm, etc.
- Messverfahren weiterer wichtiger Kenngrößen, wie das Elektromyogramm, Elektronystagmogramm, etc.
- Bildgebende Verfahren, wie die Röntgentechnik, Ultraschall, Magnetresonanztechnik, Endoskopietechnik, Thermographie, etc.
- Beispiele für Implantate und Funktionsersatz, wie das Cochlea-Implantat, Mittelohrprothese, Hörgeräte, Herzschrittmacher, Herzklappenersatz, etc.
- Beispiele aktueller Forschung, wie das Brain- Computer Interface, biohybride Armprothese, etc..

#### 14. Literatur:

- Port, J.: Grundlagen der Biomedizinischen Technik, Vorlesungsskript und Vorlesungsfolien
- Bronzino, J.: The Biomedical Engineering Handbook I+II, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000
- Wintermantel, E., Ha, S.-W.: Medizintechnik: Life Science Engineering, 5. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
- Kramme, R.: Medizintechnik, 3. Auflage, Springer- Verlag, 2007
- Schmidt, R., Lang, F.: Physiologie des Menschen, 30. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007
- Eichmeier, J.: Medizinische Elektronik, 3. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1997

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 55 von 269

20. Angeboten von:

• Czichos, H., Hennecke, M., Hütte: Das Ingenieurwissen, 33. Auflage, Springer-Verlag Berlin • Heidelberg, 2008 - Dössel, O.: Bildgebende Verfahren in der Medizin, Springer-Verlag Berlin • Heidelberg, 2000 - Kalender, W.: Computertomographie. Grundlagen, Gerätetechnologie, Bildqualität, Anwendungen, 2. Auflage, Publicis Corporate Publishing Verlag, 2006 • Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 261. Auflage, Walter de Gruyter-Verlag, 2007 • Bannwarth, H., Kremer, B. P., Schulz, A.: Basiswissen Physik, Chemie und Biochemie, Springer- Verlag Berlin Heidelberg, • Brdicka, R.: Grundlagen der physikalischen Chemie, 15. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, 1990 15. Lehrveranstaltungen und -formen: 322201 Grundlagen der Biomedizinischen Technik 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 58 Stunden Selbststudium: 122 Stunden Summe: 180 Stunden 17. Prüfungsnummer/n und -name: 32221 Grundlagen der Biomedizinischen Technik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1 18. Grundlage für ...: Übungen zur Biomedizinischen Technik Beamer-Präsentation, Overhead-Projektor, Tafel 19. Medienform:

Biomedizinische Technik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 56 von 269

# Modul: 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Joachim Burg	hartz
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	V/Ü Grundlagen der Mikroelektro	nikfertigung (Empfehlung)
12. Lernziele:		Vermittlung weiterführender Kenntnisse der wichtigsten Technologien und Techniken in der Elektronikfertigung	
13. Inhalt:		in die Herstellung von Mikrochips	te und praxisbezogene Einführung und die besonderen Aspekte chaltungen sowie dem Verpacken
14. Literatur:		<ul> <li>D. Neamon:Semiconductor Phy 2002</li> <li>S. Wolf: Silicon Processing for t 1990</li> <li>S. Sze: Physics of Semiconduct Interscience, 1981</li> <li>P.E. Allen and D.R. Holberg: CN Saunders College Publishing.</li> </ul>	he VLSI Era, Vol. 2, Lattice Press, tor Devices, 2nd Ed. Wiley

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 57 von 269

	<ul> <li>L.E. Glasser and D.W. Dobberpuhl: The Design and Aanalysis of VLSI Circuits, Addison Wesley.</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	322501 Vorlesung und Übung Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (Blockveranstaltung)	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32251 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 oder bei geringer Anzahl Studierender: mündlich, 40 min.	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	PowerPoint	
20. Angeboten von:	Mikroelektronik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 58 von 269

# Modul: 33920 Industriepraktikum Maschinenbau

2. Modulkürzel:	072410017	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	0	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. Thomas	s Bauernhansl
9. Dozenten:			
10. Zuordnung zum C Studiengang:	urriculum in diesem	M.Sc. Maschinenbau Mikro Optik, PO 961-2011, 3. Ser → Vertiefungsmodule	otechnik, Gerätetechnik und Technische mester
11. Empfohlene Vorau	ıssetzungen:		
12. Lernziele:		Nachdem der Student oder besucht hat, wird er bzw. s	r die Studentin das Fachpraktikum ie in der Lage sein:
		<ol> <li>Die zu wählende Spezialisierung im Berufsfeld ausgeher vom Studium des ",Allgemeinen Maschinenbaus' aufgrur des gewonnen Überblicks bei der Vertiefung der erworbe theoretische Kenntnisse in der Praxis zu beurteilen.</li> <li>Die der Fertigung vor- und nachgeschalteten Bereiche in ihrem komplexen Zusammenwirken zu beurteilen und zu beschreiben.</li> <li>Komplexe technische Zusammenhänge und Produktionsprozesse schriftlich zu dokumentieren</li> </ol>	
13. Inhalt:		Siehe Praktikantenrichtlinien Maschinenbau	
14. Literatur:			
15. Lehrveranstaltung	en und -formen:	339201 Industriepraktikur	m Maschinenbau
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	360 Stunden	
17. Prüfungsnummer/	n und -name:	33921 Industriepraktikum Maschinenbau (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für:			
19. Medienform:			
20. Angeboten von:		Industrielle Fertigung und F	abrikbetrieb

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 59 von 269

# 200 Spezialisierungsmodule

Zugeordnete Module: 220 Elektronikfertigung

230 Feinwerktechnik

240 Laser in der Materialbearbeitung

250 Mikrosystemtechnik260 Technische Optik

270 Medizingerätekonstruktion

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 60 von 269

### 220 Elektronikfertigung

Zugeordnete Module: 221 Kernfächer mit 6 LP

222 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP223 Ergänzungsfächer mit 3 LP

33290 Praktikum Mikroelektronikfertigung

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 61 von 269

### 221 Kernfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 14030 Fundamentals of Microelectronics

32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 62 von 269

### Modul: 14030 Fundamentals of Microelectronics

2. Modulkürzel: 0521	10002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP		6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS: 4		7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Joachim Burg	hartz
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzun	gen:	keine	
12. Lernziele:		Studierende kennen wesentliche Werkstoffe, Prozessschritte, Integ Volumenproduktionsverfahren in	grationsprozesse und
13. Inhalt:		<ul> <li>History and Basics of IC Technology</li> <li>Process Technology I and II</li> <li>Process Modules</li> <li>MOS Capacitor</li> <li>MOS Transistor</li> <li>Non-Ideal MOS Transistor</li> <li>Basics of CMOS Circuit Integration</li> <li>CMOS Device Scaling</li> <li>Metal-Silicon Contact</li> <li>Interconnects</li> <li>Design Metrics</li> <li>Special MOS Devices</li> <li>Future Directions</li> </ul>	
14. Literatur:		<ul> <li>D. Neamon:Semiconductor Physics and Devices, Mc Graw-Hill 2002</li> <li>S. Wolf: Silicon Processing for the VLSI Era, Vol. 2, Lattice Press, 1990</li> <li>S. Sze: Physics of Semiconductor Devices, 2<sup>nd</sup> Ed. Wiley Interscience, 1981</li> <li>S. Sze: Fundamentals of Semiconductor Fabrication, Wiley Interscience, 2003</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:  • 140301 Vorlesung und Übung Grundlagen der Mikroelektronikfertigung		Grundlagen der	
16. Abschätzung Arbeitsaufwa	ınd:	Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitsze	eit: 138h = 180h
17. Prüfungsnummer/n und -name:		14031 Fundamentals of Microelectronics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :			
19. Medienform:		Beamer, Tafel, persönliche Intera	ktion

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 63 von 269

20. Angeboten von:

Mikroelektronik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 64 von 269

# Modul: 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Joachim Burg	hartz
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	V/Ü Grundlagen der Mikroelektro	nikfertigung (Empfehlung)
12. Lernziele:		Vermittlung weiterführender Kenntnisse der wichtigsten Technologien und Techniken in der Elektronikfertigung	
13. Inhalt:		in die Herstellung von Mikrochips	te und praxisbezogene Einführung und die besonderen Aspekte chaltungen sowie dem Verpacken
14. Literatur:		<ul> <li>D. Neamon:Semiconductor Phy 2002</li> <li>S. Wolf: Silicon Processing for t 1990</li> <li>S. Sze: Physics of Semiconduct Interscience, 1981</li> <li>P.E. Allen and D.R. Holberg: CN Saunders College Publishing.</li> </ul>	he VLSI Era, Vol. 2, Lattice Press, tor Devices, 2nd Ed. Wiley

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 65 von 269

	<ul> <li>- L.E. Glasser and D.W. Dobberpuhl: The Design and Aanalysis of VLSI Circuits, Addison Wesley.</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>322501 Vorlesung und Übung Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (Blockveranstaltung)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32251 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 oder bei geringer Anzahl Studierender: mündlich, 40 min.
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	PowerPoint
20. Angeboten von:	Mikroelektronik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 66 von 269

### 222 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

14030 Fundamentals of Microelectronics

14230 Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 67 von 269

# Modul: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

2. Modulkürzel:	073400001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zimr	nermann
9. Dozenten:		André Zimmermann Eugen Ermantraut	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> N Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 1: Mikrotechnik/N Vertiefungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  Optik, PO 961-2011, 1. Semes	Alikrosystemtechnik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter mit 6 LP> Technische Optik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter mit 6 LP> Feinwerktechnik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter Alikrosystemtechnik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter mit 6 LP> Mikrosystemtechnik>
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Die Studierenden sind in der La Konstruktion und Fertigung vor	Grundlagen der Konstruktion schen Bauteilen und Systemen. age, die Besonderheiten der nikrotechnischen Bauteilen und cklung und Produktion zu erkennen
13. Inhalt:		<ul> <li>CVD-Technik, Thermische C</li> <li>Lithographie und Maskentec</li> <li>Ätztechniken zur Strukturieru IE, Plasmaätzen)</li> <li>Reinraumtechnik</li> </ul>	chnik en dünner Schichten (PVD- und Oxidation) hnik ung (Nasschemisches Ätzen, RIE, erbindungstechnik für Mikrosysteme

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 68 von 269

	<ul> <li>Mikrotechnische Bauteile aus Kunststoff (z.B. Mikrospritzguss)</li> <li>Mikrobearbeitung von Metallen (z.B. spanende Mikrobearbeitung)</li> <li>Messmethoden der Mikrotechnik</li> <li>Prozessketten der Mikrotechnik</li> </ul>	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>135401 Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> <li>135402 Freiwillige Übung zur Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13541 Grundlagen der Mikrotechnik (PL), Schriftlich oder Mündlich 40 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overhead-Projektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 69 von 269

### Modul: 13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

O. Madullaine ali	07040004	C. Maduldavan	Financia atria
2. Modulkürzel:	072420001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. Hermann Sa	andmaier
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier	
10. Zuordnung zum C Studiengang:	urriculum in diesem	Optik, PO 961-2011, 1. Semest  → Kern-/Ergänzungsfächer r Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semest  → Kern-/Ergänzungsfächer r Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semest  → Gruppe 1: Mikrotechnik/M Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semest  → Kern-/Ergänzungsfächer r Spezialisierungsmodule	nik, Gerätetechnik und Technische er mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> nik, Gerätetechnik und Technische er nik, Gerätetechnik und Technische er nik, Gerätetechnik und Technische er nit 6 LP> Elektronikfertigung> nik, Gerätetechnik und Technische er nik, Gerätetechnik und Technische er
11. Empfohlene Vorau	ıssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		<ul><li>als auch der Nano- und Mikro</li><li>können die Studierenden ein:</li></ul>	vichtigsten Technologien und n Bauelementen der Mikroelektronik osystemtechnik kennen gelernt,
		<ul> <li>Erworbene Kompetenzen:</li> <li>Die Studierenden</li> <li>können die wichtigsten Materialien der Nano- und Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben,</li> <li>können die wichtigsten Verfahren der Mikroelektronik sowie derNano- und Mikrosystemtechnik benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Herstellung von mikrotechnischen Bauelementen,</li> <li>haben ein Gefühl für den Aufwand einzelner Verfahren entwickeln können,</li> <li>sind mit den technologischen Grenzen der Verfahren vertraut und können diese bewerten,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technologischer und wirtschaftlicher Randbedingungen, die optimalen</li> </ul>	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 70 von 269

Prozessverfahren auszuwählen und einen kompletten

19. Medienform:	Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel,
18. Grundlage für :	Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13561 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I (PL),
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	135601 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnil I
	Online-Vorlesungen:  • http://www.sensedu.com  • http://www.ett.bme.hu/memsedu  Lernmaterialien:  • Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS
14. Literatur:	<ul> <li>Korvink, J. G., Paul O., MEMS - A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006</li> <li>Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg, 2006</li> <li>Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> </ul>
13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt den Studierenden die Grundlagen, um die komplexen Prozessabläufe bei der Herstellung von modernen Bauelementen der Mikroelektronik sowieder Nano- und Mikrosystemtechnik zu verstehen. Nach einer Einführung in die Thematik werden zunächst die wichtigsten Materialien - insbesondere Silizium - vorgestellt. Anschließend werdendie bedeutendsten Prozesse zur Herstellung von mikroelektronischen und mikrosystemtechnischen Bauelementen und Systemen behandelt. Insbesondere werden die Grundlagenzur Dünnschichttechnik, zur Lithographie und zu den Ätzverfahren vermittelt. Abschließend werden als Vertiefung die Prozessabläufe der Oberflächen- und Bulkmikromechanik kurz vorgestellt und erläutert. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente, wie elektronische Schaltungen oder Mikrosysteme, hergestellt werden können.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 71 von 269

# Modul: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 5. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre	
12. Lernziele:		Fähigkeiten zur Analyse und Lösung von komplexen feinwerktechnischen Aufgabenstellungen im Gerätebau unter Berücksichtigung des Gesamtsystems, insbesondere unter Berücksichtigung von Präzision, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umgebungs- und Toleranzeinflüssen beim Entwurf von Geräten und Systemen	
13. Inhalt:		Entwicklung und Konstruktion feinwerktechnischer Geräte und Systeme mit Betonung des engen Zusammenhangs zwischen konstruktiver Gestaltung und zugehöriger Fertigungstechnologie. Methodik der Geräteentwicklung, Ansätze zur kreativen Lösungsfindung, Genauigkeit und Fehlerverhalten in Geräten, Präzisionsgerätetechnik (Anforderungen und Aufbau genauer Geräte und Maschinen), Toleranzrechnung, Toleranzanalyse, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Geräten (zuverlässigkeits- und sicherheitsgerechte Konstruktion), Beziehungen zwischen Gerät und Umwelt, Lärmminderung in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 72 von 269

	Übungen und in den Praktika "Einführung in die 3D-Messtechnik", "Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests"	
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Grundlagen der Feinwerktechnik - Konstruktion und Fertigung. Skript zur Vorlesung</li> <li>Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. München Wien: Carl Hanser 2000</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>139701 Vorlesung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik, 3 SWS</li> <li>139702 Übung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (inklusive Praktikum, Einführung in die 3D-Meßtechnik, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests), 1,0 SWS (2x1,5 h)</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13971 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik ( Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	<ul><li>Tafel</li><li>OHP</li><li>Beamer</li></ul>	
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 73 von 269

#### Modul: 14030 Fundamentals of Microelectronics

2. Modulkürzel: 0521	10002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP		6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS: 4		7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Joachim Burg	hartz
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzun	gen:	keine	
12. Lernziele:		Studierende kennen wesentliche Werkstoffe, Prozessschritte, Integ Volumenproduktionsverfahren in	grationsprozesse und
13. Inhalt:		<ul> <li>History and Basics of IC Techn</li> <li>Process Technology I and II</li> <li>Process Modules</li> <li>MOS Capacitor</li> <li>MOS Transistor</li> <li>Non-Ideal MOS Transistor</li> <li>Basics of CMOS Circuit Integral</li> <li>CMOS Device Scaling</li> <li>Metal-Silicon Contact</li> <li>Interconnects</li> <li>Design Metrics</li> <li>Special MOS Devices</li> <li>Future Directions</li> </ul>	
14. Literatur:		<ul> <li>D. Neamon:Semiconductor Phy 2002</li> <li>S. Wolf: Silicon Processing for Press, 1990</li> <li>S. Sze: Physics of Semiconductinterscience, 1981</li> <li>S. Sze: Fundamentals of Semiconductinterscience, 2003</li> </ul>	the VLSI Era, Vol. 2, Lattice
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		• 140301 Vorlesung und Übung G Mikroelektronikfertigung	Grundlagen der
16. Abschätzung Arbeitsaufwa	ınd:	Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitsze	eit: 138h = 180h
17. Prüfungsnummer/n und -n	ame:	14031 Fundamentals of Microele Mündlich, 120 Min., Gewi	` ,
18. Grundlage für :			
19. Medienform:		Beamer, Tafel, persönliche Intera	ktion

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 74 von 269

20. Angeboten von:

Mikroelektronik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 75 von 269

# Modul: 14230 Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Industrieroboter

2. Modulkürzel:	072910003	5. Modulo	dauer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus	s: Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprach	ne: Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	Michael Seyfarth	
9. Dozenten:		Alexander Verl	
10. Zuordnung zum Cu Studiengang:	rriculum in diesem	Optik, PO 961-201	zungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	Vorlesung "Steueru Regelungs- und St	ungstechnik mit Antriebstechnik" (Modul euerungstechnik)
12. Lernziele:  Die Studierenden kennen typische Anwendungen of Steuerungstechnik in Werkzeugmaschinen und Ind Sie verstehen die Möglichkeiten heutiger Steuerun vor dem Hintergrund komfortabler Bedienerführung Mess- und Antriebsregelungstechnik (mechatronist sowie Diagnosehilfen bei Systemausfall. Aus der K verschiedenen Steuerungsarten und Steuerungsfu für Werkzeugmaschinen und Industrieroboter könn Studierenden die Komponenten innerhalb der Steu z.B. Lagesollwertbildung oder Adaptive Control-Ve interpretieren. Sie können die Auslegung der Antrie und die zugehörigen Problemstellungen der Regele Messtechnik verstehen, bewerten und Lösungen e Die Studierenden können erkennen, wie die Kinem Dynamik von Robotern und Parallelkinematiken be gelöst und steuerungstechnisch integriert werden k		in Werkzeugmaschinen und Industrierobotern. Möglichkeiten heutiger Steuerungskonzepte nd komfortabler Bedienerführung, integrierter sregelungstechnik (mechatronische Systeme) fen bei Systemausfall. Aus der Kenntnis der uerungsarten und Steuerungsfunktionen schinen und Industrieroboter können die Komponenten innerhalb der Steuerung, wie ildung oder Adaptive Control-Verfahren können die Auslegung der Antriebstechnik en Problemstellungen der Regelungs- und ehen, bewerten und Lösungen erarbeiten. können erkennen, wie die Kinematik und otern und Parallelkinematiken beschrieben,	
13. Inhalt:		<ul> <li>Steuerungsarten (mechanisch, fluidisch, Numerische Steuerung Robotersteuerung): Aufbau, Architektur, Funktionsweise.</li> <li>Mess-, Antriebs-, Regelungstechnik für Werkzeugmaschinen und Industrieroboter</li> <li>Kinematische und Dynamische Modellierung von Robotern und Parallelkinematiken.</li> <li>Praktikum zur Inbetriebnahme von Antriebssystemen und regelungstechnischer Einstellung.</li> </ul>	
14. Literatur:		Pritschow, G.: Einführung in die Steuerungstechnik, Carl Hanser Verlag, München, 2006	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:			g mit Übung Steuerungstechnik der inen und Industrieroboter
16. Abschätzung Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42h Nacharbeitszeit: 138h Gesamt: 180h		38h	
17. Prüfungsnummer/n	und -name:		stechnik der Werkzeugmaschinen und boter (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., g: 1

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 76 von 269

#### 18. Grundlage für ...:

19. Medienform:	Beamer, Overhead, Tafel
20. Angeboten von:	Application of Simulation Technology in Manufacturing Engineering

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 77 von 269

## Modul: 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Joachim Bu	urghartz	
9. Dozenten:		Joachim Burghartz		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	V/Ü Grundlagen der Mikroelekt	tronikfertigung (Empfehlung)	
12. Lernziele:		Vermittlung weiterführender Ke Technologien und Techniken ir		
13. Inhalt:		Die Vorlesung bietet eine fundierte und praxisbezogene Einführung in die Herstellung von Mikrochips und die besonderen Aspekte beim Test mikroelektronischer Schaltungen sowie dem Verpacken der Chips in IC-Gehäuse.  Grundlagen der Mikroelektronik Lithografieverfahren Wafer-Prozesse CMOS-Gesamtprozesse Packaging und Test Qualität und Zuverlässigkeit		
14. Literatur:		2002	·	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 78 von 269

	<ul> <li>- L.E. Glasser and D.W. Dobberpuhl: The Design and Aanalysis of VLSI Circuits, Addison Wesley.</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>322501 Vorlesung und Übung Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (Blockveranstaltung)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32251 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 oder bei geringer Anzahl Studierender: mündlich, 40 min.
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	PowerPoint
20. Angeboten von:	Mikroelektronik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 79 von 269

## Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Sc	hinköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>     Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Zusatzmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Technische Optik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagenaus	sbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		Die Studierenden kennen die Gr- technologie (Werkstoffe, Verfah Magnetisierung). Die Studierend Antriebe (rotatorische und linear berechnen, gestalten und ausleg können elektrodynamische Antri Gleichstromkleinstmotoren) vere und auslegen. Die Studierenden magnetostriktive und andere unk	en können elektromagnetische e Schrittmotoren) vereinfacht gen. Die Studierenden ebe (rotatorische und lineare sinfacht berechnen, gestalten kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerpun	nische Antriebe unterschiedlicher kten: Verkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 80 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 81 von 269

## Modul: 33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

2. Modulkürzel:	073100002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oster	١
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Klaus Körner Erich Steinbeißer	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> T Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 3: Optische Tech Fertigungstechnologien - M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes	mit 6 LP> Technische Optik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster Technische Optik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster nologien / Optische -> Vertiefungsmodule hnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Elektronikfertigung> hnik, Gerätetechnik und Technische
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		<ul><li>beschreiben,</li><li>können Messungen kritisch i</li><li>kennen die Rolle und Wirkur Komponenten und sind in de</li></ul>	hreibung, enfeldern enthaltene Information zu mittels Fehleranalyse bewerten, ngsweise der wichtigsten er Lage, optische Mess-Systeme aus sammenzustellen und zu bewerten, zur Vermessung von Dberflächen sowie deren
13. Inhalt:		Grundlagen der geometrisch - optische Komponenten - optische Systeme Grundlagen der Wellenoptik: - Wellentypen - Interferenz und Kohärenz	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 82 von 269

	- Beugung und Auflösungsvermögen Holografie Speckle Klassifikation und Charakterisierung von Oberflächen Messfehler Grundprinzipien und Klassifikation optischer Messtechniken Messmethoden auf Basis der geometrischen Optik: - Strukturierte Beleuchtung - Moire - Messmikroskope und Messfernrohre Messmethoden auf Basis der Wellenoptik: - interferometrische Messtechniken - Interferenzmikroskopie - holografische Interferometrie - Speckle-Messtechniken - Laufzeittechniken
14. Literatur:	Manuskript der Vorlesung, Pedrotti, F., et al: Optik für Ingenieure. Springer Verlag, Berlin 2007, Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Verlag, München 2014, Malacara, D.: Optical shop testing 2007, Cathey, T.: Optical Information Processing and Holography 1974, Erf, R.: Speckle metrology 1978.
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>337101 Vorlesung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> <li>337102 Übung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33711 Optische Messtechnik und Messverfahren (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 83 von 269

## Modul: 33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien

2. Modulkürzel:	073400002	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zimi	mermann	
9. Dozenten:		Mahdi Soltani André Zimmermann		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		<ul> <li>bildet zusammen mit dem Modul "Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau" den Kern der Ausbildung in der Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik für Mikrosysteme. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Technologien und Fertigungsverfahren bei der Montage von Mikrosystemen.</li> <li>Die Studierenden sollen:</li> <li>die wichtigsten Fertigungsverfahren der Aufbau- und Verbindungstechnik kennen und in Abhängigkeit der Systemerfordernisse zu bewerten lernen,</li> <li>die Eigenschaften der relevanten Werkstoffe und deren Einfluss auf Qualität und Zuverlässigkeit der Mikrosysteme kennenlernen,</li> <li>die wesentlichen technologischen Einflussgrößen der Verfahren kennenlernen,</li> <li>die wichtigsten Merkmale der Fertigungsanlagen kennen und zu bewerten lernen,</li> </ul>		
13. Inhalt:		Einführung in die Aufbau- und Löten und Kleben in der SMD- Gehäusearten und Typen, Chi Drahtbonden, Flip-Chip-Techn Systemträger (Molded Intercor Spritzgießtechnik, Zweikompo laserbasierte MID-Technik, che Kunststoffen, Chip- und SMD-	pmontage mit Die-Bonden, ik, TAB-Bonden, thermoplastische	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 84 von 269

	(Additive Manufacturing in der Elektronik), Fügen und Verbinden von Kunststoffbauteilen mit Kleben und Schweißen. Die jeweiligen Lehrinhalte werden anhand von einschlägigen Beispielen diskutiert und veranschaulicht. Die Lehrinhalte werden durch Übungen vertieft. In einem praktischen Teil wird der Bezug der Lehrinhalte zur industriellen Praxis dargestellt.	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	337601 Vorlesung(inkl. ÜB, Pr, Exkursion) Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33761 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 85 von 269

## 223 Ergänzungsfächer mit 3 LP

Zugeordnete Module: 33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker

33770 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 86 von 269

## Modul: 33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker

2. Modulkürzel:	073400004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	Rainer Mohr		
9. Dozenten:		Rainer Mohr		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		zu vermitteln. Dabei liegt der S	elektronische Schaltungstechnik Schwerpunkt auf Schaltungen der Itechnik: Sensorik, Sensor- u. Bio-	
		Die Studierenden sind in der L - Einfache Schaltungen zu din - Schaltbilder zu lesen und zu - elektrische Messtechnik durc - ein Schaltungssimulationspro	nensionieren verstehen chzuführen	
13. Inhalt:		Sensor- und Bio-Signalverarbe analog), Verstärker, analoge i (Operationsverstärker), Oszilla	ntegrierte Schaltungen atoren, Stromversorgungen, analoge Schaltungsbeispiele, Übungen mit	
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Literatur zu den einzelnen Kapiteln (Literaturverzeichnis im Manuskript)		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>334501 Vorlesung (inkl. Elektronikpraktikum) Elektronik für Mikrosystemtechniker</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33451 Elektronik für Mikrosys Mündlich, 20 Min., Ge	stemtechniker (BSL), Schriftlich oder wichtung: 1	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Beamerpräsentation, Overhea	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel	
20. Angeboten von:		Mikrosystemtechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 87 von 269

## Modul: 33770 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II

2. Modulkürzel:	072420004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann	Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Technologien der Nano- und	Mikrosystemtechnik I	
12. Lernziele:		Im Modul Technologien der N	ano- und Mikrosystemtechnik II	
		Bulkmikromechanik sowie of Verfahren zur Herstellung v Mikrosystemtechnik vertiefe können die Studierenden die	e Technologien der Oberflächen- und die Röntgenlithographie und das LIGA von Bauelementen der Nano- und end kennen gelernt, ie Prozessverfahren bewerten und bläufe selbstständig zu entwerfen.	
		Erworbene Kompetenzen:		
		Die Studierenden		
		sowie die Röntgenlithograp benennen und mit Hilfe phy erläutern,  • beherrschen die wesentlich Vorgehens zur Herstellung auf der Basis der oben gen.  • haben ein Gefühl für den Alentwickeln können,  • sind mit den technologische und können diese bewerter.  • sind in der Lage, auf der Ba	ufwand der einzelnen Verfahren en Grenzen der Verfahren vertraut n, asis gegebener technologischer edingungen einen kompletten ung von mikrotechnischen	
13. Inhalt:		um die spezifischen Prozessa modernen Bauelementen der Nach einer kurzen Einführung Oberflächenmikromechanik ( (BMM), die Röntgenlitho-grap	Mikrosystemtechnik zu verstehen. g in die Thematik werden die OMM), die Bulkmikromechanik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 88 von 269

	technologischen Prozessen vermittelt. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente der Nano- und Mikrosystemtechnik, wie z.B. Druck-, Beschleunigungssensoren und das Digital Mirror Device (DMD) hergestellt werden können.
14. Literatur:	<ul> <li>- Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>- Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>- Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>- Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg,2006</li> <li>- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> <li>Online-Vorlesungen:</li> <li>- http://www.esnsedu.com</li> <li>- http://www.ett.bme.hu/memsedu</li> <li>Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	337701 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33771 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 89 von 269

## Modul: 33290 Praktikum Mikroelektronikfertigung

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Joachim B	urghartz	
9. Dozenten:				
10. Zuordnung zum Co Studiengang:	urriculum in diesem	Optik, PO 961-2011, 3. Semes	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 3. Semester  → Elektronikfertigung> Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		Die Studierenden lernen theor anzuwenden und in der Praxis		
13. Inhalt:		Nähere Informationen zu den Praktischen Übungen: APMB erhalten Sie zudem unter http://www.uni-stuttgart.de/mabau/msc/msc_mach/linksunddownloads.html Praktische Beispiele und Teilschritte der Halbleiterfertigung in einer modernen CMOSProzesslinie vom Wafersubstrat bis zum aufgebauten Chips.		
14. Literatur:		Präsentationen, Moderation, Praktikumsunterlagen		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>(APMB) 4</li> <li>332901 Spezialisierungsfach</li> <li>332902 Spezialisierungsfach</li> <li>332903 Spezialisierungsfach</li> <li>332904 Spezialisierungsfach</li> <li>332905 Praktische Übungen (APMB) 1</li> <li>332906 Praktische Übungen (APMB) 2</li> </ul>	oversuch 2 oversuch 3	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 30 Stunden Selbststudium: 60 Stunden Gesamt: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33291 Praktikum Mikroelektronikfertigung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 USL. Art und Umfang der USL werden jeweils zu Beginn des Praktikums bekannt gegeben.		
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Umdrucke, elektronische Medien (Powerpoint, Excel, Mindmapping, Eagle, Speq, ,), Demonstrationen und Bedienung von Geräten		
		von Geräten		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 90 von 269

#### 230 Feinwerktechnik

Zugeordnete Module: 231 Kernfächer mit 6 LP

232 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP
233 Ergänzungsfächer mit 3 LP
33780 Praktikum Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 91 von 269

#### 231 Kernfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette,

Simulation

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 92 von 269

## Modul: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Sch	inköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 5. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	setzungen:	Abgeschlossene Grundlagenausk	oildung in Konstruktionslehre
12. Lernziele:		Fähigkeiten zur Analyse und Löst feinwerktechnischen Aufgabenste Berücksichtigung des Gesamtsys Berücksichtigung von Präzision, z Umgebungs- und Toleranzeinflüs und Systemen	ellungen im Gerätebau unter tems, insbesondere unter Zuverlässigkeit, Sicherheit,
13. Inhalt:		Entwicklung und Konstruktion feir Systeme mit Betonung des enger konstruktiver Gestaltung und zuge Methodik der Geräteentwicklung, Lösungsfindung, Genauigkeit und Geräten, Präzisionsgerätetechnik Aufbau genauer Geräte und Masc Toleranzanalyse, Zuverlässigkeit (zuverlässigkeits- und sicherheits Beziehungen zwischen Gerät und in der Gerätetechnik. Beispielhaft	n Zusammenhangs zwischen ehöriger Fertigungstechnologie. Ansätze zur kreativen I Fehlerverhalten in (Anforderungen und chinen), Toleranzrechnung, und Sicherheit von Geräten gerechte Konstruktion), I Umwelt, Lärmminderung

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 93 von 269

	Übungen und in den Praktika "Einführung in die 3D-Messtechnik", "Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests"	
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Grundlagen der Feinwerktechnik - Konstruktion und Fertigung. Skript zur Vorlesung</li> <li>Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. München Wien: Carl Hanser 2000</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>139701 Vorlesung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik, 3 SWS</li> <li>139702 Übung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (inklusive Praktikum, Einführung in die 3D-Meßtechnik, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests), 1,0 SWS (2x1,5 h)</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13971 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (PL) Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	<ul><li>Tafel</li><li>OHP</li><li>Beamer</li></ul>	
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 94 von 269

## Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 2: Gerätekonstru Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Zusatzmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> I Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> I Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer/Ergänzungsf Medizingerätekonstruktion	chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster chnik, Gerätetechnik und Technische ster chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Technische Optik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Elektronikfertigung> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Elektronikfertigung> chnik, Gerätetechnik und Technische ster Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster seinwerktechnik> chnik sein mit 6 LP> chnik sein mit
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		<ul> <li>-technologie (Werkstoffe, Verf- Magnetisierung). Die Studiere Antriebe (rotatorische und line berechnen, gestalten und ausl können elektrodynamische An</li> </ul>	ntriebe (rotatorische und lineare ereinfacht berechnen, gestalten en kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerp	(Werkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 95 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 96 von 269

# Modul: 33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation

2. Modulkürzel:	072510004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt;</li></ul>		
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor	
12. Lernziele:			verktechnik auswählen. Sie vurf von Spritzgussteilen und Gerätetechnik. Die Studierenden Simulationsprogrammen für die	
13. Inhalt:		Kunststoffspritzguss, Aufbau e Spritzgießprozess, Sondervert Gestaltung von Kunststoffsprit Spritzgießwerkzeugen, rheolo Werkzeug, Berechnung und S	rbeitung der Polymerwerkstoffe, einer Spritzgießmaschine, fahren beim Kunststoffspritzguss,	
14. Literatur:		<ul> <li>Burkard, E.: Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation. Skript zur Vorlesung</li> <li>Jaroschek, Ch.: Spritzgießen für Praktiker. München: Carl Hanser 2008</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	n und -formen:	332601 Vorlesung + Übung Gerätetechnik; Verfahren, Pı	Praxis des Spritzgießens in der rozesskette, Simulation	
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 97 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	33261 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation,PC
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 98 von 269

#### 232 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette,

Simulation

33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 99 von 269

## Modul: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

2. Modulkürzel:	073400001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zim	mermann
9. Dozenten:		André Zimmermann Eugen Ermantraut	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Technische Optik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik> Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung> Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Die Studierenden sind in der L Konstruktion und Fertigung vo	Grundlagen der Konstruktion ischen Bauteilen und Systemen. age, die Besonderheiten der n mikrotechnischen Bauteilen und cklung und Produktion zu erkennen
13. Inhalt:		<ul> <li>CVD-Technik, Thermische (</li> <li>Lithographie und Maskenter</li> <li>Ätztechniken zur Strukturier IE, Plasmaätzen)</li> <li>Reinraumtechnik</li> </ul>	chnik ten dünner Schichten (PVD- und Oxidation) chnik ung (Nasschemisches Ätzen, RIE,

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 100 von 269

	<ul> <li>Mikrotechnische Bauteile aus Kunststoff (z.B. Mikrospritzguss)</li> <li>Mikrobearbeitung von Metallen (z.B. spanende Mikrobearbeitung)</li> <li>Messmethoden der Mikrotechnik</li> <li>Prozessketten der Mikrotechnik</li> </ul>	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>135401 Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> <li>135402 Freiwillige Übung zur Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13541 Grundlagen der Mikrotechnik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overhead-Projektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 101 von 269

## Modul: 13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

-			
2. Modulkürzel:	072420001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. DrIng. Hermann Sa	indmaier
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		<ul> <li>Im Modul Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I</li> <li>haben die Studierenden die wichtigsten Technologien und Verfahren zur Herstellung von Bauelementen der Mikroelektronik als auch der Nano- und Mikrosystemtechnik kennen gelernt,</li> <li>können die Studierenden einzelne technologische Prozesse bewerten und sind in der Lage Prozessabläufe selbstständig zu entwerfen.</li> <li>Erworbene Kompetenzen:</li> <li>Die Studierenden</li> <li>können die wichtigsten Materialien der Nano- und Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben,</li> <li>können die wichtigsten Verfahren der Mikroelektronik sowie derNano- und Mikrosystemtechnik benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Herstellung von mikrotechnischen Bauelementen,</li> <li>haben ein Gefühl für den Aufwand einzelner Verfahren entwickeln können,</li> <li>sind mit den technologischen Grenzen der Verfahren vertraut und können diese bewerten,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technologischer und wirtschaftlicher Randbedingungen, die optimalen Prozessverfahren auszuwählen und einen kompletten</li> </ul>	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 102 von 269

18. Grundlage für :	
	Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
17. Prüfungsnummer/n und -name:	Gesamt: 180 h  13561 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I (PL),
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	135601 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I
	<ul> <li>http://www.ett.bme.hu/memsedu</li> <li>Lernmaterialien:</li> <li>Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS</li> </ul>
	Online-Vorlesungen: • http://www.sensedu.com
14. Literatur:	<ul> <li>Korvink, J. G., Paul O., MEMS - A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006</li> <li>Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg, 2006</li> <li>Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> </ul>
13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt den Studierenden die Grundlagen, um die komplexen Prozessabläufe bei der Herstellung von modernen Bauelementen der Mikroelektronik sowieder Nano- und Mikrosystemtechnik zu verstehen. Nach einer Einführung in die Thematik werden zunächst die wichtigsten Materialien - insbesondere Silizium - vorgestellt. Anschließend werdendie bedeutendsten Prozesse zur Herstellung von mikroelektronischen und mikrosystemtechnischen Bauelementen und Systemen behandelt. Insbesondere werden die Grundlagenzur Dünnschichttechnik, zur Lithographie und zu den Ätzverfahren vermittelt. Abschließend werden als Vertiefung die Prozessabläufe der Oberflächen- und Bulkmikromechanik kurz vorgestellt und erläutert. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente, wie elektronische Schaltungen oder Mikrosysteme, hergestellt werden können.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 103 von 269

## Modul: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>     Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Medizingerätekonstruktion>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 5. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP>     Medizingerätekonstruktion> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>     Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre	
12. Lernziele:		Fähigkeiten zur Analyse und Löst feinwerktechnischen Aufgabenste Berücksichtigung des Gesamtsys Berücksichtigung von Präzision, Z Umgebungs- und Toleranzeinflüs- und Systemen	ellungen im Gerätebau unter tems, insbesondere unter Zuverlässigkeit, Sicherheit,
13. Inhalt:		Entwicklung und Konstruktion feir Systeme mit Betonung des enger konstruktiver Gestaltung und zuge Methodik der Geräteentwicklung, Lösungsfindung, Genauigkeit und Geräten, Präzisionsgerätetechnik Aufbau genauer Geräte und Masc Toleranzanalyse, Zuverlässigkeit (zuverlässigkeits- und sicherheits Beziehungen zwischen Gerät und in der Gerätetechnik. Beispielhaft	n Zusammenhangs zwischen ehöriger Fertigungstechnologie. Ansätze zur kreativen I Fehlerverhalten in (Anforderungen und chinen), Toleranzrechnung, und Sicherheit von Geräten gerechte Konstruktion), I Umwelt, Lärmminderung

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 104 von 269

	Übungen und in den Praktika "Einführung in die 3D-Messtechnik", "Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests"	
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Grundlagen der Feinwerktechnik - Konstruktion und Fertigung. Skript zur Vorlesung</li> <li>Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. München Wien: Carl Hanser 2000</li> </ul>	
<ul> <li>15. Lehrveranstaltungen und -formen:         <ul> <li>139701 Vorlesung Gerätekonstruktion und -fertigung Feinwerktechnik, 3 SWS</li> <li>139702 Übung Gerätekonstruktion und -fertigung in d Feinwerktechnik (inklusive Praktikum, Einführung in d 3D-Meßtechnik, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests), 1,0 SWS (2x1,5 h)</li> </ul> </li> </ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13971 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (PL) Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	form:  • Tafel • OHP • Beamer	
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 105 von 269

## Modul: 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Joachim Burghartz	
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Technische Optik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester  → Gruppe 4: Spezifische Anwendungen> Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung> Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	V/Ü Grundlagen der Mikroelekt	tronikfertigung (Empfehlung)
12. Lernziele:		Vermittlung weiterführender Kenntnisse der wichtigsten Technologien und Techniken in der Elektronikfertigung	
13. Inhalt:		Die Vorlesung bietet eine fundierte und praxisbezogene Einführung in die Herstellung von Mikrochips und die besonderen Aspekte beim Test mikroelektronischer Schaltungen sowie dem Verpacken der Chips in IC-Gehäuse.  Grundlagen der Mikroelektronik Lithografieverfahren Wafer-Prozesse CMOS-Gesamtprozesse Packaging und Test Qualität und Zuverlässigkeit	
14. Literatur:		2002	·

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 106 von 269

	<ul> <li>L.E. Glasser and D.W. Dobberpuhl: The Design and Aanalysis of VLSI Circuits, Addison Wesley.</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	322501 Vorlesung und Übung Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (Blockveranstaltung)	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32251 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 oder bei geringer Anzahl Studierender: mündlich, 40 min.	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	PowerPoint	
20. Angeboten von:	Mikroelektronik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 107 von 269

## Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagenaus	sbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		Die Studierenden kennen die Gr- technologie (Werkstoffe, Verfah Magnetisierung). Die Studierend Antriebe (rotatorische und linear berechnen, gestalten und ausleg können elektrodynamische Antri Gleichstromkleinstmotoren) vere und auslegen. Die Studierenden magnetostriktive und andere unk	en können elektromagnetische e Schrittmotoren) vereinfacht gen. Die Studierenden ebe (rotatorische und lineare sinfacht berechnen, gestalten kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerpun	nische Antriebe unterschiedlicher kten: Verkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 108 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 109 von 269

# Modul: 33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation

2. Modulkürzel:	072510004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt;</li></ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor	
12. Lernziele:  Die Studierenden können Material und Fertigungsverfür Kunststoffteile in der Feinwerktechnik auswähler haben die Fähigkeit zum Entwurf von Spritzgussteile Spritzgießwerkzeugen für die Gerätetechnik. Die Stubeherrschen den Einsatz von Simulationsprogramm Kunststoffspritzgusssimulation.		verktechnik auswählen. Sie vurf von Spritzgussteilen und Gerätetechnik. Die Studierenden Simulationsprogrammen für die		
13. Inhalt:		Einteilung der Polymerwerkstoffe, charakteristische Werkstoffeigenschaften, Verarbeitung der Polymerwerkstoffe, Kunststoffspritzguss, Aufbau einer Spritzgießmaschine, Spritzgießprozess, Sonderverfahren beim Kunststoffspritzguss, Gestaltung von Kunststoffspritzgussteilen, Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen, rheologische Auslegung von Teil und Werkzeug, Berechnung und Simulation des Spritzgießprozesses, Einsatz von Simulationsprogrammen. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen.		
14. Literatur:		<ul> <li>Burkard, E.: Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation. Skript zur Vorlesung</li> <li>Jaroschek, Ch.: Spritzgießen für Praktiker. München: Carl Hanser 2008</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>332601 Vorlesung + Übung Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik; Verfahren, Prozesskette, Simulation</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 110 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	33261 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation,PC
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 111 von 269

## Modul: 33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

2. Modulkürzel:	073100002	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester		
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oster	١		
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Klaus Körner Erich Steinbeißer	Klaus Körner		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> T Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 3: Optische Tech Fertigungstechnologien - M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011, 1. Semes	mit 6 LP> Technische Optik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster Technische Optik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster nologien / Optische -> Vertiefungsmodule hnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Elektronikfertigung> hnik, Gerätetechnik und Technische		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		<ul> <li>verstehen die Unterschiede zwischen wellenoptischer und geometrisch-optischer Beschreibung,</li> <li>sind in der Lage, die in Wellenfeldern enthaltene Information zu beschreiben,</li> <li>können Messungen kritisch mittels Fehleranalyse bewerten,</li> <li>kennen die Rolle und Wirkungsweise der wichtigsten Komponenten und sind in der Lage, optische Mess-Systeme au einzelnen Komponenten zusammenzustellen und zu bewerten,</li> <li>sind in der Lage, Methoden zur Vermessung von optischen und technischen Oberflächen sowie deren Oberflächenveränderungen zielgerichtet einzusetzen.</li> </ul>			
13. Inhalt:		Grundlagen der geometrisch - optische Komponenten - optische Systeme Grundlagen der Wellenoptik: - Wellentypen - Interferenz und Kohärenz			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 112 von 269

	- Beugung und Auflösungsvermögen Holografie Speckle Klassifikation und Charakterisierung von Oberflächen Messfehler Grundprinzipien und Klassifikation optischer Messtechniken Messmethoden auf Basis der geometrischen Optik: - Strukturierte Beleuchtung - Moire - Messmikroskope und Messfernrohre Messmethoden auf Basis der Wellenoptik: - interferometrische Messtechniken - Interferenzmikroskopie - holografische Interferometrie - Speckle-Messtechniken - Laufzeittechniken
14. Literatur:	Manuskript der Vorlesung, Pedrotti, F., et al: Optik für Ingenieure. Springer Verlag, Berlin 2007, Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Verlag, München 2014, Malacara, D.: Optical shop testing 2007, Cathey, T.: Optical Information Processing and Holography 1974, Erf, R.: Speckle metrology 1978.
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>337101 Vorlesung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> <li>337102 Übung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33711 Optische Messtechnik und Messverfahren (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 113 von 269

### 233 Ergänzungsfächer mit 3 LP

Zugeordnete Module: 32880 Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik

33280 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL

33300 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik

33310 Elektronik für Feinwerktechniker 33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 114 von 269

# Modul: 32880 Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	073400005	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	Rainer Mohr		
9. Dozenten:		Rainer Mohr		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Seme  → Ergänzungsfächer mit 3  Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikroted  Optik, PO 961-2011, 1. Seme	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ıssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		Bauelemente, insbesondere f	izintechnik, z.B. als sensorische ermitteln. Es werden verteilte	
		Die Studierenden sind in der I	Lage	
		<ul> <li>Elektronische Bauelemente den gedachten Anwendung auszusuchen.</li> <li>Ersatzschaltbilder für Bauel</li> <li>elektrische Messtechnik du</li> <li>ein Schaltungssimulationsp</li> </ul>	szweck geeignetes Bauelement lemente zu erstellen rchzuführen	
13. Inhalt:		Halbleiter (Diode, Bipolare Tra Ladungsverschiebungseleme Parasitäre Eigenschaften bei	rstände, Kondensatoren, Spulen, ansistoren, Feldeffekttransistoren), nte (CCD), Elektronische Speicher, elektronischen Bauelementen, e (Quarz, Piezokeramik), Organische	
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Datenblätter und Anwendungsbeispiele von Herstellern (Application Notes), Literatur zu den einzelnen Kapiteln (Literaturverzeichnis im Manuskript).		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		328801 Vorlesung (inkl. Übungen und Schaltungssimulation) Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik		
15. Lehrveranstaltung				
<ul><li>15. Lehrveranstaltung</li><li>16. Abschätzung Arbe</li></ul>	itsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		
		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden 32881 Elektronische Bauelei	mente in der Mikrosystemtechnik (BSL) lich, 20 Min., Gewichtung: 1	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 115 von 269

19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 116 von 269

### Modul: 33280 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL

2. Modulkürzel:	072510005	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	ausbildung in einem Bachelor
ANSYS u		Die Studierenden haben die F ANSYS und MAXWELL für Si Art einzusetzen.	Fähigkeit die FEM-Programme mulationsaufgaben verschiedenster
ANSYS und MAXWELL z Aufgaben, thermischen P (Lineardirektantriebe und		Aufgaben, thermischen Proble	erechnung von Strukturmechanik- emen, Magnetfeldern und Antrieben coelektrische Antriebe). Beispielhafte
14. Literatur:		<ul> <li>Schinköthe, W., Ulmer, M., Joerges, P., Zülch, M.: Praktisch FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schätzing, W.: FEM für Praktiker - Band 4: Elektrotechnik. Renningen: expertVerlag 2009</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	<ul> <li>332801 Vorlesung und Übung Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden	
17. Prüfungsnummer/r	und -name:	33281 Praktische FEM-Simu Mündlich, 20 Min., Ge	ulation mit ANSYS und MAXWELL (BSL)
18. Grundlage für :			
19. Medienform:		am PC, Beamer-Präsentation,	
20. Angeboten von:		Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 117 von 269

### Modul: 33300 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510008	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	PD DrIng. Hubert Effenber	ger	
9. Dozenten:		Hubert Effenberger		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagenausbildung in einem Bachelor		
12. Lernziele:  Die Studierenden kennen diskrete und integrierte, and digitale Bauelemente und haben die Fähigkeiten zur panahen der Feinwerktechnik.		aben die Fähigkeiten zur praktischen		
13. Inhalt:  Halbleiterbauelemente (diskrete und integrierte, analog und digitale Bauelemente, Sensoren, Wandler), Dioder Transistoren, Thyristoren, Triac, Fotoelemente, Fotodie Lumineszenzdioden, Optokoppler, temperaturabhängig Bauelemente, Mikroprozessortechnik.		Sensoren, Wandler), Dioden, riac, Fotoelemente, Fotodioden, oppler, temperaturabhängige		
14. Literatur:		<ul> <li>Effenberger, H.: Umdrucke zur Vorlesung</li> <li>Tietze, U, Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik. Berli Springer 2002</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 333001 Vorlesung Elektris	che Bauelemente in der Feinwerktechnil	
16. Abschätzung Arbe	6. Abschätzung Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33301 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1		
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation		
20. Angeboten von:		Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 118 von 269

### Modul: 33310 Elektronik für Feinwerktechniker

2. Modulkürzel:	072510007		5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP		6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	2		7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	PD Dr	Ing. Hubert Effenberger	
9. Dozenten:		Hubert	Effenberger	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	Abgesc	hlossene Grundlagenaus	bildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		und Dig	italtechnik. Sie kennen in S-Technik und haben die	undschaltungen der Analog- tegrierte Schaltkreise in Bipolar- e Fähigkeiten zur praktischen
Anwendungsbe Operationsvers		dungsbeispiele integrierte onsverstärker, A/DWandl er) in Bipolar- und MOS-T	nd Digitaltechnik, Sensoren, r Schaltkreise (z. B. er, logische Schaltungen, echnik, Einführung in die	
14. Literatur:		<ul> <li>Tietze</li> </ul>	berger, H.: Umdrucke zui e, U, Schenk, Ch.: Halble ger 2002	· Vorlesung iter-Schaltungstechnik. Berlin:
15. Lehrveranstaltunge	n und -formen:	• 33310	1 Vorlesung Elektronik fü	r Feinwerktechniker
16. Abschätzung Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden				
17. Prüfungsnummer/n	und -name:	33311	Elektronik für Feinwerkte Gewichtung: 1	chniker (BSL), Mündlich, 20 Min.,
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Tafel, C	verhead-Projektor, Beam	ner-Präsentation
20. Angeboten von:		Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik		r Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 119 von 269

# Modul: 33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker

2. Modulkürzel:	073400004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	Rainer Mohr		
9. Dozenten:		Rainer Mohr		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		zu vermitteln. Dabei liegt der S	elektronische Schaltungstechnik Schwerpunkt auf Schaltungen der Itechnik: Sensorik, Sensor- u. Bio-	
		Die Studierenden sind in der L - Einfache Schaltungen zu din - Schaltbilder zu lesen und zu - elektrische Messtechnik durc - ein Schaltungssimulationspro	nensionieren verstehen chzuführen	
13. Inhalt:		Sensor- und Bio-Signalverarbe analog), Verstärker, analoge i (Operationsverstärker), Oszilla	ntegrierte Schaltungen atoren, Stromversorgungen, analoge Schaltungsbeispiele, Übungen mit	
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Lite (Literaturverzeichnis im Manus	eratur zu den einzelnen Kapiteln skript)	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	<ul> <li>334501 Vorlesung (inkl. Elektronikpraktikum) Elektronik für Mikrosystemtechniker</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	33451 Elektronik für Mikrosystemtechniker (BSL), Schriftlich o Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1		
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel		
20. Angeboten von:		Mikrosystemtechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 120 von 269

### Modul: 33780 Praktikum Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510006	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 3. Semes → Feinwerktechnik> Spe		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	susbildung in einem Bachelor	
12. Lernziele:		Versuchsanlagen der Feinwer	schiedene Geräte, Software und ktechnik praktisch nutzen. Sie eoretischer Vorlesungsinhalte in der	
		Nähere Informationen zu den Praktischen Übungen: APMB erhalten Sie zudem unter http://www.uni-stuttgart.de/mabau/msc/msc_mach/ linksunddownloads.html  • Beispiel Gleichstrommotoren: Die Studierenden kennen die Grundlagen von DC- und EC-Motoren. Die Studierenden können Kennlinien von DC- und EC-Motoren mit statischen und modernen dynamischen Verfahren messen und beherrschen die Messtechnik dazu. Die Studierenden können Kennlinien von DC- und EC-Motoren analysieren und bewerten.  • Beispiel Schrittmotoren: Die Studierenden kennen Aufbau, Funktion und Bewegungsverhalten von Schrittmotoren einschließlich deren Ansteuerung. Die Studierenden können Ansteuerungen und somit das Bewegungsverhalten von Schrittmotoren programmieren und Positioniersysteme damit realisieren.		
14. Literatur:		Praktikums-Unterlagen		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>337805 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbar (APMB) 1</li> <li>337806 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbar (APMB) 2</li> <li>337808 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbar (APMB) 4</li> <li>337807 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbar (APMB) 3</li> <li>337803 Spezialisierungsfachversuch 3</li> <li>337802 Spezialisierungsfachversuch 2</li> <li>337801 Spezialisierungsfachversuch 1</li> <li>337804 Spezialisierungsfachversuch 4</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 30 Stunden Selbststudium/Nacharbeit: 60 Stunden Summe: 90 Stunden		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 121 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	33781 Praktikum Feinwerktechnik (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	am Versuchsstand
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 122 von 269

## 240 Laser in der Materialbearbeitung

Zugeordnete Module: 241 Kernfächer mit 6 LP

242 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP
243 Ergänzungsfächer mit 3 LP
33800 Praktikum Lasertechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 123 von 269

#### 241 Kernfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module:

14140 Materialbearbeitung mit Lasern29990 Grundlagen der Laserstrahlquellen

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 124 von 269

# Modul: 14140 Materialbearbeitung mit Lasern

2. Modulkürzel:	073010001	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester		
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Thomas Gra	f		
9. Dozenten:		Thomas Graf			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Vorau	ıssetzungen:	Schulkenntnisse in Mathem	atik und Physik.		
12. Lernziele:		Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Strahlwerkzeuges Laser insbesondere beim Schweißen, Schneiden, Bohren, Strukturieren, Oberflächenveredeln und Urformen kennen und verstehen. Wissen, welche Strahl-, Material- und Umgebungseigenschaften sich wie auf die Prozesse auswirken. Bearbeitungsprozesse bezüglich Qualität und Effizienz bewerten und verbessern können.			
13. Inhalt:		<ul> <li>Komponenten und Syster Strahlführung, Werkstück</li> <li>Wechselwirkung Laserstr</li> <li>physikalische und techno Schneiden, Bohren und A</li> </ul>	Polarisation, etc.) auf die Fertigung, me zur Strahlformung und chandhabung, cahl-Werkstück logische Grundlagen zum Abtragen, Schweißen und Prozeßkontrolle, Sicherheitsaspekte,		
14. Literatur:		<ul> <li>Buch: Helmut Hügel und Thomas Graf, Laser in der Fertigung, Springer Vieweg(2014), ISBN 978-3-8348-1817-1</li> </ul>			
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		141401 Vorlesung mit integrierter Übung Materialbearbeitung mi Lasern			
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 42h + Nacharb	Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitszeit: 138h = 180h		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	14141 Materialbearbeitung mit Lasern (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 125 von 269

20. Angeboten von:

Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 126 von 269

# Modul: 29990 Grundlagen der Laserstrahlquellen

2. Modulkürzel:	073000002	5. Moduldaue	r: Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus: Wintersemester			
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Thomas	Graf		
9. Dozenten:		Thomas Graf			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1.  → Kern-/Ergänzungs Materialbearbeitur M.Sc. Maschinenbau M Optik, PO 961-2011, 2.	sfächer mit 6 LP> Laser in der ng> Spezialisierungsmodule likrotechnik, Gerätetechnik und Technische Semester LP> Laser in der Materialbearbeitung>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		Anregung, stimulierte E Strahlausbreitung und o verstehen. Wissen, weld Eigenschaften des Lase sich wie auf die erzeugt auswirken. Laserkonzep Wirkungsgrad und Strah	Das Prinzip der Laserstrahlerzeugung, insbesondere die Anregung, stimulierte Emission, Strahlausbreitung und optische Resonatoren kennen und verstehen. Wissen, welche Eigenschaften des Laseraktiven Mediums und des Resonators sich wie auf die erzeugte Strahlung auswirken. Laserkonzepte bezüglich Leistungsdaten, Wirkungsgrad und Strahlqualität bewerten und verbessern können.		
13. Inhalt:	Physikalische Grundlagen der Strahlausbreitung, Stra und Strahlverstärkung laseraktives Medium, Inversionserzeugung, Wechselw Strahlung mit dem laseraktives Medium (Ratengleichungen) Laser als Verstärker und Oszillator, Güteschaltung, Modenkopplung, Resonatoren technologische Aspekte, insbesondere CO2-, Nd:YAG		atengleichungen) d Oszillator, Güteschaltung, natoren e, insbesondere CO2-, Nd:YAG- Yb:YAG-,		
14. Literatur:		Buch: Graf Thomas, "Laser - Grundlagen der Laserstrahlerzeugung", Springer Vieweg 2015, ISBN:978-3-658-07953-6			
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 299901 Vorlesung (mi Laserstrahlquellen	it integrierten Übungen) Grundlagen der		
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunder Selbststudium: 138 Stur Summe: 180 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		29991 Grundlagen der Gewichtung: 1	Laserstrahlquellen (PL), Schriftlich, 120 Min.		
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					
20. Angeboten von:		Strahlwerkzeuge			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 127 von 269

## 242 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 14140 Materialbearbeitung mit Lasern

29990 Grundlagen der Laserstrahlquellen

33420 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 128 von 269

# Modul: 14140 Materialbearbeitung mit Lasern

2. Modulkürzel:	073010001	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester		
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Thomas Graf	:		
9. Dozenten:		Thomas Graf			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Vorau	issetzungen:	Schulkenntnisse in Mathema	atik und Physik.		
12. Lernziele:		Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Strahlwerkzeuges Laser insbesondere beim Schweißen, Schneiden, Bohren, Strukturieren, Oberflächenveredeln und Urformen kennen und verstehen. Wissen, welche Strahl-, Material- und Umgebungseigenschaften sich wie auf die Prozesse auswirken. Bearbeitungsprozesse bezüglich Qualität und Effizienz bewerten und verbessern können.			
13. Inhalt:		<ul> <li>Komponenten und Systen Strahlführung, Werkstückl</li> <li>Wechselwirkung Laserstra</li> <li>physikalische und technol Schneiden, Bohren und A</li> </ul>	Polarisation, etc.) auf die Fertigung, ne zur Strahlformung und handhabung, ahl-Werkstück ogische Grundlagen zum btragen, Schweißen und rozeßkontrolle, Sicherheitsaspekte,		
14. Literatur:		<ul> <li>Buch: Helmut Hügel und Thomas Graf, Laser in der Fertigung, Springer Vieweg(2014), ISBN 978-3-8348-1817-1</li> </ul>			
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		• 141401 Vorlesung mit integrierter Übung Materialbearbeitung mit Lasern			
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitszeit: 138h = 180h			
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	14141 Materialbearbeitung mit Lasern (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 129 von 269

20. Angeboten von:

Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 130 von 269

# Modul: 29990 Grundlagen der Laserstrahlquellen

2. Modulkürzel:	073000002	5. Moduldaue	r: Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus: Wintersemester			
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Thomas	Graf		
9. Dozenten:		Thomas Graf			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1.  → Kern-/Ergänzungs Materialbearbeitur M.Sc. Maschinenbau M Optik, PO 961-2011, 2.	sfächer mit 6 LP> Laser in der ng> Spezialisierungsmodule likrotechnik, Gerätetechnik und Technische Semester LP> Laser in der Materialbearbeitung>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		Anregung, stimulierte E Strahlausbreitung und o verstehen. Wissen, weld Eigenschaften des Lase sich wie auf die erzeugt auswirken. Laserkonzep Wirkungsgrad und Strah	Das Prinzip der Laserstrahlerzeugung, insbesondere die Anregung, stimulierte Emission, Strahlausbreitung und optische Resonatoren kennen und verstehen. Wissen, welche Eigenschaften des Laseraktiven Mediums und des Resonators sich wie auf die erzeugte Strahlung auswirken. Laserkonzepte bezüglich Leistungsdaten, Wirkungsgrad und Strahlqualität bewerten und verbessern können.		
13. Inhalt:	Physikalische Grundlagen der Strahlausbreitung, Stra und Strahlverstärkung laseraktives Medium, Inversionserzeugung, Wechselw Strahlung mit dem laseraktives Medium (Ratengleichungen) Laser als Verstärker und Oszillator, Güteschaltung, Modenkopplung, Resonatoren technologische Aspekte, insbesondere CO2-, Nd:YAG		atengleichungen) d Oszillator, Güteschaltung, natoren e, insbesondere CO2-, Nd:YAG- Yb:YAG-,		
14. Literatur:		Buch: Graf Thomas, "Laser - Grundlagen der Laserstrahlerzeugung", Springer Vieweg 2015, ISBN:978-3-658-07953-6			
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 299901 Vorlesung (mi Laserstrahlquellen	it integrierten Übungen) Grundlagen der		
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunder Selbststudium: 138 Stur Summe: 180 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		29991 Grundlagen der Gewichtung: 1	Laserstrahlquellen (PL), Schriftlich, 120 Min.		
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					
20. Angeboten von:		Strahlwerkzeuge			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 131 von 269

# Modul: 33420 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung

2. Modulkürzel:	073000003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Thomas Graf		
9. Dozenten:		Rudolf Weber Andreas Letsch		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:			
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Voraussetzungen für sinnvolle und effiziente Laser-Anwendungen in der Materialbearbeitung kennen und verstehen.</li> <li>Begreifen der für den Anlagenbau entscheidendenLaserprozessgrößen.</li> <li>Wissen wie diese durch geeignete Auslegung der Anlagen erfüllt werden können.</li> <li>Anlagen bezüglich technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten und verbessern können.</li> </ul>		
13. Inhalt:		<ul> <li>Die wichtigsten Anwendungen des Lasers in der Materialbearbeitung</li> <li>Anlagenkonzepte vom Roboterschweißen bis zur Laserfusion</li> <li>Auslegung der Anlage von den mechanische Komponenten und Strahlführungssystemen bis zur Achsendynamik</li> <li>Peripherie von der Steuerung bis zu Sicherheitsaspekten</li> <li>Kommerzielle Aspekte von der Stückkostenrechnung bis zur Anlagenamortisation</li> </ul>		
14. Literatur:		Folien der Vorlesungen		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>334201 Vorlesung Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung Teil I: von der Anwendung zur Anlage</li> <li>334202 Vorlesung Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung Teil II: von der Anlage zum Betrieb</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden		
17. Prüfungsnummer/n und -name:		<ul> <li>33421 Anlagetechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von de Anwendung zur Anlage (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung 1</li> <li>33422 Anlagetechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil II: von de Anlage zum Betrieb (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1 Die Prüfung des Moduls Anlagentechnik für laserbasierte Fertigungbesteht aus den zwei Teilprüfungen [33421] Teil I: von der Anwendung zur Anlage, Gewichtung 0,5</li> </ul>		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 132 von 269

	Nach Möglichkeit werden die beiden Teilprüfungen am selben Termin durchgeführt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 133 von 269

#### 243 Ergänzungsfächer mit 3 LP

Zugeordnete Module: 29980 Einführung in das Optik-Design

32110 Thermokinetische Beschichtungsverfahren

32740 Physikalische Prozesse der Lasermaterialbearbeitung

32760 Diodenlaser 36120 Scheibenlaser

46900 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von der Anwendung zur

Anlage

46910 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil II: von der Anlage zum

**Betrieb** 

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 134 von 269

# Modul: 29980 Einführung in das Optik-Design

2. Modulkürzel: 073100007	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte: 3 LP	6. Turnus: Wintersemester			
4. SWS: 2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlicher:	UnivProf. Dr. Alois Herkomm	ner		
9. Dozenten:	Christoph Menke Alois Herkommer			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Voraussetzungen:	empfohlen: Grundlagen der T	echnischen Optik		
Die Studierenden - kennen die physikalischen Grundlagen der optische und sind mit den Konventionen und Bezeichnungen der geometrischer vertraut - können die Bildgüte von optischen Systemen bewer - kennen die Entstehung und die Auswirkung einzelne Abbildungsfehler - können geeignete Korrektionsmittel zu den einzelne Abbildungsfehler benennen und anwenden - sind in der Lage mit Hilfe des Optik-Design Program (auf bereitgestellten Rechnern) einfache Optiksysteme zu optimieren		ngen der geometrischen Optik ischen Systemen bewerten die Auswirkung einzelner nsmittel zu den einzelnen nd s Optik-Design Programms ZEMAX		
13. Inhalt:	<ul> <li>Grundlagen der geometrischen Optik</li> <li>Geometrische und chromatische Aberrationen (Entstehung, Systematik, Auswirkung, Gegenmaßnahmen)</li> <li>Bewertung der Abbildungsgüte optischer Systeme</li> <li>Verschiedene Typen optischer Systeme (Fotoobjektive, Teleskope, Okulare, Mikroskope, Spiegelsysteme, Zoomsysteme)</li> <li>Systementwicklung (Ansatzfindung, Optimierung, Tolerierung, Konstruktion)</li> </ul>			
14. Literatur:	<ul> <li>Manuskript der Vorlesung</li> <li>Gross: Handbook of optical s</li> <li>Kingslake: Lens Design Fund</li> <li>Smith: Modern Optical Engir</li> <li>Fischer/Tadic-Galeb: Optical</li> <li>Shannon: The Art and Scien</li> </ul>	damentals neering I System Design		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	299801 Vorlesung Einführur	og in das Ontik Dosign		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 135 von 269

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	29981 Einführung in das Optik-Design (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 abhängig von der Zahl der Prüfungsanmeldungen findet eine ca. 20-minütige mündliche Prüfung oder eine 60-minütige schriftliche Prüfung statt	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Powerpoint-Vortrag für Studenten bereitgestellte Notebooks mit Zemax-Optik-Design Programm	
20. Angeboten von:	Optik-Design und Simulation	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 136 von 269

# Modul: 32110 Thermokinetische Beschichtungsverfahren

2. Modulkürzel:	072200005	5. Moduldauer: Einsemestrig			
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus: Wintersemester			
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlicher:		apl. Prof. Dr. Andreas Killinger			
9. Dozenten:		Andreas Killinger			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Ergänzungsfächer mit 3	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorausse	etzungen:	keine			
12. Lernziele:		Die Studenten können: Funktionsprinzipien thermokinetischer Beschichtungsverfahren beschreiben und erklären. verfahrensspezifische Eigenschaften von Schichten auflisten und benennen. Unterschiede der einzelnen Verfahrensvarianten untereinander wiedergeben und gegenüberstellen. Eignung einer bestimmten Verfahrensvariante hinsichtlich vorgegebener Schichteigenschaften beurteilen und begründen. Herstellverfahren für Pulver und Drähte wiedergeben, vergleichen und Beispiele geben. Einfluss der Pulvereigenschaften auf den Prozess vorhersagen und bewerten. Einfluss der Pulvereigenschaften auf die Schichteigenschaften verstehen und ableiten. industrielle Anwendungsfelder im Maschinenbau benennen und wiedergeben.			
13. Inhalt:		<ul> <li>Dieser Modul hat die Grundlagen und Verfahrensvarianten der thermokinetischen Beschichtungsverfahren zum Inhalt. Dabei wird auf Fertigungsund Anlagentechnik, Spritzzusatzwerkstoffe, moderne Online-Diagnoseverfahren, zerstörende und zerstörungsfreie Prüfverfahren für Schichtverbunde eingegangen. Anhand von Beispielen aus der industriellen Praxis wird eine Übersicht über die wichtigsten industriellen Anwendungen und aktuelle Forschungsschwerpunkte gegeben.</li> <li>Stichpunkte:</li> <li>Flammspritzen, Elektrolichtbogendrahtspritzen, Überschallpulverflammspritzen, Suspensionsflammspritzen, Plasmaspritzen.</li> <li>Herstellung und Eigenschaften von Spritzzusatzwerkstoffen.</li> <li>Fertigungs- und Anlagentechnik.</li> <li>Industrielle Anwendungen (Überblick).</li> <li>Grundlagen der Schichtcharakterisierung.</li> </ul>			
14. Literatur:		Skript, Literaturliste	<u> </u>		
15. Lehrveranstaltungen u	und -formen:	• 321101 Vorlesung Thermoki	netische Beschichtungsverfahren		
16. Abschätzung Arbeitsa	ufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 137 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	32111	Thermokinetische Beschichtungsverfahren (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
18. Grundlage für :		
19. Medienform:		
20. Angeboten von:	Fertigu	ngstechnologie keramischer Bauteile

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 138 von 269

## Modul: 32740 Physikalische Prozesse der Lasermaterialbearbeitung

2. Modulkürzel:	073000006	5. Moduldauer: Einsemestrig		Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus: Wintersemester/ Sommersemester			
4. SWS:	2	7. 9	Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. D	r. Thomas Graf		
9. Dozenten:		Peter Berger Thomas Gra			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 96  → Ergänz  Materia  M.Sc. Masch  Optik, PO 96	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		unterschiedli kennen und einzelnen We Verfahrenser	chen Lasermate verstehen. Wiss echselwirkungsr gebnis hat. Moo	en und Modelle der erialbearbeitungsverfahren en welche Bedeutung die mechanismen auf das jeweilige dellierungsansätze für unterschiedliche ewerten und verbessern können.	
13. Inhalt:		Lasermate bohren, -al • Modellieru Wechselwi Wärmeleitu Verdampfu • Anhand za einzelnen	<ul> <li>Beschreibung und Simulation ausgewählter         Lasermaterialbearbeitungsverfahren: Laserstrahlschweißen, -         bohren, -abtragen, -schneiden und - härten.</li> <li>Modellierung der physikalischen Prozesse bei der         Wechselwirkung Laserstrahl/ Werkstück: Absorption,         Wärmeleitung, Schmelzen/Erstarren, Schmelzbadbewegung,         Verdampfung, Plasmaausbildung.</li> <li>Anhand zahlreicher Beispiele wird die Bedeutung der         einzelnen Wechselwirkungsmechanismen für das jeweilige         Verfahrensergebnis erläutert.</li> </ul>		
14. Literatur:		Folien der Vo	orlesungen		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	327401 Vorlesung Physikalische Prozesse der Lasermaterialbearbeitung		lische Prozesse der	
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/r	und -name:	32741 Physikalische Prozesse der Lasermaterialbearbeitung Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					
20. Angeboten von:		Strahlwerkze	1100		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 139 von 269

## Modul: 32760 Diodenlaser

2. Modulkürzel:	073000008	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester		
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Thomas Graf			
9. Dozenten:		Uwe Brauch			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Voraussetzungen:		keine			
12. Lernziele:		Die Grundlagen und Funktionsprinzipien von Diodenlasern kennen und verstehen.			
13. Inhalt:		Halbleiter-Grundlagen (Energieniveaus und deren Besetzung, optische Übergänge, Dotierung, pn-Übergang, Materialaspekte), Aufbau und Eigenschaften der verschiedenen Laserdioden-Bauformen (Kanten- und Vertikalemitter, Leistungsskalierung) und deren technologische Realisierung (Epitaxie, Lithographie, Konfektionierung).			
14. Literatur:		Skript und Folien der Vorlesung			
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		327601 Vorlesung Diodenlaser			
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		32761 Diodenlaser (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					
20. Angeboten von:		Strahlwerkzeuge			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 140 von 269

### Modul: 36120 Scheibenlaser

2. Modulkürzel:	073000088	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortliche	r:	UnivProf. Dr. Thomas Graf		
9. Dozenten:		Uwe Brauch		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraus	setzungen:			
12. Lernziele:		Die Funktionsweise und Einsatz kennen und verstehen. Wissen, Laserkristalle und sonstigen opt und charakterisiert werden. Sch und -verstärker im cw-, Puls- un anwendungsbezogen auslegen	wie die dazu benötigten ischen Komponenten hergestellt eibenlaseroszillatoren d Ultrakurzpulsbetrieb	
13. Inhalt:		Definition, Arten und Anwendungsbereiche von Scheibenlasern. Theoretische Grundlagen, Auslegung, Herstellung und Charakterisierung von Scheibenlasern und deren Komponenten. Optische Komponenten für Scheibenlaser: Scheibenlaserkristalle einschließlich Beschichtungen, Wärmesenke und Montage, Pumplichtanordnungen, Hochleistungs-Laserspiegel, Modulatoren, Verdoppler etc. Auslegung und Anwendungen von Scheibenlaser, oszillatoren und verstärkern im cw-, Puls- und Ultra, kurz, puls, betrieb einschließlich Frequenzkonversion.  Die Funktionsweise und Einsatzbereiche von Scheibenlasern kennen und verstehen. Wissen, wie die dazu benötigten Laserkristalle und sonstigen optischen Komponenten hergestellt und charakterisiert werden. Scheibenlaser, oszillatoren und -verstärker im cw-, Puls- und Ultra, kurz, puls, betrieb anwendungsbezogen auslegen können.		
14. Literatur:		<ul> <li>Folien der Vorlesungen</li> <li>A. Voß: Der Scheibenlaser: Theoretische Grundlagen des Dauerstrichbetriebs und erste experimentelle Ergebnisse anhand von Yb:YAG, Dissertation der Universität Stuttgart, Herbert Utz Verlag.</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		361201 Vorlesung Scheibenlaser		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 28 Stunden Selbststudium: 62 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/n	und -name:	36121 Scheibenlaser (BSL), M	ündlich, 20 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :				

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 141 von 269

4	$\sim$	B 4		•	•		
1	u	1\/	ed	ıan	TΩ	rm	•

20. Angeboten von: Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 142 von 269

# Modul: 46900 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von der Anwendung zur Anlage

2. Modulkürzel:	073000004		5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP		6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	2		7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivPro	of. Dr. Thomas Graf		
9. Dozenten:		Rudolf Weber			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Voraussetzungen für sinnvolle und effiziente Laser-Anwendungen in der Material,bearbeitung kennen und verstehen.</li> <li>Begreifen der für den Anlagenbau entschei,den,den Laserprozessgrößen.</li> <li>Wissen wie diese durch geeignete Auslegung der Anlagen erfüllt werden können.</li> <li>Anlagen bezüglich technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten und verbessern können.</li> </ul>			
13. Inhalt:		<ul> <li>Die wichtigsten Anwendungen des Lasers in der Materialbearbeitung</li> <li>Anlagenkonzepte vom Roboterschweißen bis zur Laserfusion</li> <li>Auslegung der Anlage von den mechanische Komponenten und Strahlführungssystemen bis zur Achsendynamik</li> <li>Peripherie von der Steuerung bis zu Sicherheitsaspekten</li> <li>Kommerzielle Aspekte von der Stückkostenrechnung bis zur Anlagen,amorti,sation</li> </ul>			
14. Literatur:		Folien der Vorlesungen			
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>469001 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von der Anwendung zur Anlage</li> </ul>			
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		V	46901 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil I: von der Anwendung zur Anlage (BSL), Mündlich, 20 M Gewichtung: 1		
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					
20. Angeboten von:		Strahlwe	rkzeuge		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 143 von 269

# Modul: 46910 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil II: von der Anlage zum Betrieb

O Modulleüneni.	072000005	C. Maduldanar			
2. Modulkürzel:	073000005	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester		
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Thomas Graf			
9. Dozenten:		Andreas Letsch			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Voraussetzungen für sinnvolle und effiziente Laser-Anwendungen in der Material,bearbeitung kennen und verstehen.</li> <li>Begreifen der für den Anlagenbau entschei,den,den Laserprozessgrößen und wie diese in der Praxis umgesetzt und überprüft werden.</li> <li>Verständnis zur Auswahl und Spezifikation von geeigneten Systemkomponenten für Laseranlagen</li> <li>Verständnis für Messtechnik zur Bewertung von Laserstrahlung und Einsatz für Regelungssysteme</li> </ul>			
		Gesamtziel: Fähigkeit zur Konzeption und zum Betrieb von Laseranlagen bei hoher Wirtschaftlichkeit			
13. Inhalt:		<ul> <li>Übertragung und Formung des Werkzeugs Laserstrahl von der Quelle bis zum Werkstück</li> <li>Spezifikation und Auslegung der Komponenten</li> <li>An Hand von Beispielen aus der Praxis werden verschiedene Anlagenkonzepte für Anwendungen des Lasers in der Materialbearbeitung diskutiert</li> <li>Normgerechte Vermessung von Laserstrahlung</li> <li>Lasersicherheit</li> </ul>			
14. Literatur:		Folien der Vorlesungen			
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	<ul> <li>469101 Anlagentechnik für die laserbasierte Fertigung - Teil II: der Anlage zum Betrieb</li> </ul>			
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/ı	n und -name:	<u> </u>	e laserbasierte Fertigung - Teil II: von de BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1		
18. Grundlage für:					
10. Grandlage far					
19. Medienform:					

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 144 von 269

### Modul: 33800 Praktikum Lasertechnik

2. Modulkürzel:	073000009		5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP		6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	2		7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	Un	ivProf. Dr. Thomas Graf	
9. Dozenten:			omas Graf dreas Voß	
10. Zuordnung zum Co Studiengang:	urriculum in diesem	Ор	tik, PO 961-2011, 3. Semes	hnik, Gerätetechnik und Technische ster rbeitung> Spezialisierungsmodule
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		such des Spezialisierungsm serstrahlquellen.	noduls Grundlagen der
12. Lernziele:			Studierenden sind in der L zuwenden und in der Praxis	age, theoretische Vorlesungsinhalte umzusetzen.
12. Lernziele:  13. Inhalt:		erh http link	ralten Sie zudem unter o://www.uni-stuttgart.de/maksunddownloads.html ispiele:  Scheibenlaser Zu Beginn des Scheibenlasers justie Mit Hilfe eines Leistungsn Laserschwelle und der dif Durch gezieltes Einfügen werden Resonatormoden aufgenommen.  Laserstrahlpropagation M wird in mehreren Ebenen Lasers gemessen. Um die zu bestimmen, muss nach in mindestens 10 Messeb Messebenen sind im Berebei Positionen größer als Im Rahmen dieses Versudass die oben beschriebe werden kann.  Polarisation Im Rahmen of Polarisationseigenschafte Nach der Charakterisierur von doppelbrechenden M polarisiertes Licht erzeugt die optische Dichte eines Interferometer Zu Beginn aufgebaut, mit dem die Olvermessen wird. Mit einer Ausdehnungskoeffizient vie die Längenänderung eine interferometrisch gemesse wurde	des Versuchs wird der Resonator rt und zum Lasen gebracht. nessgerätes wird dann die ferentielle Wirkungsgrad bestimmt. von Verlusten im Resonator erzeugt und mit einer Kamera it der Messerschneidenmethode der Strahldurchmesser eines HeNes Strahlpropagationseigenschaften ISO 11146 der Strahldurchmesser einen ermittelt werden. Fünf dieser eich der Taille und fünf Messebenen zwei Rayleighlängen aufzunehmen. Ist ein Teleskop so einzurichten, eine Messvorschrift angewendet dieses Versuchs werden die ein eines HeNe- Lasers untersucht. In dieses Lasers wird mit Hilfe aterialien zirkular und elliptisch in Mit Hilfe des Brewstereffekts wird unbekannten Materials bestimmt. Des Versuchs wird ein Interferometer berfläche eines Spiegels meiteren Interferometer wird der in Aluminium bestimmt. Hierzu wird se Aluminiumblocks beim Abkühlen en, der zuvor elektrisch erwärmt

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 145 von 269

	Eigenschaften des Lasers bestimmt und der Einfluss von Biegung der Faser untersucht. Die Studierenden sind in der Lage, theoretische Vorlesungsinhalte anzuwenden und in der Praxis umzusetzen.
14. Literatur:	Praktikums-Unterlagen
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>338004 Spezialisierungsfachversuch 4</li> <li>338008 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 4</li> <li>338007 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 3</li> <li>338001 Spezialisierungsfachversuch 1</li> <li>338005 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 1</li> <li>338003 Spezialisierungsfachversuch 3</li> <li>338002 Spezialisierungsfachversuch 2</li> <li>338006 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 2</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 30 Stunden Selbststudium / Nacharbeitszeit: 60 Stunden Gesamt: 90 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33801 Praktikum Lasertechnik (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Strahlwerkzeuge

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 146 von 269

### 250 Mikrosystemtechnik

Zugeordnete Module: 251 Kernfächer mit 6 LP

252 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP
253 Ergänzungsfächer mit 3 LP
33810 Praktikum Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 147 von 269

### 251 Kernfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik

32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau

33690 Mikrofluidik und Mikroaktorik

33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 148 von 269

## Modul: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

2. Modulkürzel:	073400001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zim	mermann
9. Dozenten:		André Zimmermann Eugen Ermantraut	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:  13. Inhalt:		Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die wichtigsten Werkstoffeigenschaften sowie Grundlagen der Konstruktion und Fertigung von mikrotechnischen Bauteilen und Systemen. Die Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten der Konstruktion und Fertigung von mikrotechnischen Bauteilen und Systemen in der Produktentwicklung und Produktion zu erkenne und sich eigenständig in Lösungswege einzuarbeiten.	
		<ul> <li>CVD-Technik, Thermische (</li> <li>Lithographie und Maskenter</li> <li>Ätztechniken zur Strukturier IE, Plasmaätzen)</li> <li>Reinraumtechnik</li> </ul>	chnik ten dünner Schichten (PVD- und Oxidation) chnik ung (Nasschemisches Ätzen, RIE,

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 149 von 269

	<ul> <li>Mikrotechnische Bauteile aus Kunststoff (z.B. Mikrospritzguss)</li> <li>Mikrobearbeitung von Metallen (z.B. spanende Mikrobearbeitung)</li> <li>Messmethoden der Mikrotechnik</li> <li>Prozessketten der Mikrotechnik</li> </ul>	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>135401 Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> <li>135402 Freiwillige Übung zur Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13541 Grundlagen der Mikrotechnik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overhead-Projektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 150 von 269

## Modul: 13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

2. Modulkürzel:	072420001	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. Hermann S	Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	issetzungen:	keine		
12. Lernziele:		<ul><li>als auch der Nano- und Mikr</li><li>können die Studierenden eir</li></ul>		
		<ul> <li>Erworbene Kompetenzen:</li> <li>Die Studierenden</li> <li>können die wichtigsten Materialien der Nano- und Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben,</li> <li>können die wichtigsten Verfahren der Mikroelektronik sow derNano- und Mikrosystemtechnik benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodisct Vorgehens zur Herstellung von mikrotechnischen Bauelementen,</li> <li>haben ein Gefühl für den Aufwand einzelner Verfahren entwickeln können,</li> <li>sind mit den technologischen Grenzen der Verfahren vertrund können diese bewerten,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technologische und wirtschaftlicher Randbedingungen, die optimalen</li> </ul>		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 151 von 269

Prozessverfahren auszuwählen und einen kompletten

19. Medienform:	Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel,
18. Grundlage für :	Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13561 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I (PL),
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	135601 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnil I
	Online-Vorlesungen:  • http://www.sensedu.com  • http://www.ett.bme.hu/memsedu  Lernmaterialien:  • Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS
14. Literatur:	<ul> <li>Korvink, J. G., Paul O., MEMS - A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006</li> <li>Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg, 2006</li> <li>Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> </ul>
13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt den Studierenden die Grundlagen, um die komplexen Prozessabläufe bei der Herstellung von modernen Bauelementen der Mikroelektronik sowieder Nano- und Mikrosystemtechnik zu verstehen. Nach einer Einführung in die Thematik werden zunächst die wichtigsten Materialien - insbesondere Silizium - vorgestellt. Anschließend werdendie bedeutendsten Prozesse zur Herstellung von mikroelektronischen und mikrosystemtechnischen Bauelementen und Systemen behandelt. Insbesondere werden die Grundlagenzur Dünnschichttechnik, zur Lithographie und zu den Ätzverfahren vermittelt. Abschließend werden als Vertiefung die Prozessabläufe der Oberflächen- und Bulkmikromechanik kurz vorgestellt und erläutert. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente, wie elektronische Schaltungen oder Mikrosysteme, hergestellt werden können.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 152 von 269

### Modul: 32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	072420002	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann S	Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier		
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011,  → Zusatzmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotect Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> N Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotect Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 1: Mikrotechnik/N Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotect Optik, PO 961-2011, 1. Semes	Mikrosystemtechnik> hnik, Gerätetechnik und Technische ster Mikrosystemtechnik> hnik, Gerätetechnik und Technische	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		Im Modul Mikrosystemtechnik		

- haben die Studierenden einen Überblick über die bedeutendsten Märkte und Bauelemente bzw. Systeme der Mikrosystemtechnik (MST) kennen gelernt
- · wissen die Studierenden, wie sich einzelne physikalische Größen bei einer Miniaturisierung verhalten bzw. ändern und wie diese Skalierung genutzt werden kann, um Mikrosensoren und mikroaktorische Antriebe zu realisieren
- können die Studierenden die bedeutendsten Sensoren und Systeme der Mikrosystemtechnik nach vorgegebene Spezifikationen entwerfen und auslegen.

### Erworbene Kompetenzen:

### Die Studierenden

- haben ein Gefühl für die Märkte der MST und können die wichtigsten Produkte der Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben
- besitzen die Grundlagen, um Auswirkungen einer Miniaturisierung auf physikalische Größen, wie mechanische Spannungen, elektrische, piezoelektrische und magnetische Kräfte, Zeitkonstanten und Frequenzen, thermische Phänomene, Reibungseffekte und das Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen beurteilen zu können
- kennen die physikalischen Grundlagen zu den bedeutendsten Wandlungsprinzipien bzw. Messeffekten der MST

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 153 von 269

- beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Realisierung von mikrosystemtechnischen Sensoren einschließlich der teilweise in den Sensoren erforderlichen mikroaktorischen Antriebe
- können anhand vorgegebener Spezifikationen einen Mikrosensor einschließlich der elektrischen Auswerteschaltung auslegen und entwerfen.

#### 13. Inhalt:

Die Vorlesung Mikrosystemtechnik vermittelt den Studierenden die Grundlagen, und das Basiswissen zur Gestaltung und Entwicklung von mikrotechnischen Funktionselementen, Sensoren und Systemen. Anhand der Skalierung von physikalischen Gesetzen und Größen werden die Grundlagen vermittelt, die zur Auslegung und Berechnung von Bauelementen und Systemen der Mikrosystemtechnik benötigt werden. Es werden die Grundlagen zur Auslegung von schwingungsfähigen Systemen, wie sie in Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren erforderlich sind, vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die in der MST bedeutendsten Wandlungsprinzipien und die Beschreibung anisotroper Effekte. Die gewonnenen Kenntnisse werden anschließend eingesetzt, um den Aufbau und die Funktionsweise der wirtschaftlich bedeutenden Mikrosensoren zu erläutern. Ausführlich wird auf die Mikrosensoren zur Messung von Abständen bzw. Wegen, Drücken, Beschleunigungen, Drehraten, magnetischen und thermischen Größen sowie Durchflüssen, Winkel und Neigungen eingegangen. Da Mikrosensoren heute in der Regel ein elektrisches Ausgangssignal liefern, werden auch für die Sensorsignalauswertung wichtige elektronische Schaltungen behandelt.

#### 14. Literatur:

- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009
- HSU Tai-Ran, MEMS and Microsystems, Wiley, 2008
- Korvink, J. G., Paul O., MEMS A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006
- Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005
- Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik,
- Mescheder U., Mikrosystemtechnik, Teubner Stuttgart Leipzig , 2000
- Pagel L., Mikrosysteme, J. Schlembach Fachverlag, 2001 Online-Vorlesungen:
- http://www.sensedu.com
- http://www.ett.bme.hu/memsedu

Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS Übungen zur Vorlesung

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 322301 Vorlesung Mikrosystemtechnik

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

32231 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1

### 18. Grundlage für ...:

Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen)

### 19. Medienform:

Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 154 von 269

20. Angeboten von:

Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 155 von 269

## Modul: 32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau

2. Modulkürzel:	073400003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. André Zimr	mermann	
9. Dozenten:		André Zimmermann Tobias Vieten		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
11. Empfohlene Voraussetzungen: 12. Lernziele:		Verbindungstechnik - Technologier Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik von Studierenden erwerben grund Verbindungstechnik von Studierenden mikrotechnisch Die Studierenden sollen:  • die Vielfalt und Verschieden Mikrosystemen und der Technick Verbindungstechnik kennen erkennen, wie das Einsatzge die Anforderungen an die Aubestimmt und welche Anforderungen andie Aubestimmt und welche Anforderungen die Einflüsse der Aufbau- un Eigenschaften der Sensorere die Auswirkungen der Aufbau Qualität, Zuverlässigkeit und die von der Stückzahl abhär	en mit dem Modul "Aufbau- und ogien" den Kern der Ausbildung in erbindungstechnik für Mikrosysteme. undlegende Kenntnisse über vei der Entwicklung der Aufbausensoren und Systemen aus en Komponenten.  heit der Aufbauten von hnologien der Aufbau- und lernen, ebiet von Sensoren und Systemen ufbau- und Verbindungstechnik derungen zu erfüllen sind, au Verbindungstechnik auf die n und Systeme erkennen, au- und Verbindungstechniken auf die Kosten kennenlernen, agigen spezifischen ufbau- und Verbindungstechnik von ufbau- und Verbindungstechnik von	
			ird auf die Erfordernisse kompletter den ganzen Lebenszyklus gelegt.	
13. Inhalt:		Einführung, Übersicht zu Aufba Einteilung der Sensoren und M	auten von Mikrosystemen, likrosysteme nach Anforderungen	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 156 von 269

	und Spezifikationen für verschiedene Branchen, Übersicht zu mikrotechnischen Bauelementen für Sensoren, Grundzüge zur Systemarchitektur, Übersicht über Aufbaustrategien und Montageprozesse, grundlegende Eigenschaften der eingesetzten Werkstoffe, umwelt- und betriebsbedingte Beanspruchungen und Stress in verschiedenen Anwendungen, wesentliche Ausfallmechanismen bei mikrotechnischen Bauelementen und Aufbauten, Qualität und Zuverlässigkeit von Sensoren und Mikrosystemen, Funktionsprüfung und Kalibrierung, Besonderheiten von speziellen Sensorsystemen für verschiedene Branchen, Aspekte der Fertigung von Sensoren und Mikrosystemen bei kleinen und großen Stückzahlen. Die jeweiligen Lehrinhalte werden anhand von einschlägigen Beispielen diskutiert und veranschaulicht. Die Lehrinhalte werden durch Übungen vertieft. In einem praktischen Teil wird der Bezug der Lehrinhalte zur industriellen Praxis dargestellt.	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	322401 Vorlesung (inkl. Übungen)	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32241 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 157 von 269

### Modul: 33690 Mikrofluidik und Mikroaktorik

2. Modulkürzel:	072420003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann	Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier Joachim Sägebarth		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		<ul> <li>Im Modul Mikrofluidik und Mikroaktorik</li> <li>haben die Studierenden die physikalischen Grundlagen zu mikrofluidischen Phänomenen kennen gelernt,</li> <li>haben die Studierenden die physikalischen Grundlagen zu Aktorprinzipien kennen gelernt,</li> <li>können die Studierenden die Funktionsweise der wichtigsten mikrofluidischen Produkte und der wichtigsten Aktoren erläutern.</li> <li>Erworbene Kompetenzen</li> <li>Die Studierenden</li> <li>können die wichtigsten Bauelemente der Mikrofluidik und Mikroaktorik benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens beim Entwurf und der Berechnung von mikrofluidischen Bauelementen und Mikroaktoren,</li> <li>haben ein Gefühl für den technischen Aufwand zur Herstellung einzelner Bauelemente entwickelt,</li> <li>sind mit den technischen Grenzen der Bauelemente vertraut und können diese bewerten,</li> <li>besitzen die Grundlagen, um Auswirkungen einer Miniaturisierung auf physikalische Größen, wie Kräfte, Zeitkonstanten, Wärmetransport, fluidische Strömungen, etc. beurteilen zu können,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technischer und wirtschaftlicher Randbedingungen, die optimalen Bauelemente</li> </ul>		
13. Inhalt:		Systeme zu entwerfen.     Die Vorlesung ist in zwei Te unabhängig voneinander sir	eile aufgeteilt, die weitgehen nd. Während im Wintersemester	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 158 von 269

die Mikrofluidik behandelt wird, wird im Sommersemester schwerpunktmäßig auf die Mikroaktorik eingegangen. In keinem Teil der Vorlesung werden die vermittelten Kenntnisse des anderen Teils vorausgesetzt. Die Vorlesung kann deshalb sowohl im Sommer als auch im Wintersemester begonnen werden.

- Im Vorlesungsteil mit dem Schwerpunkt Mikrofluidik werden die physikalischen Grundlagen zu Fluideigenschaften und zur Fluiddynamik vermittelt sowie die Randbedingungen beim miniaturisieren von Fluidsystemen dargestellt. Des Weiteren wird die Entwicklung, Funktionsweise und Herstellung von mikrofluidischen Bauelementen und Aktoren anhand bereits realisierter Systeme (z.B. Lab-On-A-Chip) analysiert.
- Im Vorlesungsteil mit dem Schwerpunkt Mikroaktorik werden die physikalischen Grundlagen zur Mikroaktorik vermittelt. Anhand von Übungen werden die vermittelten Kenntnisse vertieft. Es werden insbesondere die elektrostatischen, die piezoelektrischen, die magnetischen, magneto- und elektrostriktiven sowie die thermischen Aktorprinzipien behandelt. Dabei werden auch die Auswirkungen einer Miniaturisierung auf das Aktorprinzip (Kraft, Weg, Geschwindigkeit bzw. Frequenz, Leistungsverbrauch, etc.) analysiert. Des Weiteren wird auf die Entwicklung und Funktionsweise bereits realisierter mikroaktorischer Bauelemente und Systeme eingegangen.

1	4.	Literatur:	

- Pagel L., Mikrosysteme, J. Schlembach Fachverlag, 2001
- Nam-Trung Nguyen, Mikrofluidik: Entwurf, Herstellung und Charakterisierung, Teubner, 2004
- Korvink, J. G., Paul O., MEMS A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006
- Nam-Trung Nguyen, Steven T. Wereley, Fundamentals and applications of microfluidics, Artech House, 2006
- Patrick Tabeling, Introduction to microfluidics, Oxford University Press. 2006
- Oliver Geschke, Henning Klank, Pieter Telleman, Microsystem engineering of lab on a chip devices, Wiley-VCH, 2008
- HSU Tai-Ran, MEMS and Microsystems, Wiley, 2008
- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009

Online-Vorlesungen:

- http://www.sensedu.com
- http://www.ett.bme.hu/memsedu

Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 336901 Vorlesung mit Übungen : Mikrofluidik und Mikroaktorik

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden

Summe: 180 Stunden

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

33691 Mikrofluidik und Mikroaktorik (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1

#### 18. Grundlage für ...:

Mikrofluidik (Übungen)

### 19. Medienform:

Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial

### 20. Angeboten von:

Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 159 von 269

## Modul: 33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien

2. Modulkürzel:	073400002	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. André Zimi	mermann	
9. Dozenten:		Mahdi Soltani André Zimmermann		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		<ul> <li>bildet zusammen mit dem Modul "Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau" den Kern der Ausbildung in der Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik für Mikrosysteme. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Technologien und Fertigungsverfahren bei der Montage von Mikrosystemen.</li> <li>Die Studierenden sollen:</li> <li>die wichtigsten Fertigungsverfahren der Aufbau- und Verbindungstechnik kennen und in Abhängigkeit der Systemerfordernisse zu bewerten lernen,</li> <li>die Eigenschaften der relevanten Werkstoffe und deren Einfluss auf Qualität und Zuverlässigkeit der Mikrosysteme kennenlernen,</li> <li>die wesentlichen technologischen Einflussgrößen der Verfahren kennenlernen,</li> <li>die wichtigsten Merkmale der Fertigungsanlagen kennen und zu bewerten lernen,</li> </ul>		
13. Inhalt:		Einführung in die Aufbau- und Löten und Kleben in der SMD- Gehäusearten und Typen, Chi Drahtbonden, Flip-Chip-Techn Systemträger (Molded Intercor Spritzgießtechnik, Zweikompo laserbasierte MID-Technik, che Kunststoffen, Chip- und SMD-	pmontage mit Die-Bonden, ik, TAB-Bonden, thermoplastische	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 160 von 269

	(Additive Manufacturing in der Elektronik), Fügen und Verbinden von Kunststoffbauteilen mit Kleben und Schweißen. Die jeweiligen Lehrinhalte werden anhand von einschlägigen Beispielen diskutiert und veranschaulicht. Die Lehrinhalte werden durch Übungen vertieft. In einem praktischen Teil wird der Bezug der Lehrinhalte zur industriellen Praxis dargestellt.	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	337601 Vorlesung(inkl. ÜB, Pr, Exkursion) Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33761 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 161 von 269

### 252 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

13580 Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion

32220 Grundlagen der Biomedizinischen Technik

32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik

32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33690 Mikrofluidik und Mikroaktorik

33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 162 von 269

## Modul: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

2. Modulkürzel:	073400001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zim	mermann
9. Dozenten:		André Zimmermann Eugen Ermantraut	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 1: Mikrotechnik// Vertiefungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes	Mikrosystemtechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Technische Optik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster Mikrosystemtechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Die Studierenden sind in der L Konstruktion und Fertigung vo	Grundlagen der Konstruktion ischen Bauteilen und Systemen. Lage, die Besonderheiten der on mikrotechnischen Bauteilen und icklung und Produktion zu erkennen
13. Inhalt:		<ul> <li>CVD-Technik, Thermische (</li> <li>Lithographie und Maskenter</li> <li>Ätztechniken zur Strukturier IE, Plasmaätzen)</li> <li>Reinraumtechnik</li> </ul>	echnik iten dünner Schichten (PVD- und Oxidation) chnik rung (Nasschemisches Ätzen, RIE, Verbindungstechnik für Mikrosysteme

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 163 von 269

	<ul> <li>Mikrotechnische Bauteile aus Kunststoff (z.B. Mikrospritzguss)</li> <li>Mikrobearbeitung von Metallen (z.B. spanende Mikrobearbeitung)</li> <li>Messmethoden der Mikrotechnik</li> <li>Prozessketten der Mikrotechnik</li> </ul>	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>135401 Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> <li>135402 Freiwillige Übung zur Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13541 Grundlagen der Mikrotechnik (PL), Schriftlich oder Mündlic 40 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overhead-Projektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 164 von 269

## Modul: 13560 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I

2. Modulkürzel:	072420001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann	Sandmaier
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		<ul> <li>haben die Studierenden die Verfahren zur Herstellung v als auch der Nano- und Mik</li> <li>können die Studierenden ei</li> </ul>	ano- und Mikrosystemtechnik I wichtigsten Technologien und on Bauelementen der Mikroelektronik rosystemtechnik kennen gelernt, nzelne technologische Prozesse ige Prozessabläufe selbstständig zu
		<ul> <li>derNano- und Mikrosystemt physikalischer Grundlagenk</li> <li>beherrschen die wesentlich Vorgehens zur Herstellung Bauelementen,</li> <li>haben ein Gefühl für den Auentwickeln können,</li> <li>sind mit den technologische und können diese bewerten</li> </ul>	nen und beschreiben, fahren der Mikroelektronik sowie rechnik benennen und mit Hilfe renntnisse erläutern, en Grundlagen des methodischen von mikrotechnischen ufwand einzelner Verfahren en Grenzen der Verfahren vertraut in, issis gegebener technologischer

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 165 von 269

Prozessverfahren auszuwählen und einen kompletten

19. Medienform:	Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel,
18. Grundlage für :	Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13561 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik I (PL),
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	135601 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnil I
	Online-Vorlesungen:  • http://www.sensedu.com  • http://www.ett.bme.hu/memsedu  Lernmaterialien:  • Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS
14. Literatur:	<ul> <li>Korvink, J. G., Paul O., MEMS - A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006</li> <li>Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg, 2006</li> <li>Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> </ul>
13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt den Studierenden die Grundlagen, um die komplexen Prozessabläufe bei der Herstellung von modernen Bauelementen der Mikroelektronik sowieder Nano- und Mikrosystemtechnik zu verstehen. Nach einer Einführung in die Thematik werden zunächst die wichtigsten Materialien - insbesondere Silizium - vorgestellt. Anschließend werdendie bedeutendsten Prozesse zur Herstellung von mikroelektronischen und mikrosystemtechnischen Bauelementen und Systemen behandelt. Insbesondere werden die Grundlagenzur Dünnschichttechnik, zur Lithographie und zu den Ätzverfahren vermittelt. Abschließend werden als Vertiefung die Prozessabläufe der Oberflächen- und Bulkmikromechanik kurz vorgestellt und erläutert. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente, wie elektronische Schaltungen oder Mikrosysteme, hergestellt werden können.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 166 von 269

## Modul: 13580 Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion

2. Modulkürzel:	072410003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Thomas Ba	auernhansl	
9. Dozenten:		Thomas Bauernhansl		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:			Fertigungslehre mit Einführung in die Fabrikorganisation. Es wird empfohlen die Vorlesung Fabrikbetriebslehreergänzend zu belegen	
Die Digitale Transformation findet inzwischen auch Produktion statt. Die Studierenden erfahren in der die digitale Transformation ist und welche Auswirk auf produzierende Unternehmen hat. Dabei liegt be Augenmerk darauf, die derzeitigen Strukturen und informations- und kommunikationstechnischer Systelleuchten und einen Ausblick auf die zukünftige Ezu geben. Die Studierenden beherrschen nach Bevorlesung die Grundlagen, Methoden und Zusammes Managements von Informationen und Prozess Produktion und haben eine Vorstellung darüber, win den nächsten Jahren verändern werden. Die Stukönnen diese Methoden und Zusammenhänge auf wie auch planerischer Ebene innerhalb der Industrund bewerten und diese entsprechend der jeweilig modifizieren.		und welche Auswirkungen diese en hat. Dabei liegt besonderes tigen Strukturen und Aufgaben tionstechnischer Systeme zu k auf die zukünftige Entwicklung eherrschen nach Besuch der ethoden und Zusammenhänge ationen und Prozessen in der orstellung darüber, wie sich diese dern werden. Die Studierenden Zusammenhänge auf operativer innerhalb der Industrie anwenden		
13. Inhalt:		Informationsmanagement in de Informations- und Kommunikateingesetzt wird und welche Vertransformation zu erwarten sit anfangs einen einführenden Ülenformation, Wissen und Komp Studierenden einen Überblick, in den produzierenden Unterneinen Einblick in grundlegende Kommunikationstechnologie. I Digitale Transformation und Intreibern und Grundlagen vorg Vorlesung auf Anwendungsbe	Themen in der Industrie. Die Vorlesung Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion zeigt auf, wie derzeit Informations- und Kommunikationstechnologie in der Produktion eingesetzt wird und welche Veränderungen durch die Digitale Transformation zu erwarten sind. Dabei gibt die Vorlesung anfangs einen einführenden Überblick über die Themen Daten, Information, Wissen und Kompetenz. Danach erhalten die Studierenden einen Überblick, wie Informationstechnologie derzeit in den produzierenden Unternehmen eingesetzt wird, sowie einen Einblick in grundlegende Konzepte von Informations- und Kommunikationstechnologie. Danach wird der Themenkomplex Digitale Transformation und Industrie 4.0 mit seinen wesentlichen Treibern und Grundlagen vorgestellt, bevor im zweiten Teil der Vorlesung auf Anwendungsbeispiele im Kontext Industrie 4.0 und neue Geschäftsmodelle eingegangen wird.	
14. Literatur:		Skript zur Vorlesung		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		Produktion I	und Informationsmanagement in der	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 167 von 269

	<ul> <li>135803 Vorlesung Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion II</li> <li>135804 Übung Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion II</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 63 Stunden Selbststudium: 117 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13581 Wissens- und Informationsmanagement in der Produktion (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Power-Point Präsentationen, Simulationen, Animationen und Filme	
20. Angeboten von:	Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 168 von 269

## Modul: 32220 Grundlagen der Biomedizinischen Technik

2. Modulkürzel:	040900001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Joachim Nagel	
9. Dozenten:		Joachim Nagel Johannes Port	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Biomedizinische Technik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Biomedizinische Technik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		keine	
12. Lernziele:		<ul> <li>Instrumentierung</li> <li>kennen die physikalischen C Herleitungen und Annahmer Messverfahren</li> <li>haben wesentliche Kenntnis</li> <li>besitzen fundamentale Kenr und von der Physiologie der Funktionen</li> <li>können die Verfahren bewei in der biomedizinischen Tec</li> <li>verfügen über einen wesent biomedizinischer Begriffe</li> <li>besitzen sowohl grundlegen Fach- und Methodenwissen medizinische Kenntnisse</li> <li>sind in der Lage, eine Verbir Biologie einerseits und den andererseits herzustellen so molekularen Ebene bis hin z erforschen und neue Materia</li> </ul>	des theoretisches und praktisches als auch biologische und ndung zwischen der Medizin und Ingenieurund Naturwissenschaften wie neue Kenntnisse von der zu gesamten Organsystemen zu alien, Systeme, Verfahren und t dem Ziel der Prävention, Diagnose

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 169 von 269

der Patientenversorgung, der Rehabilitation und der Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme.

#### 13. Inhalt:

In dem Modul werden folgende Inhalte vermittelt:

- die besonderen Probleme bei der Messung physiologischer Kenngrößen
- die grundlegenden Eigenschaften biologischer Gewebe
- die Besonderheiten der Elektroden und damit die entsprechenden einzuhaltenden Maßnahmen bei der Ableitung der Signale
- die physikalischen Grundlagen wichtiger mechanoelektrischer, photoelektrischer, elektrochemischer und thermoelektrischer Wandler
- die wesentlichen Prinzipien und die biomedizinisch spezifischen Besonderheiten der Signalerfassung, Signalverarbeitung, Signalverstärkung und Signalübertragung
- allgemeine Eigenschaften des kardiovaskulären und respiratorischen Systems
- Messverfahren kardiovaskulärer Kenngrößen, wie Elektrokardiogramm, Impedanzkardiogramm, Impedanzplethysmogramm, Blutdruckmessung, Blutflussmessung, etc.
- Messverfahren respiratorischer Kenngrößen, wie Impedanzpneumographie, Pneumotachographie, Spirometrie, Ganzkörperplethysmographie, etc.
- Messverfahren biochemischer Kenngrößen, wie pH-Wert-Messung, Ionenkonzentrationsmessung, Sauerstoffmessung, etc.
- Messverfahren neurologischer Kenngrößen, wie das Elektroenzephalogramm, Elektroneurogramm, Evozierte Potentiale, etc.
- Messverfahren visueller Kenngröße, wie das Elektrookulogramm, das Elektroretinogramm, etc., - wichtige physikalische, akustische Kenngrößen
- Messverfahren akustischer Kenngrößen, wie das Audiogramm, otoakustisch evozierte Potentiale, Elektrocochleogramm, etc.
- Messverfahren weiterer wichtiger Kenngrößen, wie das Elektromyogramm, Elektronystagmogramm, etc.
- Bildgebende Verfahren, wie die Röntgentechnik, Ultraschall, Magnetresonanztechnik, Endoskopietechnik, Thermographie, etc.
- Beispiele für Implantate und Funktionsersatz, wie das Cochlea-Implantat, Mittelohrprothese, Hörgeräte, Herzschrittmacher, Herzklappenersatz, etc.
- Beispiele aktueller Forschung, wie das Brain- Computer Interface, biohybride Armprothese, etc..

#### 14. Literatur:

- Port, J.: Grundlagen der Biomedizinischen Technik, Vorlesungsskript und Vorlesungsfolien
- Bronzino, J.: The Biomedical Engineering Handbook I+II, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000
- Wintermantel, E., Ha, S.-W.: Medizintechnik: Life Science Engineering, 5. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
- Kramme, R.: Medizintechnik, 3. Auflage, Springer- Verlag, 2007
- Schmidt, R., Lang, F.: Physiologie des Menschen, 30. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007
- Eichmeier, J.: Medizinische Elektronik, 3. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1997

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 170 von 269

20. Angeboten von:

• Czichos, H., Hennecke, M., Hütte: Das Ingenieurwissen, 33. Auflage, Springer-Verlag Berlin • Heidelberg, 2008 - Dössel, O.: Bildgebende Verfahren in der Medizin, Springer-Verlag Berlin • Heidelberg, 2000 - Kalender, W.: Computertomographie. Grundlagen, Gerätetechnologie, Bildqualität, Anwendungen, 2. Auflage, Publicis Corporate Publishing Verlag, 2006 • Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 261. Auflage, Walter de Gruyter-Verlag, 2007 • Bannwarth, H., Kremer, B. P., Schulz, A.: Basiswissen Physik, Chemie und Biochemie, Springer- Verlag Berlin Heidelberg, • Brdicka, R.: Grundlagen der physikalischen Chemie, 15. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, 1990 15. Lehrveranstaltungen und -formen: • 322201 Grundlagen der Biomedizinischen Technik 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 58 Stunden Selbststudium: 122 Stunden Summe: 180 Stunden 17. Prüfungsnummer/n und -name: 32221 Grundlagen der Biomedizinischen Technik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1 18. Grundlage für ...: Übungen zur Biomedizinischen Technik Beamer-Präsentation, Overhead-Projektor, Tafel 19. Medienform:

Biomedizinische Technik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 171 von 269

### Modul: 32230 Grundlagen der Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	072420002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann Sa	ndmaier
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier	
10. Zuordnung zum Cu Studiengang:	urriculum in diesem		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Im Modul Mikrosystemtechnik	

- haben die Studierenden einen Überblick über die bedeutendsten Märkte und Bauelemente bzw. Systeme der Mikrosystemtechnik (MST) kennen gelernt
- · wissen die Studierenden, wie sich einzelne physikalische Größen bei einer Miniaturisierung verhalten bzw. ändern und wie diese Skalierung genutzt werden kann, um Mikrosensoren und mikroaktorische Antriebe zu realisieren
- können die Studierenden die bedeutendsten Sensoren und Systeme der Mikrosystemtechnik nach vorgegebene Spezifikationen entwerfen und auslegen.

### Erworbene Kompetenzen:

### Die Studierenden

- haben ein Gefühl für die Märkte der MST und können die wichtigsten Produkte der Mikrosystemtechnik benennen und beschreiben
- besitzen die Grundlagen, um Auswirkungen einer Miniaturisierung auf physikalische Größen, wie mechanische Spannungen, elektrische, piezoelektrische und magnetische Kräfte, Zeitkonstanten und Frequenzen, thermische Phänomene, Reibungseffekte und das Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen beurteilen zu können
- kennen die physikalischen Grundlagen zu den bedeutendsten Wandlungsprinzipien bzw. Messeffekten der MST

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 172 von 269

- beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Realisierung von mikrosystemtechnischen Sensoren einschließlich der teilweise in den Sensoren erforderlichen mikroaktorischen Antriebe
- können anhand vorgegebener Spezifikationen einen Mikrosensor einschließlich der elektrischen Auswerteschaltung auslegen und entwerfen.

#### 13. Inhalt:

Die Vorlesung Mikrosystemtechnik vermittelt den Studierenden die Grundlagen, und das Basiswissen zur Gestaltung und Entwicklung von mikrotechnischen Funktionselementen, Sensoren und Systemen. Anhand der Skalierung von physikalischen Gesetzen und Größen werden die Grundlagen vermittelt, die zur Auslegung und Berechnung von Bauelementen und Systemen der Mikrosystemtechnik benötigt werden. Es werden die Grundlagen zur Auslegung von schwingungsfähigen Systemen, wie sie in Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren erforderlich sind, vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die in der MST bedeutendsten Wandlungsprinzipien und die Beschreibung anisotroper Effekte. Die gewonnenen Kenntnisse werden anschließend eingesetzt, um den Aufbau und die Funktionsweise der wirtschaftlich bedeutenden Mikrosensoren zu erläutern. Ausführlich wird auf die Mikrosensoren zur Messung von Abständen bzw. Wegen, Drücken, Beschleunigungen, Drehraten, magnetischen und thermischen Größen sowie Durchflüssen, Winkel und Neigungen eingegangen. Da Mikrosensoren heute in der Regel ein elektrisches Ausgangssignal liefern, werden auch für die Sensorsignalauswertung wichtige elektronische Schaltungen behandelt.

#### 14. Literatur:

- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009
- HSU Tai-Ran, MEMS and Microsystems, Wiley, 2008
- Korvink, J. G., Paul O., MEMS A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006
- Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005
- Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik,
- Mescheder U., Mikrosystemtechnik, Teubner Stuttgart Leipzig , 2000
- Pagel L., Mikrosysteme, J. Schlembach Fachverlag, 2001
   Online-Vorlesungen:
- http://www.sensedu.com
- http://www.ett.bme.hu/memsedu

Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS Übungen zur Vorlesung

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 322301 Vorlesung Mikrosystemtechnik

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

32231 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1

### 18. Grundlage für ...:

Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen)

19. Medienform:

Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 173 von 269

20. Angeboten von:

Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 174 von 269

## Modul: 32240 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau

2. Modulkürzel:	073400003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. André Zimr	mermann	
9. Dozenten:		André Zimmermann Tobias Vieten		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
11. Empfohlene Voraussetzungen: 12. Lernziele:		Verbindungstechnik - Technologier Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik von Studierenden erwerben grund Verbindungstechnik von Studierenden mikrotechnisch Die Studierenden sollen:  • die Vielfalt und Verschieden Mikrosystemen und der Technick Verbindungstechnik kennen erkennen, wie das Einsatzge die Anforderungen an die Aubestimmt und welche Anforderungen andie Aubestimmt und welche Anforderungen die Einflüsse der Aufbau- un Eigenschaften der Sensorere die Auswirkungen der Aufbau Qualität, Zuverlässigkeit und die von der Stückzahl abhär	en mit dem Modul "Aufbau- und ogien" den Kern der Ausbildung in erbindungstechnik für Mikrosysteme. undlegende Kenntnisse über vei der Entwicklung der Aufbausensoren und Systemen aus en Komponenten.  heit der Aufbauten von hnologien der Aufbau- und lernen, ebiet von Sensoren und Systemen ufbau- und Verbindungstechnik derungen zu erfüllen sind, au Verbindungstechnik auf die n und Systeme erkennen, au- und Verbindungstechniken auf die Kosten kennenlernen, agigen spezifischen ufbau- und Verbindungstechnik von ufbau- und Verbindungstechnik von	
		Ein besonderes Augenmerk wird auf die Erfordernisse kompletter Sensoren oder Systeme über den ganzen Lebenszyklus gelegt.		
13. Inhalt:		Einführung, Übersicht zu Aufbauten von Mikrosystemen, Einteilung der Sensoren und Mikrosysteme nach Anforderungen		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 175 von 269

	und Spezifikationen für verschiedene Branchen, Übersicht zu mikrotechnischen Bauelementen für Sensoren, Grundzüge zur Systemarchitektur, Übersicht über Aufbaustrategien und Montageprozesse, grundlegende Eigenschaften der eingesetzten Werkstoffe, umwelt- und betriebsbedingte Beanspruchungen und Stress in verschiedenen Anwendungen, wesentliche Ausfallmechanismen bei mikrotechnischen Bauelementen und Aufbauten, Qualität und Zuverlässigkeit von Sensoren und Mikrosystemen, Funktionsprüfung und Kalibrierung, Besonderheiten von speziellen Sensorsystemen für verschiedene Branchen, Aspekte der Fertigung von Sensoren und Mikrosystemen bei kleinen und großen Stückzahlen. Die jeweiligen Lehrinhalte werden anhand von einschlägigen Beispielen diskutiert und veranschaulicht. Die Lehrinhalte werden durch Übungen vertieft. In einem praktischen Teil wird der Bezug der Lehrinhalte zur industriellen Praxis dargestellt.	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 322401 Vorlesung (inkl. Übungen)	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32241 Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 176 von 269

## Modul: 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. Joachim Bu	ırghartz
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	issetzungen:	V/Ü Grundlagen der Mikroelekt	
12. Lernziele:		Vermittlung weiterführender Kenntnisse der wichtigsten Technologien und Techniken in der Elektronikfertigung	
13. Inhalt:		Die Vorlesung bietet eine fundierte und praxisbezogene Einführung in die Herstellung von Mikrochips und die besonderen Aspekte beim Test mikroelektronischer Schaltungen sowie dem Verpacken der Chips in IC-Gehäuse.  Grundlagen der Mikroelektronik Lithografieverfahren Wafer-Prozesse CMOS-Gesamtprozesse Packaging und Test Qualität und Zuverlässigkeit	
14. Literatur:		2002	·

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 177 von 269

	<ul> <li>- L.E. Glasser and D.W. Dobberpuhl: The Design and Aanalysis of VLSI Circuits, Addison Wesley.</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>322501 Vorlesung und Übung Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (Blockveranstaltung)</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32251 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 oder bei geringer Anzahl Studierender: mündlich, 40 min.	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	PowerPoint	
20. Angeboten von:	Mikroelektronik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 178 von 269

# Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		<ul> <li>-technologie (Werkstoffe, Verf- Magnetisierung). Die Studiere Antriebe (rotatorische und line berechnen, gestalten und ausl können elektrodynamische An</li> </ul>	ntriebe (rotatorische und lineare ereinfacht berechnen, gestalten en kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerp	(Werkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 179 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 180 von 269

#### Modul: 33690 Mikrofluidik und Mikroaktorik

2. Modulkürzel:	072420003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann	Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier Joachim Sägebarth		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		<ul> <li>Im Modul Mikrofluidik und Mikroaktorik</li> <li>haben die Studierenden die physikalischen Grundlagen zu mikrofluidischen Phänomenen kennen gelernt,</li> <li>haben die Studierenden die physikalischen Grundlagen zu Aktorprinzipien kennen gelernt,</li> <li>können die Studierenden die Funktionsweise der wichtigsten mikrofluidischen Produkte und der wichtigsten Aktoren erläutern</li> <li>Erworbene Kompetenzen</li> <li>Die Studierenden</li> <li>können die wichtigsten Bauelemente der Mikrofluidik und Mikroaktorik benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens beim Entwurf und der Berechnung von mikrofluidischen Bauelementen und Mikroaktoren,</li> <li>haben ein Gefühl für den technischen Aufwand zur Herstellung einzelner Bauelemente entwickelt,</li> <li>sind mit den technischen Grenzen der Bauelemente vertraut unkönnen diese bewerten,</li> <li>besitzen die Grundlagen, um Auswirkungen einer Miniaturisierung auf physikalische Größen, wie Kräfte, Zeitkonstanten, Wärmetransport, fluidische Strömungen, etc. beurteilen zu können,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technischer und wirtschaftlicher Randbedingungen, die optimalen Bauelemente</li> </ul>		
13. Inhalt:		Systeme zu entwerfen.     Die Vorlesung ist in zwei Te unabhängig voneinander sir	eile aufgeteilt, die weitgehen nd. Während im Wintersemester	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 181 von 269

die Mikrofluidik behandelt wird, wird im Sommersemester schwerpunktmäßig auf die Mikroaktorik eingegangen. In keinem Teil der Vorlesung werden die vermittelten Kenntnisse des anderen Teils vorausgesetzt. Die Vorlesung kann deshalb sowohl im Sommer als auch im Wintersemester begonnen werden.

- Im Vorlesungsteil mit dem Schwerpunkt Mikrofluidik werden die physikalischen Grundlagen zu Fluideigenschaften und zur Fluiddynamik vermittelt sowie die Randbedingungen beim miniaturisieren von Fluidsystemen dargestellt. Des Weiteren wird die Entwicklung, Funktionsweise und Herstellung von mikrofluidischen Bauelementen und Aktoren anhand bereits realisierter Systeme (z.B. Lab-On-A-Chip) analysiert.
- Im Vorlesungsteil mit dem Schwerpunkt Mikroaktorik werden die physikalischen Grundlagen zur Mikroaktorik vermittelt. Anhand von Übungen werden die vermittelten Kenntnisse vertieft. Es werden insbesondere die elektrostatischen, die piezoelektrischen, die magnetischen, magneto- und elektrostriktiven sowie die thermischen Aktorprinzipien behandelt. Dabei werden auch die Auswirkungen einer Miniaturisierung auf das Aktorprinzip (Kraft, Weg, Geschwindigkeit bzw. Frequenz, Leistungsverbrauch, etc.) analysiert. Des Weiteren wird auf die Entwicklung und Funktionsweise bereits realisierter mikroaktorischer Bauelemente und Systeme eingegangen.

#### 14. Literatur:

- Pagel L., Mikrosysteme, J. Schlembach Fachverlag, 2001
- Nam-Trung Nguyen, Mikrofluidik: Entwurf, Herstellung und Charakterisierung, Teubner, 2004
- Korvink, J. G., Paul O., MEMS A practical guide to design, analysis and applications, Springer, 2006
- Nam-Trung Nguyen, Steven T. Wereley, Fundamentals and applications of microfluidics, Artech House, 2006
- Patrick Tabeling, Introduction to microfluidics, Oxford University Press. 2006
- Oliver Geschke, Henning Klank, Pieter Telleman, Microsystem engineering of lab on a chip devices, Wiley-VCH, 2008
- HSU Tai-Ran, MEMS and Microsystems, Wiley, 2008
- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009

Online-Vorlesungen:

- http://www.sensedu.com
- http://www.ett.bme.hu/memsedu

Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS

#### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 336901 Vorlesung mit Übungen : Mikrofluidik und Mikroaktorik

#### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden

Summe: 180 Stunden

#### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

33691 Mikrofluidik und Mikroaktorik (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1

18. Grundlage für ...: Mikrofluidik (Übungen)

#### 19. Medienform:

Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial

20. Angeboten von:

Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 182 von 269

#### Modul: 33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

2. Modulkürzel: 073100002		5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester		
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oster	١		
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Klaus Körner Erich Steinbeißer	Klaus Körner		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:				
12. Lernziele:		<ul> <li>verstehen die Unterschiede zwischen wellenoptischer und geometrisch-optischer Beschreibung,</li> <li>sind in der Lage, die in Wellenfeldern enthaltene Information z beschreiben,</li> <li>können Messungen kritisch mittels Fehleranalyse bewerten,</li> <li>kennen die Rolle und Wirkungsweise der wichtigsten Komponenten und sind in der Lage, optische Mess-Systeme a einzelnen Komponenten zusammenzustellen und zu bewerten</li> <li>sind in der Lage, Methoden zur Vermessung von optischen und technischen Oberflächen sowie deren Oberflächenveränderungen zielgerichtet einzusetzen.</li> </ul>			
13. Inhalt:		Grundlagen der geometrisch - optische Komponenten - optische Systeme Grundlagen der Wellenoptik: - Wellentypen - Interferenz und Kohärenz			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 183 von 269

	- Beugung und Auflösungsvermögen Holografie Speckle Klassifikation und Charakterisierung von Oberflächen Messfehler Grundprinzipien und Klassifikation optischer Messtechniken Messmethoden auf Basis der geometrischen Optik: - Strukturierte Beleuchtung - Moire - Messmikroskope und Messfernrohre Messmethoden auf Basis der Wellenoptik: - interferometrische Messtechniken - Interferenzmikroskopie - holografische Interferometrie - Speckle-Messtechniken - Laufzeittechniken
14. Literatur:	Manuskript der Vorlesung, Pedrotti, F., et al: Optik für Ingenieure. Springer Verlag, Berlin 2007, Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Verlag, München 2014, Malacara, D.: Optical shop testing 2007, Cathey, T.: Optical Information Processing and Holography 1974, Erf, R.: Speckle metrology 1978.
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>337101 Vorlesung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> <li>337102 Übung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33711 Optische Messtechnik und Messverfahren (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 184 von 269

## Modul: 33760 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien

2. Modulkürzel:	073400002	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zimi	mermann	
9. Dozenten:		Mahdi Soltani André Zimmermann		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		<ul> <li>Das Modul "Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien" bildet zusammen mit dem Modul "Aufbau- und Verbindungstechnik - Sensor- und Systemaufbau" den Kern der Ausbildung in der Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik für Mikrosysteme. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Technologien und Fertigungsverfahren bei der Montage von Mikrosystemen.</li> <li>Die Studierenden sollen:</li> <li>die wichtigsten Fertigungsverfahren der Aufbau- und Verbindungstechnik kennen und in Abhängigkeit der Systemerfordernisse zu bewerten lernen,</li> <li>die Eigenschaften der relevanten Werkstoffe und deren Einfluss auf Qualität und Zuverlässigkeit der Mikrosysteme kennenlernen,</li> <li>die wesentlichen technologischen Einflussgrößen der Verfahren kennenlernen,</li> <li>die wichtigsten Merkmale der Fertigungsanlagen kennen und zu bewerten lernen,</li> </ul>		
13. Inhalt:		Einführung in die Aufbau- und Verbindungstechnik, Leiterplatten, Löten und Kleben in der SMD-Technik, Dickschichttechnik, Gehäusearten und Typen, Chipmontage mit Die-Bonden, Drahtbonden, Flip-Chip-Technik, TAB-Bonden, thermoplastische Systemträger (Molded Interconnect Devices "MID") mit Spritzgießtechnik, Zweikomponentenspritzguss-MID-Technik, laserbasierte MID-Technik, chemische Metallbeschichtung von Kunststoffen, Chip- und SMD-Montage auf MID, Heißpräge-MID-Technik, Sensoren und Aktoren in MID-Technik, Drucktechniken		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 185 von 269

	(Additive Manufacturing in der Elektronik), Fügen und Verbinden von Kunststoffbauteilen mit Kleben und Schweißen. Die jeweiligen Lehrinhalte werden anhand von einschlägigen Beispielen diskutiert und veranschaulicht. Die Lehrinhalte werden durch Übungen vertieft. In einem praktischen Teil wird der Bezug der Lehrinhalte zur industriellen Praxis dargestellt.	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	337601 Vorlesung(inkl. ÜB, Pr, Exkursion) Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33761 Aufbau- und Verbindungstechnik - Technologien (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 186 von 269

#### 253 Ergänzungsfächer mit 3 LP

Zugeordnete Module: 32880 Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik

33110 Modellierung und Simulation in der Mikrosystemtechnik

33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker

33530 Mikrofluidik (Übungen)

33540 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen)33770 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 187 von 269

## Modul: 32880 Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	073400005	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester		
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	er:	Rainer Mohr			
9. Dozenten:		Rainer Mohr			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Ergänzungsfächer mit 3 L  Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech  Optik, PO 961-2011, 1. Semes	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische</li> <li>Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt;</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine			
12. Lernziele:		<ul> <li>Ziel ist es, den Studierenden Kenntnisse über elektronische Bauelemente, insbesondere für Anwendungen in der Mikrosystemtechnik und Medizintechnik, z.B. als sensorische und aktorische Elemente zu vermitteln. Es werden verteilte elektronische Bauelemente behandelt, z.B. Leiterbahnen, Oberflächen u.a.</li> <li>Die Studierenden sind in der Lage</li> <li>Elektronische Bauelemente zu qualifizieren, d.h. ein für den gedachten Anwendungszweck geeignetes Bauelement</li> </ul>			
		<ul><li>auszusuchen.</li><li>Ersatzschaltbilder für Bauele</li><li>elektrische Messtechnik durc</li><li>ein Schaltungssimulationspro</li></ul>	mente zu erstellen chzuführen		
13. Inhalt:		Allgemeines zu elektronischen Bauelementen, Leitungsmechanismen, Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Halbleiter (Diode, Bipolare Transistoren, Feldeffekttransistoren), Ladungsverschiebungselemente (CCD), Elektronische Speicher, Parasitäre Eigenschaften bei elektronischen Bauelementen, Piezoelektrische Bauelemente (Quarz, Piezokeramik), Organische elektronische Bauelemente (OLED, OFET)			
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Datenblätter und Anwendungsbevon Herstellern (Application Notes), Literatur zu den einzelr Kapiteln (Literaturverzeichnis im Manuskript).			
15. Lehrveranstaltunge	taltungen und -formen: • 328801 Vorlesung (inkl. Übungen und Schaltungssimu Elektronische Bauelemente in der Mikrosystemtechnik				
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/r	und -name:		lente in der Mikrosystemtechnik (BSL)		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 188 von 269

19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 189 von 269

# Modul: 33110 Modellierung und Simulation in der Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	073400006	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester		
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	er:	Rainer Mohr			
9. Dozenten:		Rainer Mohr			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Se → Ergänzungsfächer m	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine			
12. Lernziele:		Simulationsmethoden, ins vermitteln. Dazu gehört au	Ziel ist es, den Studierenden Modellierungs- und Simulationsmethoden, insbesondere der Mikrosystemtechnik, zu vermitteln. Dazu gehört auch die Vermittlung von Kenntnissen der Bedienung entsprechender Programme (Matlab / Simulink, LTSpice und ANSYS).		
13. Inhalt:		Einführung in die Modellierung und Simulation, Einführung in die numerische Feldberechnung, Netzwerkbeschreibung physikalischer Strukturen (elektrische, mechanische, elektromechanische und thermische Netzwerke), Blockbeschreibung, Finite Differenzen Methode, Finite Elemente Methode (Galerkin Verfahren, Vernetzung, Fehlerabschätzung, Adaptive Verfahren), Einführung in ANSYS			
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Literatur zu den einzelnen Kapiteln (Literaturverzeichnis im Manuskript)			
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	331101 Vorlesung (inkl. Übungen am Computer): Modellierung u Simulation in der Mikrosystemtechnik			
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33111 Modellierung und Simulation in der Mikrosystemtechnik (BS Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:		Beamerpräsentation, Tafel, 20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung/ en und			
20. Angeboten von:		Mikrosystemtechnik			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 190 von 269

## Modul: 33450 Elektronik für Mikrosystemtechniker

2. Modulkürzel:	073400004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	Rainer Mohr		
9. Dozenten:		Rainer Mohr		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine		
12. Lernziele:		Ziel ist es, den Studierenden elektronische Schaltungstechnik zu vermitteln. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Schaltungen der Mikrosystem- und der Medizintechnik: Sensorik, Sensor- u. Bio-Signalverarbeitung.		
		Die Studierenden sind in der L - Einfache Schaltungen zu din - Schaltbilder zu lesen und zu - elektrische Messtechnik durc - ein Schaltungssimulationspro	nensionieren verstehen chzuführen	
13. Inhalt:		Einfache Stromkreise, Elektrische Netzwerke, Wechselstromlehre, Sensor- und Bio-Signalverarbeitung (digital und analog), Verstärker, analoge integrierte Schaltungen (Operationsverstärker), Oszillatoren, Stromversorgungen, analoge und digitale Filter, Rauschen, Schaltungsbeispiele, Übungen mit dem Schaltungsanalyseprogramm LT-Spice.		
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Lite (Literaturverzeichnis im Manus	eratur zu den einzelnen Kapiteln skript)	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	334501 Vorlesung (inkl. Elek Mikrosystemtechniker	ktronikpraktikum) Elektronik für	
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	33451 Elektronik für Mikrosys Mündlich, 20 Min., Ge	stemtechniker (BSL), Schriftlich oder wichtung: 1	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Beamerpräsentation, Overheadprojektor, Tafel		
20. Angeboten von:		Mikrosystemtechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 191 von 269

# Modul: 33530 Mikrofluidik (Übungen)

2. Modulkürzel:	072420106	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	-	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	Hermann Sandmaier		
9. Dozenten:		Joachim Sägebarth Hermann Sandmaier		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Seme	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Ergänzungsfächer mit 3 LP> Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Teilnahme an der Vorlesung	Mikrofluidik und Mikroaktorik	
12. Lernziele:		lm Modul Mikrofluidik (Übung	en)	
		- vertiefen die Studierenden das in der Vorlesung Mikrofluidik vermittelte theoretische Wissen von		
		fluidischen Systemen an praktischen Übungsbeispielen.		
		Erworbene Kompetenzen:		
		Die Studierenden		
		- können fluidische Systeme ı	modellieren,	
		- können diese Systeme simu	ılieren	
		- lernen das Werkzeug "Simu	lation kennen und zu bedienen.	
13. Inhalt:				
14. Literatur:				
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 335301 Übungen Mikrofluid	ik	
16. Abschätzung Arbe	itsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 9 Stunden		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	33531 Mikrofluidik (Übunger 1	n) (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtun	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Beamer, handouts, Gruppena	arbeit, einzeln am PC	
20. Angeboten von:		Mikrosystemtechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 192 von 269

# Modul: 33540 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen)

2. Modulkürzel:	072420102		5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP		6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	2		7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivF	Prof. DrIng. Hermann	Sandmaier	
9. Dozenten:		Herma	nn Sandmaier		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, → E	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Modul	32230: Grundlagen de	er Mikrosystemtechnik (Vorlesung)	
12. Lernziele:		der Vo	Zur Vertiefung und zum besseren Verständnis des Vorlesungstoffs der Vorlesung Grundlagen der Mikrosystemtechnik werden zu den in der Vorlesung behandelten Themen Übungsbeispiele gerechnet.		
13. Inhalt:		Die Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen) ergänzen die Vorlesung Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Modul 33540). Der Inhalt ist weitgehen identisch mit dem Vorlesungstoff der Vorlesung Grundlagen der Mikrosystemtechnik. Dabei werden die in der Vorlesung behandelten Grundlagen durch Übungsaufgaben vertieft.			
14. Literatur:		Mikros Aufgal	siehe die Angaben in der Vorlesung Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Modul 32230) Aufgabenstellungen und Lösungen zur Übung Grundlagen der Mikrosystemtechnik auf ILIAS		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 3354	01 Übungen Mikrosys	temtechnik	
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbstudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33541 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Übungen) (BSL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:		Rechnung in Gruppen und Präsentation der Lösungen			
20. Angeboten von:		Mikros	Mikrosystemtechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 193 von 269

## Modul: 33770 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II

2. Modulkürzel:	072420004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Hermann	Sandmaier	
9. Dozenten:		Hermann Sandmaier		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Technologien der Nano- und	Mikrosystemtechnik I	
12. Lernziele:		Im Modul Technologien der N	ano- und Mikrosystemtechnik II	
		<ul> <li>haben die Studierenden die Technologien der Oberflächen- und Bulkmikromechanik sowie die Röntgenlithographie und das LIGA Verfahren zur Herstellung von Bauelementen der Nano- und Mikrosystemtechnik vertiefend kennen gelernt,</li> <li>können die Studierenden die Prozessverfahren bewerten und sind in der Lage Prozessabläufe selbstständig zu entwerfen.</li> </ul>		
		Erworbene Kompetenzen:		
		Die Studierenden		
		<ul> <li>können die Verfahren der Oberflächen- und Bulkmikromechanik sowie die Röntgenlithographie und das LIGA-Verfahren benennen und mit Hilfe physikalischer Grundlagenkenntnisse erläutern,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens zur Herstellung von mikrotechnischen Bauelemente auf der Basis der oben genannten Technologien</li> <li>haben ein Gefühl für den Aufwand der einzelnen Verfahren entwickeln können,</li> <li>sind mit den technologischen Grenzen der Verfahren vertraut und können diese bewerten,</li> <li>sind in der Lage, auf der Basis gegebener technologischer und wirtschaftlicher Randbedingungen einen kompletten Prozessablauf zur Herstellung von mikrotechnischen Bauelementen und Systemen zu entwerfen.</li> </ul>		
13. Inhalt:		Die Vorlesung vermittelt den Studierenden die Grundlagen, um die spezifischen Prozessabläufe zur Herstellung von modernen Bauelementen der Mikrosystemtechnik zu verstehen. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik werden die Oberflächenmikromechanik (OMM), die Bulkmikromechanik (BMM), die Röntgenlitho-graphie und das LIGA-Verfahren ausführlich behandelt, und die Grundlagen zu den einzelnen		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 194 von 269

	technologischen Prozessen vermittelt. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie durch eine geschickte Aneinanderreihung der einzelnen Prozesse komplexe Bauelemente der Nano- und Mikrosystemtechnik, wie z.B. Druck-, Beschleunigungssensoren und das Digital Mirror Device (DMD) hergestellt werden können.
14. Literatur:	<ul> <li>- Menz, W., Mohr, J., Paul, O., Mikrosystemtechnik für Ingenieure, Weinheim: Wiley-VCH, 2005</li> <li>- Madou, M., Fundamentals of Microfabrication, 2. Auflage, Boca Raton: crcpress, 1997</li> <li>- Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer, 2003</li> <li>- Völklein, F., Zetterer T., Praxiswissen Mikrosystemtechnik, 2. Auflage, Wiesbaden, Vieweg,2006</li> <li>- Schwesinger N., Dehne C., Adler F., Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenburg Verlag, 2009</li> <li>Online-Vorlesungen:</li> <li>- http://www.sensedu.com</li> <li>- http://www.sensedu.com</li> <li>- http://www.ett.bme.hu/memsedu</li> <li>Lernmaterialien: - Vorlesungsfolien und -skript auf ILIAS</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	337701 Vorlesung Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33771 Technologien der Nano- und Mikrosystemtechnik II (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Präsentation mit Animationen und Filmen, Beamer, Tafel, Anschauungsmaterial
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 195 von 269

#### Modul: 33810 Praktikum Mikrosystemtechnik

2. Modulkürzel:	073400201	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	ner:	Dr. Joachim Sägebarth	
9. Dozenten:		Rainer Mohr Joachim Sägebarth	
10. Zuordnung zum Co Studiengang:	urriculum in diesem	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 3. Semester  → Mikrosystemtechnik> Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Vorau	ıssetzungen:		
12. Lernziele:			s umzusetzen. Im Praktikum hnik lernen die Studierenden in en (SFV) innerhalb eines Teams u analysieren, in Teilprojekte sieren und mit den Mitteln des
13. Inhalt:		Nähere Informationen zu den Praktischen Übungen: APMB erhalten Sie zudem unter http://www.uni-stuttgart.de/mabau/msc/msc_mach/ linksunddownloads.html und unter dem Infopool Mikrosystemtechnik in Ilias Praktikum am Lehrstuhl mst: Durchführung eines Projektes zum Aufbau eines Versuchsstandes zur Charakterisierung eines Beschleunigungssensors. Praktikum am IFM: Praktische Beispiele für Herstellung, Aufbau und Test mikromechanischer Komponenten und Systeme, insbesondere in MID-Technologie.	
14. Literatur:		Präsentationen, Moderation, F	Praktikumsunterlagen
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>338102 Spezialisierungsfachversuch 2</li> <li>338108 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschiner (APMB) 4</li> <li>338107 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschiner (APMB) 3</li> <li>338106 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschiner (APMB) 2</li> <li>338103 Spezialisierungsfachversuch 3</li> <li>338104 Spezialisierungsfachversuch 4</li> <li>338101 Spezialisierungsfachversuch 1</li> <li>338105 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschiner (APMB) 1</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 30 Stunden Selbststudium: 60 Stunden Gesamt: 90 Stunden	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 196 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	33811 Praktikum Mikrosystemtechnik (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	mst: Umdrucke, elektronische Medien (Powerpoint, Excel, Mindmapping, Eagle, Speq, ,) IFM: Umdrucke, Demonstrationen und Bedienung von Geräten
20. Angeboten von:	Mikrointegration

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 197 von 269

#### 260 Technische Optik

Zugeordnete Module: 261 Kernfächer mit 6 LP

262 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP
263 Ergänzungsfächer mit 3 LP
33460 Praktikum Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 198 von 269

#### 261 Kernfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 14060 Grundlagen der Technischen Optik

29950 Optische Informationsverarbeitung

33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 199 von 269

## Modul: 14060 Grundlagen der Technischen Optik

2. Modulkürzel:	073100001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oster	า
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Erich Steinbeißer Christof Pruß Alexander Bielke	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	HM 1 - HM 3, Experimentalphysik	
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Studierenden</li> <li>erkennen die Möglichkeiten und Grenzen der abbildenden Optik auf Basis des mathematischen Modells der Kollineation</li> <li>sind in der Lage, grundlegende optische Systeme zu klassifizieren und im Rahmen der Gaußschen Optik zu berechnen</li> <li>verstehen die Grundzüge der Herleitung der optischen Phänomene "Interferenz" und "Beugung" aus den Maxwell-Gleichungen</li> <li>können die Grenzen der optischen Auflösung definieren</li> <li>können grundlegende optische Systeme (wie z.B. Mikroskop, Messfernrohr und Interferometer) einsetzen und bewerten</li> </ul>	
<ul> <li>optische Grundgesetze der Reflexion, Refraktion un Dispersion,</li> <li>Kollineare (Gaußsche) Optik,</li> <li>optische Bauelemente und Instrumente,</li> <li>Wellenoptik: Grundlagen der Beugung und Auflösun</li> <li>Abbildungsfehler,</li> <li>Strahlung und Lichttechnik</li> <li>Lust auf Praktikum?</li> <li>Zur beispielhaften Anwendung und Vertiefung des Lehbieten wir fakultativ ein kleines Praktikum an. Bei Inter Herrn Steinbeißer wenden.</li> </ul>		k, nstrumente, r Beugung und Auflösung, und Vertiefung des Lehrstoffs	
14. Literatur:		Formelsammlung,	en der Vorlesung, Übungsblätter, en mit ausführlichen Lösungen,

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 200 von 269

	<ul> <li>Fleisch: A Student's Guide to Maxwell's Equation, 2011</li> <li>Fleisch: A Student's Guide to Waves, 2015</li> <li>Gross: Handbook of Optical Systems Vol. 1, Fundamentals of Technical Optics, 2005</li> <li>Haferkorn: Optik, Wiley, 2002</li> <li>Hecht: Optik, Oldenbourg, 2014</li> <li>Kühlke: Optik, Harri Deutsch, 2011</li> <li>Naumann, Schröder, Löffler-Mang: Handbuch Bauelemente der Optik, 2014</li> <li>Pedrotti: Optik für Ingenieure, Springer, 2007</li> <li>Schröder: Technische Optik, Vogel, 2007</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>140601 Vorlesung Grundlagen der Technischen Optik</li> <li>140602 Übung Grundlagen der Technischen Optik</li> <li>140603 Praktikum Grundlagen der Technischen Optik</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitszeit: 138h = 180
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>14061 Grundlagen der Technischen Optik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Powerpoint-Vorlesung mit zahlreichen Demonstrations-Versuchen, Übung: Notebook + Beamer, OH-Projektor, Tafel, kleine "Hands-on" Versuche gehen durch die Reihen
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 201 von 269

#### Modul: 29950 Optische Informationsverarbeitung

2. Modulkürzel:	073100003	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oste	n	
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Karsten Frenner		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:			
11. Empfohlene Voraussetzungen:  Die Studierenden - erkennen die physikalischen Grundlagen der Prop Beugung von Licht mittels (skalarer) Wellenoptik - verstehen die Herleitung der optischen Phänomer und "Beugung aus den Maxwell-Gleichungen - kennen die Grundlagen der Fourieroptischen Bes optischer Systeme sowie die mathematischen Grundlagen der Fouriertransforma wichtiger, sich daraus ergebender Resultate (z.B. Sampling Theor - verstehen kohärente und inkohärente Abbildunger moderne Beschreibung mittels der optischen Transferfunktion - kennen typische Aufbauten der optischen Informationsverarbeitung (insbesondere Filterung, Korrelation, Holografie) und sind in der La mathematisch zu beschreiben kennen die Grundlagen der Kohärenz - verstehen den Zusammenhang zwischen digitaler optischer Bildverarbeitung - kennen die grundsätzlich eingesetzten Bauelemer informationsverarbeitende optische Systeme.		optischen Phänomene "Interferenz Fourieroptischen Beschreibung der Fouriertransformation und (z.B. Sampling Theorem). ohärente Abbildungen und ihre funktion der optischen besondere fie) und sind in der Lage, diese . Kohärenz ing zwischen digitaler und analog-		
13. Inhalt:		Fourier-Theorie der optischen Abbildung Fouriertransformation Eigenschaften linearer physikalischer Systeme Grundlagen der Beugungstheorie Kohärenz Fouriertransformationseigenschaften einer Linse Frequenzanalyse optischer Systeme Holografie und Speckle Spektrumanalyse und optische Filterung		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 202 von 269

	Lichtquellen, Lichtmodulatoren, Detektoren, computergenerierte Hologramme, Optische Prozessoren/Computer, Optische Mustererkennung, Optische Korrelation  Digitale Bildverarbeitung  Grundbegriffe Bildverbesserung Bildrestauration, Bildsegmentierung, Bildanalyse Anwendungen
14. Literatur:	<ul> <li>- Manuskript der Vorlesung</li> <li>- Lauterborn: Kohärente Optik</li> <li>- Goodman: Introduction to Fourier Optics</li> <li>- Hecht: Optik</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>299501 Vorlesung Optische Informationsverarbeitung</li> <li>299502 Übung Optische Informationsverarbeitung</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	29951 Optische Informationsverarbeitung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 203 von 269

#### Modul: 33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

2. Modulkürzel:	073100002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Osten	
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Klaus Körner Erich Steinbeißer	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		<ul> <li>verstehen die Unterschiede zwischen wellenoptischer und geometrisch-optischer Beschreibung,</li> <li>sind in der Lage, die in Wellenfeldern enthaltene Information zu beschreiben,</li> <li>können Messungen kritisch mittels Fehleranalyse bewerten,</li> <li>kennen die Rolle und Wirkungsweise der wichtigsten Komponenten und sind in der Lage, optische Mess-Systeme aus einzelnen Komponenten zusammenzustellen und zu bewerten,</li> <li>sind in der Lage, Methoden zur Vermessung von optischen und technischen Oberflächen sowie deren Oberflächenveränderungen zielgerichtet einzusetzen.</li> </ul>	
13. Inhalt:		Grundlagen der geometrisch - optische Komponenten - optische Systeme Grundlagen der Wellenoptik: - Wellentypen - Interferenz und Kohärenz	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 204 von 269

	- Beugung und Auflösungsvermögen Holografie Speckle Klassifikation und Charakterisierung von Oberflächen Messfehler Grundprinzipien und Klassifikation optischer Messtechniken Messmethoden auf Basis der geometrischen Optik: - Strukturierte Beleuchtung - Moire - Messmikroskope und Messfernrohre Messmethoden auf Basis der Wellenoptik: - interferometrische Messtechniken - Interferenzmikroskopie - holografische Interferometrie - Speckle-Messtechniken - Laufzeittechniken
14. Literatur:	Manuskript der Vorlesung, Pedrotti, F., et al: Optik für Ingenieure. Springer Verlag, Berlin 2007, Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Verlag, München 2014, Malacara, D.: Optical shop testing 2007, Cathey, T.: Optical Information Processing and Holography 1974, Erf, R.: Speckle metrology 1978.
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>337101 Vorlesung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> <li>337102 Übung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33711 Optische Messtechnik und Messverfahren (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 205 von 269

#### 262 Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

14060 Grundlagen der Technischen Optik29950 Optische Informationsverarbeitung

32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 206 von 269

## Modul: 13540 Grundlagen der Mikrotechnik

2. Modulkürzel:	073400001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. André Zim	mermann
9. Dozenten:		André Zimmermann Eugen Ermantraut	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 1: Mikrotechnik/Mikrosystemtechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die wichtigsten Werkstoffeigenschaften sowie Grundlagen der Konstruktion und Fertigung von mikrotechnischen Bauteilen und Systemen. Die Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten der Konstruktion und Fertigung von mikrotechnischen Bauteilen und Systemen in der Produktentwicklung und Produktion zu erkennen und sich eigenständig in Lösungswege einzuarbeiten.	
13. Inhalt:		<ul> <li>CVD-Technik, Thermische (</li> <li>Lithographie und Maskenter</li> <li>Ätztechniken zur Strukturier IE, Plasmaätzen)</li> <li>Reinraumtechnik</li> </ul>	echnik iten dünner Schichten (PVD- und Oxidation) chnik rung (Nasschemisches Ätzen, RIE, Verbindungstechnik für Mikrosysteme

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 207 von 269

	<ul> <li>Mikrotechnische Bauteile aus Kunststoff (z.B. Mikrospritzguss)</li> <li>Mikrobearbeitung von Metallen (z.B. spanende Mikrobearbeitung)</li> <li>Messmethoden der Mikrotechnik</li> <li>Prozessketten der Mikrotechnik</li> </ul>	
14. Literatur:	Vorlesungsmanuskript und Literaturangaben darin	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>135401 Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> <li>135402 Freiwillige Übung zur Vorlesung Grundlagen der Mikrotechnik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	13541 Grundlagen der Mikrotechnik (PL), Schriftlich oder Mündlich 40 Min., Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Beamerpräsentation, Overhead-Projektor, Tafel, Demonstrationsobjekte	
20. Angeboten von:	Mikrosystemtechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 208 von 269

## Modul: 14060 Grundlagen der Technischen Optik

2. Modulkürzel:	073100001	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oster	า
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Erich Steinbeißer Christof Pruß Alexander Bielke	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 3: Optische Technologien / Optische Fertigungstechnologien&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraus	ssetzungen:	HM 1 - HM 3, Experimentalphysik	
12. Lernziele:		<ul> <li>Die Studierenden</li> <li>erkennen die Möglichkeiten und Grenzen der abbildenden Optik auf Basis des mathematischen Modells der Kollineation</li> <li>sind in der Lage, grundlegende optische Systeme zu klassifizieren und im Rahmen der Gaußschen Optik zu berechnen</li> <li>verstehen die Grundzüge der Herleitung der optischen Phänomene "Interferenz" und "Beugung" aus den Maxwell-Gleichungen</li> <li>können die Grenzen der optischen Auflösung definieren</li> <li>können grundlegende optische Systeme (wie z.B. Mikroskop, Messfernrohr und Interferometer) einsetzen und bewerten</li> </ul>	
<ul> <li>optische Grundgesetze der Reflexion, Refraktion un Dispersion,</li> <li>Kollineare (Gaußsche) Optik,</li> <li>optische Bauelemente und Instrumente,</li> <li>Wellenoptik: Grundlagen der Beugung und Auflösun</li> <li>Abbildungsfehler,</li> <li>Strahlung und Lichttechnik</li> <li>Lust auf Praktikum?</li> <li>Zur beispielhaften Anwendung und Vertiefung des Lehbieten wir fakultativ ein kleines Praktikum an. Bei Inter Herrn Steinbeißer wenden.</li> </ul>		k, nstrumente, r Beugung und Auflösung, und Vertiefung des Lehrstoffs	
14. Literatur:		Formelsammlung,	en der Vorlesung, Übungsblätter, en mit ausführlichen Lösungen,

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 209 von 269

	<ul> <li>Fleisch: A Student's Guide to Maxwell's Equation, 2011</li> <li>Fleisch: A Student's Guide to Waves, 2015</li> <li>Gross: Handbook of Optical Systems Vol. 1, Fundamentals of Technical Optics, 2005</li> <li>Haferkorn: Optik, Wiley, 2002</li> <li>Hecht: Optik, Oldenbourg, 2014</li> <li>Kühlke: Optik, Harri Deutsch, 2011</li> <li>Naumann, Schröder, Löffler-Mang: Handbuch Bauelemente der Optik, 2014</li> <li>Pedrotti: Optik für Ingenieure, Springer, 2007</li> <li>Schröder: Technische Optik, Vogel, 2007</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>140601 Vorlesung Grundlagen der Technischen Optik</li> <li>140602 Übung Grundlagen der Technischen Optik</li> <li>140603 Praktikum Grundlagen der Technischen Optik</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h + Nacharbeitszeit: 138h = 180	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	n und -name:  14061 Grundlagen der Technischen Optik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1  bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Powerpoint-Vorlesung mit zahlreichen Demonstrations-Versuchen, Übung: Notebook + Beamer, OH-Projektor, Tafel, kleine "Hands-on" Versuche gehen durch die Reihen	
20. Angeboten von:	Technische Optik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 210 von 269

#### Modul: 29950 Optische Informationsverarbeitung

2. Modulkürzel:	073100003	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oste	n
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Karsten Frenner	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
11. Empfohlene Voraussetzungen: 12. Lernziele:		Die Studierenden - erkennen die physikalischen Grundlagen der Propagation und Beugung von Licht mittels (skalarer) Wellenoptik - verstehen die Herleitung der optischen Phänomene "Interferenz und "Beugung aus den Maxwell-Gleichungen - kennen die Grundlagen der Fourieroptischen Beschreibung optischer Systeme sowie die mathematischen Grundlagen der Fouriertransformation und wichtiger, sich daraus ergebender Resultate (z.B. Sampling Theorem) verstehen kohärente und inkohärente Abbildungen und ihre moderne Beschreibung mittels der optischen Transferfunktion - kennen typische Aufbauten der optischen Informationsverarbeitung (insbesondere Filterung, Korrelation, Holografie) und sind in der Lage, diese mathematisch zu beschreiben kennen die Grundlagen der Kohärenz - verstehen den Zusammenhang zwischen digitaler und analog- optischer Bildverarbeitung - kennen die grundsätzlich eingesetzten Bauelemente für informationsverarbeitende optische Systeme.	
13. Inhalt:		Fourier-Theorie der optischen Abbildung Fouriertransformation Eigenschaften linearer physikalischer Systeme Grundlagen der Beugungstheorie Kohärenz Fouriertransformationseigenschaften einer Linse Frequenzanalyse optischer Systeme Holografie und Speckle Spektrumanalyse und optische Filterung	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 211 von 269

	Lichtquellen, Lichtmodulatoren, Detektoren, computergenerierte Hologramme, Optische Prozessoren/Computer, Optische Mustererkennung, Optische Korrelation  Digitale Bildverarbeitung  Grundbegriffe  Bildverbesserung  Bildrestauration, Bildsegmentierung, Bildanalyse  Anwendungen
14. Literatur:	<ul> <li>- Manuskript der Vorlesung</li> <li>- Lauterborn: Kohärente Optik</li> <li>- Goodman: Introduction to Fourier Optics</li> <li>- Hecht: Optik</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul><li>299501 Vorlesung Optische Informationsverarbeitung</li><li>299502 Übung Optische Informationsverarbeitung</li></ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	29951 Optische Informationsverarbeitung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 212 von 269

## Modul: 32250 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme

2. Modulkürzel:	052110003	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Joachim Bu	ırghartz
9. Dozenten:		Joachim Burghartz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Mikrosystemtechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Gruppe 4: Spezifische Anwendungen&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Elektronikfertigung&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	V/Ü Grundlagen der Mikroelekt	tronikfertigung (Empfehlung)
12. Lernziele:		Vermittlung weiterführender Ke Technologien und Techniken ir	
13. Inhalt:		Die Vorlesung bietet eine fundierte und praxisbezogene Einführung in die Herstellung von Mikrochips und die besonderen Aspekte beim Test mikroelektronischer Schaltungen sowie dem Verpacken der Chips in IC-Gehäuse.  Grundlagen der Mikroelektronik Lithografieverfahren Wafer-Prozesse CMOS-Gesamtprozesse Packaging und Test Qualität und Zuverlässigkeit	
14. Literatur:		2002	·

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 213 von 269

	<ul> <li>- L.E. Glasser and D.W. Dobberpuhl: The Design and Aanalysis of VLSI Circuits, Addison Wesley.</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>322501 Vorlesung und Übung Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (Blockveranstaltung)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32251 Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 oder bei geringer Anzahl Studierender: mündlich, 40 min.
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	PowerPoint
20. Angeboten von:	Mikroelektronik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 214 von 269

# Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		<ul> <li>-technologie (Werkstoffe, Verf- Magnetisierung). Die Studiere Antriebe (rotatorische und line berechnen, gestalten und ausl können elektrodynamische An</li> </ul>	ntriebe (rotatorische und lineare ereinfacht berechnen, gestalten en kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerp	(Werkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 215 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 216 von 269

### Modul: 33710 Optische Messtechnik und Messverfahren

2. Modulkürzel:	073100002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Osten	
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Klaus Körner Erich Steinbeißer	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes:  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semes:  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 2. Semes:  → Kernfächer mit 6 LP> T Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semes:  → Gruppe 3: Optische Tech Fertigungstechnologien M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semes:  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semes:  → Kern-/Ergänzungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotech Optik, PO 961-2011, 1. Semes:	mit 6 LP> Technische Optik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter echnische Optik> nnik, Gerätetechnik und Technische ter nologien / Optische -> Vertiefungsmodule nnik, Gerätetechnik und Technische ter mit 6 LP> Elektronikfertigung> nnik, Gerätetechnik und Technische
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		<ul> <li>beschreiben,</li> <li>können Messungen kritisch r</li> <li>kennen die Rolle und Wirkun Komponenten und sind in de einzelnen Komponenten zus</li> <li>sind in der Lage, Methoden z optischen und technischen C Oberflächenveränderungen z</li> </ul>	nreibung, enfeldern enthaltene Information zu mittels Fehleranalyse bewerten, egsweise der wichtigsten er Lage, optische Mess-Systeme aus ammenzustellen und zu bewerten, eur Vermessung von Oberflächen sowie deren zielgerichtet einzusetzen.
13. Inhalt:		Grundlagen der geometrisch - optische Komponenten - optische Systeme Grundlagen der Wellenoptik: - Wellentypen - Interferenz und Kohärenz	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 217 von 269

	- Beugung und Auflösungsvermögen Holografie Speckle Klassifikation und Charakterisierung von Oberflächen Messfehler Grundprinzipien und Klassifikation optischer Messtechniken Messmethoden auf Basis der geometrischen Optik: - Strukturierte Beleuchtung - Moire - Messmikroskope und Messfernrohre Messmethoden auf Basis der Wellenoptik: - interferometrische Messtechniken - Interferenzmikroskopie - holografische Interferometrie - Speckle-Messtechniken - Laufzeittechniken
14. Literatur:	Manuskript der Vorlesung, Pedrotti, F., et al: Optik für Ingenieure. Springer Verlag, Berlin 2007, Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Verlag, München 2014, Malacara, D.: Optical shop testing 2007, Cathey, T.: Optical Information Processing and Holography 1974, Erf, R.: Speckle metrology 1978.
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>337101 Vorlesung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> <li>337102 Übung Optische Messtechnik und Messverfahren</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33711 Optische Messtechnik und Messverfahren (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 bei einer geringen Anzahl an Prüfungsanmeldungen findet die Prüfung mündlich (40 min.) statt
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 218 von 269

### 263 Ergänzungsfächer mit 3 LP

Zugeordnete Module: 29970 Optik dünner und nanostrukturierter Schichten

29980 Einführung in das Optik-Design

31870 Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung

32760 Diodenlaser

33400 Optische Phänomene in Natur und Alltag

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 219 von 269

### Modul: 29970 Optik dünner und nanostrukturierter Schichten

2. Modulkürzel:	073100004	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	DrIng. Karsten Frenner	
9. Dozenten:		Karsten Frenner	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		Die Studierenden - verstehen die Grundlagen de - beherrschen das Rechnen ir - können das Verhalten von p Bauteilen und Messverfahren - beschreiben die Grundlagen mit Nanostrukturen - können Simulationsprogram wellenoptischen Wechselwirkung nutzen	n Jones-/Müller-Formalismus olarisationsoptischen erklären der Wechselwirkung von Licht
13. Inhalt:		<ul> <li>Polarisation des Lichtes</li> <li>Interferenz und Kohärenz</li> <li>Licht an Grenzflächen</li> <li>Wellenoptik am Computer</li> <li>Dünne Schichten - Herstellu</li> <li>Ellipsometrie dünner Schichte</li> <li>Strukturierte Schichten - Her</li> <li>Mikroskopie und Ellipsometr</li> <li>Kristalloptik und elektrooptis</li> </ul>	ten stellung und Anwendung ie strukturierter Schichten
14. Literatur:		Manuskript der Vorlesung, Übungsblätter, Hecht: Optik, 3.Aufl., 2014, Goldstein: Polarized light, 3.Aufl., 2011.	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		• 299701 Vorlesung Optik dür	nner und nanostrukturierter Schichten
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:		29971 Optik dünner und nan Mündlich, 20 Min., Ge	ostrukturierter Schichten (BSL), ewichtung: 1
18. Grundlage für:			
19. Medienform:			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 220 von 269

### Modul: 29980 Einführung in das Optik-Design

2. Modulkürzel: 073100007	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 3 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS: 2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlicher:	UnivProf. Dr. Alois Herkomm	ner
9. Dozenten:	Christoph Menke Alois Herkommer	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:	empfohlen: Grundlagen der T	echnischen Optik
12. Lernziele:	Die Studierenden - kennen die physikalischen Grundlagen der optischen Abbildung und sind mit den Konventionen und Bezeichnungen der geometrischen Optik vertraut - können die Bildgüte von optischen Systemen bewerten - kennen die Entstehung und die Auswirkung einzelner Abbildungsfehler - können geeignete Korrektionsmittel zu den einzelnen Abbildungsfehler benennen und anwenden - sind in der Lage mit Hilfe des Optik-Design Programms ZEMAX (auf bereitgestellten Rechnern) einfache Optiksysteme zu optimieren	
13. Inhalt:	<ul> <li>- Grundlagen der geometrischen Optik</li> <li>- Geometrische und chromatische Aberrationen (Entstehung, Systematik, Auswirkung, Gegenmaßnahmen)</li> <li>- Bewertung der Abbildungsgüte optischer Systeme</li> <li>- Verschiedene Typen optischer Systeme (Fotoobjektive, Teleskope, Okulare, Mikroskope, Spiegelsysteme, Zoomsysteme)</li> <li>- Systementwicklung (Ansatzfindung, Optimierung, Tolerierung, Konstruktion)</li> </ul>	
14. Literatur:	<ul> <li>Manuskript der Vorlesung</li> <li>Gross: Handbook of optical s</li> <li>Kingslake: Lens Design Fund</li> <li>Smith: Modern Optical Engir</li> <li>Fischer/Tadic-Galeb: Optical</li> <li>Shannon: The Art and Scien</li> </ul>	damentals neering I System Design
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	299801 Vorlesung Einführur	og in das Ontik Dosign

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 221 von 269

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	29981 Einführung in das Optik-Design (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 abhängig von der Zahl der Prüfungsanmeldungen findet eine ca. 20-minütige mündliche Prüfung oder eine 60-minütige schriftliche Prüfung statt	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Powerpoint-Vortrag für Studenten bereitgestellte Notebooks mit Zemax-Optik-Design Programm	
20. Angeboten von:	Optik-Design und Simulation	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 222 von 269

### Modul: 31870 Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung

2. Modulkürzel: 073100008	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte: 3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS: 2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlicher:	DrIng. Tobias Haist		
9. Dozenten:	Tobias Haist		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Ergänzungsfächer mit 3  Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester	
11. Empfohlene Voraussetzungen:	Keine		
12. Lernziele:	Die Studierenden sollen		
	<ul> <li>Parameter zur Beurteilung und Beleuchtungsoptiken ke</li> <li>gezielt Teilkomponenten auf</li> <li>Grundlagen der linearen und</li> <li>Standardverfahren der optis</li> </ul>	der optischen Abbildung kennen und Beschreibung von Abbildungs- ennen, fgabengerecht auswählen können, d nichtlinearen Filterung verstehen,	
13. Inhalt:	Tiefenschärfe, Beugung Sensoren, Kamerainterfaces Lineare Systemtheorie, Four Rangordnungsfilter, morpho Punktoperationen Typische Bibliotheken Derfassungsgeometrien, Sepezifikation von Abbildungs MTF, OTF Abbildungsqualität/Bildfehle Komponenten / Katalogarbe	<ul> <li>Sensoren, Kamerainterfaces, Beurteilungsparamter, Rauschen</li> <li>Lineare Systemtheorie, Fourier, Lineare Filter, Rangordnungsfilter, morphologische Filter (Grundprinzip), Punktoperationen</li> <li>Typische Bibliotheken</li> <li>2D Erfassungsgeometrien, 3D Messprinzipien</li> <li>Spezifikation von Abbildungs- und Beleuchtungsoptiken</li> <li>MTF, OTF</li> <li>Abbildungsqualität/Bildfehler</li> <li>Komponenten / Katalogarbeit</li> <li>Grundlagen Photometrie/Radiometrie und Beleuchtungsquellen</li> <li>Beleuchtungsgeometrien</li> <li>Farbe, BRDF</li> <li>3D Bildverarbeitung</li> </ul>	
14. Literatur:	Hornberg: Handbook of Machi	Hornberg: Handbook of Machine Vision Fiete: Modeling the imaging chain of digital camera	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>318701 Vorlesung Bildverarb Anwendung</li> </ul>	peitungssysteme in der industriellen	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 223 von 269

	Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	31871 Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Powerpoint, Laptops
20. Angeboten von:	Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 224 von 269

### Modul: 32760 Diodenlaser

2. Modulkürzel:	073000008	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Thomas Graf	
9. Dozenten:		Uwe Brauch	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Laser in der Materialbearbeitung&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	keine	
12. Lernziele:		Die Grundlagen und Funktionsprinzipien von Diodenlasern kennen und verstehen.	
13. Inhalt:		Aufbau und Eigenschaften der Bauformen (Kanten- und Vertik	, pn-Übergang, Materialaspekte), verschiedenen Laserdioden-
14. Literatur:		Skript und Folien der Vorlesung	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	327601 Vorlesung Diodenlaser	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden	
17. Prüfungsnummer/r	und -name:	32761 Diodenlaser (BSL), Mü	ndlich, 20 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :			
19. Medienform:			
20. Angeboten von:		Strahlwerkzeuge	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 225 von 269

### Modul: 33400 Optische Phänomene in Natur und Alltag

2. Modulkürzel:	073100005	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	DrIng. Tobias Haist	
9. Dozenten:		Tobias Haist	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		Die Studierenden	
		<ul> <li>verstehen die optischen Grundgesetze</li> <li>erlangen einen Einblick in die Problematik der Frage "Was ist Licht und lernen übliche Lichtmodelle und die Beschreibung von "Licht kennen</li> <li>können die klassischen, mit unbewaffnetem Auge erfassbaren optischen Phänomene erkennen und erklären</li> <li>verstehen die Grundzüge des menschlichen Sehvorgangs</li> <li>kennen die Möglichkeiten der Lichtentstehung</li> <li>erkennen die Bedeutung des Lichts im Rahmen des physikalischen Weltbilds</li> </ul>	
13. Inhalt:		<ul> <li>Wechselwirkungsmodelle von Licht mit Materie (insbesondere: Streuung, Brechung, Absorption, Reflexion, Beugung)</li> <li>Physiologie (Mensch und Tier) des Sehsystems</li> <li>Optische Täuschungen</li> <li>Atmosphärische Optik (Regenbogen, Halos, Luftspiegelungen, Himmelsfärbungen, Glorien, Korona, Irisierung)</li> <li>Schattenphänomene</li> <li>Farbe (u.a. Farbmischung, Farbentstehung, Physiologie)</li> <li>Optische Phänomene an Alltagsgegenständen (viele verschiedene)</li> <li>Polarisation</li> <li>Kurzüberblick: Photonen (Quanteneffekte, Quantenkryptographie, Quantencomputer)</li> <li>Kurzüberblick: Licht in der Relativitätstheorie (u.a. Lichtuhr, Dopplereffekt, Gravitationslinsen, schwarze Löcher)</li> </ul>	
14. Literatur:		www.optipina.de dort ausführliches eBook mit vielen weiteren Literaturhinweisen D. K. Lynch,W. Livingston, Color and Light in Nature, Cambridge University Press 2001	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 334001 Vorlesung Optische	Phänomene in Natur und Alltag
16. Abschätzung Arbei	tsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 226 von 269

Summe: 90 Stunden
33401 Optische Phänomene in Natur und Alltag (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1
Powerpoint-Vorlesung mit zahlreichen Demonstrations- Versuchen
Technische Optik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 227 von 269

### Modul: 33460 Praktikum Technische Optik

2. Modulkürzel:	073100009	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. Wolfgang Oste	n
9. Dozenten:		Wolfgang Osten Erich Steinbeißer	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische</li> <li>Optik, PO 961-2011, 3. Semester</li> <li>→ Technische Optik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:		
12. Lernziele:		Die Studierenden	
		<ul> <li>sind in der Lage Kenntnisse Spezialisierungsfachs vielfä Versuchsaufbauten umzuse</li> <li>besprechen die Versuchser Praktikumsausarbeitung na</li> </ul>	ultig anzuwenden sowie in etzen. gebnisse und stellen diese in einer
13. Inhalt:		Spezialisierungsfach-Prakti  1) Flächenhafte Interferome In diesem Praktikumsversuch Interferometer als Messmittel Formprüfung kennen. Durch p Interferometern werden die G sowie Anwendungsaspekte di die Kohärenzlängenbestimmun Krümmungsradienbestimmun Formprüfung von optischen K  2) Rechnerunterstütztes Dei In diesem Spezialisierungsfact Einführungsteil zunächst die G Design Programms ZEMAX e Eingabe von primären Linsen und Brechzahlen sowie den S jeweils erzielte Abbildungsqua	abau/msc/msc_mach/  J. 10 verschiedenen, angebotenen ka:  trie und Messtechnik  lernen die Studierenden das für die nanometergenaue oraktische Experimente an rundlagen der Interferometrie vertieft skutiert. Die Experimente umfassen ing von Lichtquellen, die hochpräzise g von Kugelspiegeln sowie die omponenten.  Sign optischer Systeme:  Ehversuch wird in einem Grundfunktionalität des Optikriäutert. Aufbauend auf der daten wie Radien, Abständen itrahlbegrenzungen wird die alität aufgezeigt und diskutiert. en erarbeitet. Als Abschluss des rete Auslegung eines Handy-
14. Literatur:		Praktikumsunterlagen werden Praktikumsterminen als pdf-D	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>334604 Spezialisierungsfach</li> <li>334608 Praktische Übunger (APMB) 4</li> </ul>	nversuch 4 n: Allgemeines Praktikum Maschinenb

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 228 von 269

20. Angeboten von:	Technische Optik
19. Medienform:	
18. Grundlage für :	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33461 Praktikum Technische Optik (USL), Sonstige, Gewichtung: 1 USL. Art und Umfang der USL werden jeweils zu Beginn des Praktikums bekannt gegeben.
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden
	<ul> <li>334607 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 3</li> <li>334605 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 1</li> <li>334603 Spezialisierungsfachversuch 3</li> <li>334602 Spezialisierungsfachversuch 2</li> <li>334601 Spezialisierungsfachversuch 1</li> <li>334606 Praktische Übungen: Allgemeines Praktikum Maschinenbau (APMB) 2</li> </ul>

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 229 von 269

### 270 Medizingerätekonstruktion

Zugeordnete Module: 271 Kernfächer mit 6 LP

272 Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP

273 Ergänzungsfächer mit 3 LP

47250 Praktische Übungen Medizingerätetechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 230 von 269

#### 271 Kernfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

14160 Methodische Produktentwicklung

14240 Technisches Design33090 Medizingerätetechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 231 von 269

### Modul: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Sch	inköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik>     Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Medizingerätekonstruktion>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 5. Semester  → Kernfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP>     Medizingerätekonstruktion> Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Feinwerktechnik>     Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester  → Kern-/Ergänzungsfächer mit 6 LP> Elektronikfertigung>     Spezialisierungsmodule	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausk	oildung in Konstruktionslehre
12. Lernziele:		Fähigkeiten zur Analyse und Löst feinwerktechnischen Aufgabenste Berücksichtigung des Gesamtsys Berücksichtigung von Präzision, z Umgebungs- und Toleranzeinflüs und Systemen	ellungen im Gerätebau unter tems, insbesondere unter Zuverlässigkeit, Sicherheit,
13. Inhalt:		Entwicklung und Konstruktion feir Systeme mit Betonung des enger konstruktiver Gestaltung und zuge Methodik der Geräteentwicklung, Lösungsfindung, Genauigkeit und Geräten, Präzisionsgerätetechnik Aufbau genauer Geräte und Masc Toleranzanalyse, Zuverlässigkeit (zuverlässigkeits- und sicherheits Beziehungen zwischen Gerät und in der Gerätetechnik. Beispielhaft	n Zusammenhangs zwischen ehöriger Fertigungstechnologie. Ansätze zur kreativen I Fehlerverhalten in (Anforderungen und chinen), Toleranzrechnung, und Sicherheit von Geräten gerechte Konstruktion), I Umwelt, Lärmminderung

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 232 von 269

	Übungen und in den Praktika "Einführung in die 3D-Messtechnik", "Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests"	
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Grundlagen der Feinwerktechnik - Konstruktion und Fertigung. Skript zur Vorlesung</li> <li>Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. München Wien: Carl Hanser 2000</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>139701 Vorlesung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik, 3 SWS</li> <li>139702 Übung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (inklusive Praktikum, Einführung in die 3D-Meßtechnik, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests), 1,0 SWS (2x1,5 h)</li> </ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13971 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (PL) Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	<ul><li>Tafel</li><li>OHP</li><li>Beamer</li></ul>	
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 233 von 269

# Modul: 14160 Methodische Produktentwicklung

2. Modulkürzel:	072710010	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	r:	UnivProf. DrIng. Hansgeorg Bir	nz
9. Dozenten:		Hansgeorg Binz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt;</li></ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		<ul> <li>Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module</li> <li>Konstruktionslehre I - IV oder</li> <li>Grundzüge der Maschinenkonstruktion + Grundlagen der Produktentwicklung bzw.</li> <li>Konstruktion in der Medizingerätetechnik I + II</li> </ul>	
12. Lernziele:		Im Modul Methodische Produkten	twicklung
		<ul> <li>haben die Studierenden die Phadie Vorgehensweisen innerhalb Produktentwicklungsprozesses</li> <li>können die Studierenden wichti Produktentwicklungsmethoden (Kleingruppenarbeit) anwenden Ergebnisse.</li> </ul>	eines methodischen kennen gelernt, ge in kooperativen Lernsituationen
		Erworbene <b>Kompetenzen</b> : Die S	studierenden
		<ul> <li>können die Stellung des Geschäftsbereichs "Entwicklung/ Konstruktion" im Unternehmen einordnen,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens, der technischen Systeme sowie des Elementmodells,</li> <li>können allgemein anwendbare Methoden zur Lösungssuche anwenden,</li> <li>verstehen einen Lösungsprozess als Informationsumsatz,</li> <li>kennen die Phasen eines methodischen Produktentwicklungsprozesses,</li> <li>sind mit den wichtigsten Methoden zur Produktplanung, zur Klärung der Aufgabenstellung, zum Konzipieren, Entwerfen und zum Ausarbeiten vertraut und können diese zielführend anwenden,</li> <li>beherrschen die Baureihenentwicklung nach unterschiedlichen Ähnlichkeitsgesetzen sowie die Grundlagen der Baukastensystematik.</li> </ul>	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 234 von 269

13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der methodischen Produktentwicklung. Im ersten Teil der Vorlesung werden zunächst die Einordnung des Konstruktionsbereichs im Unternehmen und die Notwendigkeit der methodischen Produktentwicklung sowie die Grundlagen technischer Systeme und des methodischen Vorgehens behandelt. Auf Basis eines allgemeinen Lösungsprozesses werden dann der Prozess des Planens und Konstruierens sowie der dafür notwendige Arbeitsfluss erörtert. Einen wesentlichen Schwerpunkt stellen anschließend die Methoden für die Konstruktionsphasen Produktplanung/Aufgabenklärung und Konzipieren dar. Hier werden beispielsweise allgemein einsetzbare Lösungs- und Beurteilungsmethoden vorgestellt und an Fallbeispielen geübt. Der zweite Teil beginnt mit Methoden für die Konstruktionsphasen Entwerfen und Ausarbeiten. Es werden Grundregeln der Gestaltung, Gestaltungsprinzipien und Gestaltungsrichtlinien ebenso behandelt wie die Systematik von Fertigungsunterlagen. Den Abschluss bildet das Kapitel Variantenmanagement mit Themen wie dem Entwickeln von Baureihen und Baukästen sowie von Plattformen.  Der Vorlesungsstoff wird innerhalb eines eintägigen Workshops anhand eines realen Anwendungsbeispiel vertieft.
14. Literatur:	<ul> <li>Binz, H.: Methodische Produktentwicklung I + II. Skript zur Vorlesung</li> <li>Pahl G., Beitz W. u. a.: Konstruktionslehre, Methoden und Anwendung, 7. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007</li> <li>Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007</li> <li>Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung: Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, 4. Auflage, Carl Hanser Verlag München Wien, 2009</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>141601 Vorlesung und Übung Methodische Produktentwicklung I</li> <li>141602 Vorlesung und Übung Methodische Produktentwicklung II</li> <li>141603 Workshop Methodeneinsatz im Produktentwicklungsprozess</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit:50 h (4 SWS + Workshop) Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 130 h Gesamt: 180 h
17. Prüfungsnummer/n und -name:	14161 Methodische Produktentwicklung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Prüfung: i.d.R. schriftlich (gesamter Stoff von beiden Semestern), nach jedem Semester angeboten, Dauer 120 min, bei weniger als 10 Kandidaten: mündlich, Dauer 40 min
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Beamer-Präsentation, Tafel
20. Angeboten von:	Maschinenkonstruktionen und Getriebebau

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 235 von 269

# Modul: 14240 Technisches Design

2. Modulkürzel:	072710110	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Thomas N	Maier
9. Dozenten:		Thomas Maier Markus Schmid	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt;</li></ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagen-ausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module Konstruktionslehre I - IV oder Grundzüge der Maschinen-konstruktion I / II	
12. Lernziele:		das Wissen über die wesel orientierten Designs, als in Produktentwicklung,	nach dem Besuch des Moduls ntlichen Grundlagen des technisch tegraler Bestandteil der methodischen vichtige Gestaltungsmethoden
		<ul> <li>Erworbene Kompetenzen:</li> <li>Die Studierenden</li> <li>erwerben und besitzen fundierte Designkenntnisse für den Einsatz an der Schnittstelle zwischen Ingenieur und Designer,</li> <li>beherrschen alle relevanten Mensch-Produkt-Anforderungen, wie z.B. demografische/geografische und psychografische Merkmale, relevante Wahrnehmungsarten, typische Erkennungsinhalte sowie ergonomische Grundlagen,</li> <li>beherrschen die Vorgehensweise zur Gestaltung eines Produkts, Produktprogramms bzw. Produkt-systems vom Aufbau, über Form-, Farb- und Grafikgestaltung innerhalb der Phasen des Designprozesses,</li> <li>können mit Kreativmethoden arbeiten, erste Konzepte erstellen und daraus Designentwürfe ableiten,</li> <li>beherrschen die Funktions- und Tragwerkgestaltung sowie die wichtige Mensch-Maschine-Schnittstelle der Interfacegestaltung</li> <li>haben Kenntnis über die wesentlichen Parameter eines guten Corporate Designs.</li> </ul>	
13. Inhalt:		Darlegung des Designs als Teilnutzwert eines technischen Produkts und ausführliche Behandlung der wertrelevanten Parameter an aktuellen Anwendungs-beispielen. Behandlung des Designs als Bestandteil der Produktentwick-lung und Anwendung der Design-kriterien in der Gestaltkonzeption von Einzelprodukten mit Funktions-, Tragwerks- und Interfacegestaltung.	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 236 von 269

	Form- und Farbgebung mit Oberflächendesign und Grafik von Einzelprodukten. Interior-Design sowie das Design von Produkt-programmen und Produktsystemen mit Corporate-Design.	
14. Literatur:	<ul> <li>Maier, T., Schmid, M.: Online-Skript IDeEn<sup>Kompakt</sup> mit SelfStudy-Online-Übungen,</li> <li>Seeger, H.: Design technischer Produkte, Produktprogramme und -systeme, Springer-Verlag,</li> <li>Lange, W., Windel, A.: Kleine ergonomische Datensammlung, TÜV-Verlag</li> </ul>	
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul><li>142401 Vorlesung Technisches Design</li><li>142402 Übung und Praktikum Technisches Design</li></ul>	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	14241 Technisches Design (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung:	
18. Grundlage für :		
19. Medienform:	Vorlesungsskript, kombinierter Einsatz von Präsentationsfolien und Videos, mit Designmodellen und Produkten, Präsentation von Übungen mit Aufgabenstellung und Papiervorlagen	
20. Angeboten von:	Technisches Design	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 237 von 269

#### Modul: 33090 Medizingerätetechnik

2. Modulkürzel:	072511001	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. rer. nat. habil.	Peter Pott
9. Dozenten:		Hans-Otto Maier Klaus Frank	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagena Medizintechnik oder des Maso	ausbildung in einem Bachelor der chinenbaus
12. Lernziele:		Fähigkeiten zum Verständnis Anforderungen an Medizinger Konzeption entsprechender G	äte und daraus abgeleiteter
13. Inhalt:		<ul> <li>Medizingerätetechnik I: An Hand von Krankheitsbildern werden Bedeutung und Grenzen der Medizingerätetechnik aufgezeigt. Die Vorlesung folgt dazu dem Patienten von der Einlieferung bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus: <ul> <li>Ambulanz (Bildgebung, Wundversorgung, Atemunterstützung, Monitoring)</li> <li>Im OP (Patientenlagerung, Licht, Operationsbesteck, Sterilisierbarkeit, Mechanische Assistenzsysteme, Optische Bildgebung)</li> <li>In der Intensivstation, Im Patientenzimmer, Labormedizin</li> <li>Medizintechnik im Alltag (Geräte für die häusliche Anwendung, Prothesen, Telemedizin) Krankenhaustechnik (Kommunikation, Energie- und Medienversorgung, Entsorgung und Reinigung)</li> </ul> </li> </ul>	
		Medizingerätetechnik II:	

#### Medizingerätetechnik II:

Entwicklungsmethodik und Ablauf der Entwicklung von Medizingeräten unter der Reglementierung der Zulassung von Medizingerätetechniken in Europa und USA. Beispiele von Medizingeräteentwicklungen (z. B Infusionspumpe).

- Definition Medizinprodukte, rechtliche und normative Grundlagen
- Einteilung Medizinprodukte, Klassifizierung, Risikoklassen
- Gesetzliche Regelungen, Zulassungsgrundsätze, EU USA -Japan - China

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 238 von 269

	<ul> <li>Entwicklungsgrundlagen, Lasten-/Pflichtenheft, Konstruktion, Verifikation, Qualitätssicherung</li> <li>Serienproduktion, vom Prototyp zur Serie, Life Cycle Management, Qualitätssicherung</li> </ul>
14. Literatur:	Skripte als PDF der Vorlesungspräsentationen
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	330901 Medizingerätetechnik
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit 42 Std., Selbststudium 138 Std., Summe 180 Std.
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33091 Medizingerätetechnik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Medizingerätetechnik I und Medizingerätetechnik II als zwei getrennte Teilprüfungen
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overheadprojektor, Beamer, Präsentation
20. Angeboten von:	Medizingerätetechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 239 von 269

#### 272 Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP

Zugeordnete Module: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

14160 Methodische Produktentwicklung

14240 Technisches Design14310 Zuverlässigkeitstechnik32320 Interface-Design

32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung

mechatronischer Komponenten

33090 Medizingerätetechnik

33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette,

Simulation

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 240 von 269

### Modul: 13970 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang S	Schinköthe
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 2: Gerätekonstru Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> F Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> F Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 5. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> F Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kernfächer/Ergänzungsfa Medizingerätekonstruktic  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule	chnik, Gerätetechnik und Technische ster Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster Medizingerätekonstruktion> chnik, Gerätetechnik und Technische ster Elektronikfertigung> chnik, Gerätetechnik und Technische ster Elektronikfertigung> chnik, Gerätetechnik und Technische ster ächer mit 6 LP> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Elektronikfertigung>
11. Empfohlene Voraussetzungen:			usbildung in Konstruktionslehre
12. Lernziele:		Berücksichtigung des Gesamts Berücksichtigung von Präzisio	nstellungen im Gerätebau unter systems, insbesondere unter
13. Inhalt:		Systeme mit Betonung des en konstruktiver Gestaltung und z Methodik der Geräteentwicklur Lösungsfindung, Genauigkeit Geräten, Präzisionsgerätetech Aufbau genauer Geräte und M Toleranzanalyse, Zuverlässigk (zuverlässigkeits- und sicherhe Beziehungen zwischen Gerät	und Fehlerverhalten in nnik (Anforderungen und laschinen), Toleranzrechnung, ceit und Sicherheit von Geräten eitsgerechte Konstruktion),

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 241 von 269

	Übungen und in den Praktika "Einführung in die 3D-Messtechnik", "Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests"
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Grundlagen der Feinwerktechnik - Konstruktion und Fertigung. Skript zur Vorlesung</li> <li>Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. München Wien: Carl Hanser 2000</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>139701 Vorlesung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik, 3 SWS</li> <li>139702 Übung Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (inklusive Praktikum, Einführung in die 3D-Meßtechnik, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Lebensdauertests), 1,0 SWS (2x1,5 h)</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:138 h Gesamt: 180 h
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>13971 Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik (PL) Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	<ul><li>Tafel</li><li>OHP</li><li>Beamer</li></ul>
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 242 von 269

# Modul: 14160 Methodische Produktentwicklung

2. Modulkürzel:	072710010	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche	er:	UnivProf. DrIng. Hansgeorg	Binz
9. Dozenten:		Hansgeorg Binz	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		<ul> <li>Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module</li> <li>Konstruktionslehre I - IV oder</li> <li>Grundzüge der Maschinenkonstruktion + Grundlagen der Produktentwicklung bzw.</li> <li>Konstruktion in der Medizingerätetechnik I + II</li> </ul>	
12. Lernziele:		Im Modul Methodische Produktentwicklung	
		<ul> <li>haben die Studierenden die Phasen, Methoden und die Vorgehensweisen innerhalb eines methodischen Produktentwicklungsprozesses kennen gelernt,</li> <li>können die Studierenden wichtige Produktentwicklungsmethoden in kooperativen Lernsituationen (Kleingruppenarbeit) anwenden und präsentieren ihre Ergebnisse.</li> </ul>	
		Erworbene <b>Kompetenzen</b> : Die	e Studierenden
		<ul> <li>können die Stellung des Geschäftsbereichs "Entwicklung/ Konstruktion" im Unternehmen einordnen,</li> <li>beherrschen die wesentlichen Grundlagen des methodischen Vorgehens, der technischen Systeme sowie des Elementmodells,</li> <li>können allgemein anwendbare Methoden zur Lösungssuche anwenden,</li> <li>verstehen einen Lösungsprozess als Informationsumsatz,</li> <li>kennen die Phasen eines methodischen Produktentwicklungsprozesses,</li> <li>sind mit den wichtigsten Methoden zur Produktplanung, zur Klärung der Aufgabenstellung, zum Konzipieren, Entwerfen und zum Ausarbeiten vertraut und können diese zielführend anwenden,</li> <li>beherrschen die Baureihenentwicklung nach unterschiedlichen Ähnlichkeitsgesetzen sowie die Grundlagen der Baukastensystematik.</li> </ul>	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 243 von 269

13. Inhalt:	Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der methodischen Produktentwicklung. Im ersten Teil der Vorlesung werden zunächst die Einordnung des Konstruktionsbereichs im Unternehmen und die Notwendigkeit der methodischen Produktentwicklung sowie die Grundlagen technischer Systeme und des methodischen Vorgehens behandelt. Auf Basis eines allgemeinen Lösungsprozesses werden dann der Prozess des Planens und Konstruierens sowie der dafür notwendige Arbeitsfluss erörtert. Einen wesentlichen Schwerpunkt stellen anschließend die Methoden für die Konstruktionsphasen Produktplanung/Aufgabenklärung und Konzipieren dar. Hier werden beispielsweise allgemein einsetzbare Lösungs- und Beurteilungsmethoden vorgestellt und an Fallbeispielen geübt. Der zweite Teil beginnt mit Methoden für die Konstruktionsphasen Entwerfen und Ausarbeiten. Es werden Grundregeln der Gestaltung, Gestaltungsprinzipien und Gestaltungsrichtlinien ebenso behandelt wie die Systematik von Fertigungsunterlagen. Den Abschluss bildet das Kapitel Variantenmanagement mit Themen wie dem Entwickeln von Baureihen und Baukästen sowie von Plattformen.  Der Vorlesungsstoff wird innerhalb eines eintägigen Workshops anhand eines realen Anwendungsbeispiel vertieft.
14. Literatur:	<ul> <li>Binz, H.: Methodische Produktentwicklung I + II. Skript zur Vorlesung</li> <li>Pahl G., Beitz W. u. a.: Konstruktionslehre, Methoden und Anwendung, 7. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007</li> <li>Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007</li> <li>Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung: Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, 4. Auflage, Carl Hanser Verlag München Wien, 2009</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>141601 Vorlesung und Übung Methodische Produktentwicklung I</li> <li>141602 Vorlesung und Übung Methodische Produktentwicklung II</li> <li>141603 Workshop Methodeneinsatz im Produktentwicklungsprozess</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit:50 h (4 SWS + Workshop) Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 130 h Gesamt: 180 h
17. Prüfungsnummer/n und -name:	14161 Methodische Produktentwicklung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Prüfung: i.d.R. schriftlich (gesamter Stoff von beiden Semestern), nach jedem Semester angeboten, Dauer 120 min, bei weniger als 10 Kandidaten: mündlich, Dauer 40 min
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Beamer-Präsentation, Tafel
20. Angeboten von:	Maschinenkonstruktionen und Getriebebau

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 244 von 269

# Modul: 14240 Technisches Design

2. Modulkürzel:	072710110	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Thomas N	Maier	
9. Dozenten:		Thomas Maier Markus Schmid		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagen-ausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module Konstruktionslehre I - IV oder Grundzüge der Maschinen-konstruktion I / II		
12. Lernziele:		das Wissen über die weser orientierten Designs, als in Produktentwicklung,	nach dem Besuch des Moduls ntlichen Grundlagen des technisch tegraler Bestandteil der methodischen vichtige Gestaltungsmethoden	
		<ul> <li>Erworbene Kompetenzen:</li> <li>Die Studierenden</li> <li>erwerben und besitzen fundierte Designkenntnisse für den Einsatz an der Schnittstelle zwischen Ingenieur und Designer,</li> <li>beherrschen alle relevanten Mensch-Produkt-Anforderungen, wie z.B. demografische/geografische und psychografische Merkmale, relevante Wahrnehmungsarten, typische Erkennungsinhalte sowie ergonomische Grundlagen,</li> <li>beherrschen die Vorgehensweise zur Gestaltung eines Produkts, Produktprogramms bzw. Produkt-systems vom Aufbau, über Form-, Farb- und Grafikgestaltung innerhalb der Phasen des Designprozesses,</li> <li>können mit Kreativmethoden arbeiten, erste Konzepte erstellen und daraus Designentwürfe ableiten,</li> <li>beherrschen die Funktions- und Tragwerkgestaltung sowie die wichtige Mensch-Maschine-Schnittstelle der Interfacegestaltung,</li> <li>haben Kenntnis über die wesentlichen Parameter eines guten Corporate Designs.</li> </ul>		
13. Inhalt:		Produkts und ausführliche Be Parameter an aktuellen Anwe Designs als Bestandteil der F	eilnutzwert eines technischen ehandlung der wertrelevanten endungs-beispielen. Behandlung des Produktentwick-lung und Anwendung estaltkonzeption von Einzelprodukten nd Interfacegestaltung.	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 245 von 269

20. Angeboten von:	Technisches Design
19. Medienform:	Vorlesungsskript, kombinierter Einsatz von Präsentationsfolien und Videos, mit Designmodellen und Produkten, Präsentation von Übungen mit Aufgabenstellung und Papiervorlagen
18. Grundlage für :	
17. Prüfungsnummer/n und -name:	14241 Technisches Design (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung:
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 h Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 138 h Gesamt: 180 h
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul><li>142401 Vorlesung Technisches Design</li><li>142402 Übung und Praktikum Technisches Design</li></ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Maier, T., Schmid, M.: Online-Skript IDeEn<sup>Kompakt</sup> mit SelfStudy-Online-Übungen,</li> <li>Seeger, H.: Design technischer Produkte, Produktprogramme und -systeme, Springer-Verlag,</li> <li>Lange, W., Windel, A.: Kleine ergonomische Datensammlung, TÜV-Verlag</li> </ul>
	Form- und Farbgebung mit Oberflächendesign und Grafik von Einzelprodukten. Interior-Design sowie das Design von Produkt-programmen und Produktsystemen mit Corporate-Design.

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 246 von 269

### Modul: 14310 Zuverlässigkeitstechnik

2. Modulkürzel:	072600003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. DrIng. Bernd Be	UnivProf. DrIng. Bernd Bertsche	
9. Dozenten:		Bernd Bertsche		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Höhere Mathematik und abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre I-IV oder Grundzüge der Maschinenkonstruktion + Grundlagen der Produktentwicklung		
12. Lernziele:		Die Studierenden kennen die statistischen Grundlagen sowie die verschiedenen Methoden der Zuverlässigkeitstechnik. Sie beherrschen qualitative Methoden (FMEA, FTA, Design Review, ABC-Analyse) und quantitative Methoden (Boole, Markov, Monte Carlo u.a.) und können diese zur Ermittlung der Zuverlässigkeit technischer Systeme anwenden. Sie beherrschen die Testplanung, können Zuverlässigkeitsanalysen auswerten und Zuverlässigkeitsprogramme aufstellen.		
13. Inhalt:		<ul> <li>Bedeutung und Einordnung der Zuverlässigkeitstechnik</li> <li>Übersicht zu Methoden und Hilfsmittel</li> <li>Behandlung qualitativer Methoden zur systematischen Ermittlung von Fehlern bzw. Ausfällen und ihre Auswirkungen, z. B. FMEA (mit Übungen), Fehlerbaumanalyse FTA, Design Review (konstruktiv)</li> <li>Grundbegriffe der quantitativen Methoden zur Berechnung von Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitswerten, z. B. Boolsche Theorie (mit Übungen), Markov Theorie, Monte Carlo Simulation</li> <li>Auswertung von Lebensdauerversuchen (z. B. mit Weibullverteilung)</li> <li>Zuverlässigkeitsnachweisverfahren</li> <li>Zuverlässigkeitssicherungsprogramme</li> </ul>		
14. Literatur:		<ul> <li>Bertsche, Lechner: Zuverlä Maschinenbau, Springer 20</li> <li>VDA-Band 3.2: Zuverlässig Automobilherstellern und L</li> </ul>	004. gkeitssicherung bei	
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	<ul><li>143101 Vorlesung und Übu</li><li>143102 Praktikumsversuch</li></ul>		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit:42 h Vorlesung und 2 h Praktikum Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 136 h Gesamt: 180 h		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	14311 Zuverlässigkeitstechr Gewichtung: 1	nik (PL), Schriftlich, 120 Min.,	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Vorlesung: Laptop, Beamer, (	Overhead	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 247 von 269

20. Angeboten von:

Maschinenelemente

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 248 von 269

### Modul: 32320 Interface-Design

2. Modulkürzel:	072710150	5. Moduldauer:	Einsemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	ier:	UnivProf. DrIng. Thomas N	Maier
9. Dozenten:		Thomas Maier Markus Schmid	
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>	
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module Konstruktionslehre I - IV oder Grundzüge der Maschinenkonstruktion I / II, Grundzüge der Produktentwicklung I / II. und empfohlene Wahl des Ergänzungs- bzw. Vertiefungsbzw. Spezialisierungsmoduls Technisches Design	
12. Lernziele:		Das Modul vermittelt Grundla Interfacedesign. Studierende Moduls	agen und Vertiefungen zum besitzen nach dem Besuch des
		<ul> <li>das Wissen über die wesentlichen Grundlagen des Interfacedesigns als Bestandteil der methodischen Entwicklung und zur Vertiefung des Technischen Designs,</li> <li>die Kenntnis über wesentliche InteraktionsprinziModulhandbuch pien zur Wahrnehmung, Kognition und Betätigung und Benutzung,</li> <li>die Fähigkeit wichtige Methoden zur Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle anzuwenden, Lösungen zu realisieren und zu präsentieren,</li> <li>die Fertigkeiten zur Planung und Durchführung von Usability-Tests mit Probanden,</li> <li>grundlegende Kenntnisse zu Kriterien und Bewertung von Anzeigern und Stellteilen über die XKompatibilitäten,</li> <li>ein detailliertes Verständnis von Makro-, Mikround Informationsergonomie und deren Integration in die Planungs-, Konzept-, Entwurfs- und Ausarbeitungsphase,</li> <li>die Fähigkeit zur Durchführung und Auswertung einer Workflow-Analyse als Querschnittsfunktion,</li> <li>die Fähigkeit effiziente Bedienstrategien zu beurteilen,</li> <li>das Wissen über Auswirkungen und zukünftige Trends der Interfacegestaltung.</li> </ul>	
13. Inhalt:		relevanten Mensch-Maschine notwendigen Begriffe und Gr Ausführliche Vorstellung der Makro-, Mikro- und Informatio Entwicklungsprozess. Darauf wie Usabiltiy-Tests und Work	ären Interfacedesi,gn als Design mit Fokussierung auf alle e- Interaktionen. Beschreibung aller undlagen zur Interfacegestaltung. Methoden zur Integration der onsergonomie in den gegenwärtigen f aufbauend werden Werkzeuge, kflow-Analyse, intensiv beschrieben Ergebnisse diskutiert. Es werden

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 249 von 269

	zahlreiche realisierte Beispiele aus der Praxis als Fallbeispiele vorgestellt und behandelt.
14. Literatur:	<ul> <li>Maier, T., Schmid, M.: Online-Skript IDeEnKompakt mit SelfStudy-Online-Übungen, Zühlke, Detlef: Der intelligente Versager - Das Mensch-Technik-Dilemma. Darmstadt: Primus Verlag, 2005.</li> <li>Zühlke, Detlef: Useware-Engineering für technische Systeme. Berlin: Springer, 2004.</li> <li>Bullinger, Hans-Jörg: Ergonomie, Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner, 1994.</li> <li>Baumann, Konrad, Lanz, Herwig: Mensch- Maschine-Schnittstellen elektronischer Geräte. Berlin: Springer, 1998.</li> <li>Norman, Donald. A.: Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday things. New York: Basic Book, 2005.</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul><li>323201 Vorlesung Interface-Design</li><li>323202 Übung (inkl. Praktikum) Interface-Design</li></ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	32321 Interface-Design (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Vorlesungsskript, kombinierter Einsatz von Präsentationsfolien und Videos, mit Designmodellen und Produkten, Präsentation von Übungen mit Aufgabenstellung und Papiervorlagen
20. Angeboten von:	Technisches Design

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 250 von 269

# Modul: 32730 Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten

2. Modulkürzel:	072510003	5. Moduldauer:	Zweisemestrig
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe	
9. Dozenten:  10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Gruppe 2: Gerätekonstru Vertiefungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Zusatzmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 1. Semes  → Kern-/Ergänzungsfächer Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> I Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer mit 6 LP> I Spezialisierungsmodule  M.Sc. Maschinenbau Mikrotec Optik, PO 961-2011, 2. Semes  → Kernfächer/Ergänzungsf Medizingerätekonstruktion	chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Feinwerktechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Mikrosystemtechnik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Technische Optik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Technische Optik> chnik, Gerätetechnik und Technische ster mit 6 LP> Elektronikfertigung> chnik, Gerätetechnik und Technische ster Feinwerktechnik> Spezialisierungsmodule
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor
12. Lernziele:		<ul> <li>-technologie (Werkstoffe, Verf- Magnetisierung). Die Studiere Antriebe (rotatorische und line berechnen, gestalten und ausl können elektrodynamische An</li> </ul>	ntriebe (rotatorische und lineare ereinfacht berechnen, gestalten en kennen piezoelektrische,
13. Inhalt:		Wirkprinzipe mit den Schwerp	(Werkstoffe, Verfahren, konstruktive

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 251 von 269

	<ul> <li>Elektromagnetische Antriebe (rotatorische und lineare Schrittmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Elektrodynamische Antriebe (rotatorische und lineare Gleichstromkleinstmotoren, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Piezoelektrische, magnetostriktive und andere unkonventionelle Aktorik (neue Werkstoffe in mechatronischen Komponenten, Berechnung, Gestaltung, Anwendung)</li> <li>Beispiele zur Realisierung mechatronischer Lösungen in der Gerätetechnik. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen und Praktika (Spezialisierungsfachpraktika und APMB).</li> </ul>
14. Literatur:	<ul> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 1. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 2 Übung und Praktikumsversuch Piezosysteme/ Ultraschallantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Schinköthe, W.: Aktorik in der Gerätetechnik - Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten - Teil 3 Übung und Praktikumsversuch Lineare Antriebssysteme/ Lineardirektantriebe. Skript zu Übung und Praktikum</li> <li>Kallenbach, E., Stölting, HD.: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2011</li> </ul>
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>327301 Vorlesung + Übung Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul> <li>32731 Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1</li> <li>bei Wahl als Kern- oder Ergänzungsfach: mündliche Prüfung, 40 Minuten</li> <li>bei Wahl als Pflichtfach: schriftliche Prüfung, 120 Minuten</li> </ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 252 von 269

#### Modul: 33090 Medizingerätetechnik

2. Modulkürzel:	072511001	5. Moduldauer:	Zweisemestrig		
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester		
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. Dr. rer. nat. habil.	Peter Pott		
9. Dozenten:		Hans-Otto Maier Klaus Frank			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Gruppe 2: Gerätekonstruktion/Gerätetechnik&gt; Vertiefungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausbildung in einem Bachelor der Medizintechnik oder des Maschinenbaus			
12. Lernziele:		Fähigkeiten zum Verständnis und zur Analyse komplexer Anforderungen an Medizingeräte und daraus abgeleiteter Konzeption entsprechender Gerätesysteme			
13. Inhalt:		<ul> <li>Medizingerätetechnik I:         <ul> <li>An Hand von Krankheitsbildern werden Bedeutung und Grenzen der Medizingerätetechnik aufgezeigt. Die Vorlesung folgt dazu dem Patienten von der Einlieferung bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus:</li> <li>Ambulanz (Bildgebung, Wundversorgung, Atemunterstützung, Monitoring)</li> <li>Im OP (Patientenlagerung, Licht, Operationsbesteck, Sterilisierbarkeit, Mechanische Assistenzsysteme, Optische Bildgebung)</li> <li>In der Intensivstation, Im Patientenzimmer, Labormedizin</li> <li>Medizintechnik im Alltag (Geräte für die häusliche Anwendung, Prothesen, Telemedizin)</li> <li>Krankenhaustechnik (Kommunikation, Energie- und Medienversorgung, Entsorgung und Reinigung)</li> </ul> </li> </ul>			
		Medizingerätetechnik II:			

#### Medizingerätetechnik II:

Entwicklungsmethodik und Ablauf der Entwicklung von Medizingeräten unter der Reglementierung der Zulassung von Medizingerätetechniken in Europa und USA. Beispiele von Medizingeräteentwicklungen (z. B Infusionspumpe).

- Definition Medizinprodukte, rechtliche und normative Grundlagen
- Einteilung Medizinprodukte, Klassifizierung, Risikoklassen
- Gesetzliche Regelungen, Zulassungsgrundsätze, EU USA -Japan - China

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 253 von 269

	<ul> <li>Entwicklungsgrundlagen, Lasten-/Pflichtenheft, Konstruktion, Verifikation, Qualitätssicherung</li> <li>Serienproduktion, vom Prototyp zur Serie, Life Cycle Management, Qualitätssicherung</li> </ul>
14. Literatur:	Skripte als PDF der Vorlesungspräsentationen
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	330901 Medizingerätetechnik
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit 42 Std., Selbststudium 138 Std., Summe 180 Std.
17. Prüfungsnummer/n und -name:	33091 Medizingerätetechnik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1  Medizingerätetechnik I und Medizingerätetechnik II als zwei getrennte Teilprüfungen
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overheadprojektor, Beamer, Präsentation
20. Angeboten von:	Medizingerätetechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 254 von 269

# Modul: 33260 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation

2. Modulkürzel:	072510004	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe Eberhard Burkard		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP&gt;</li></ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	usbildung in einem Bachelor	
12. Lernziele:		Die Studierenden können Material und Fertigungsverfahren für Kunststoffteile in der Feinwerktechnik auswählen. Sie haben die Fähigkeit zum Entwurf von Spritzgussteilen und Spritzgießwerkzeugen für die Gerätetechnik. Die Studierenden beherrschen den Einsatz von Simulationsprogrammen für die Kunststoffspritzgusssimulation.		
13. Inhalt:		Einteilung der Polymerwerkstoffe, charakteristische Werkstoffeigenschaften, Verarbeitung der Polymerwerkstoffe, Kunststoffspritzguss, Aufbau einer Spritzgießmaschine, Spritzgießprozess, Sonderverfahren beim Kunststoffspritzguss, Gestaltung von Kunststoffspritzgussteilen, Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen, rheologische Auslegung von Teil und Werkzeug, Berechnung und Simulation des Spritzgießprozesses, Einsatz von Simulationsprogrammen. Beispielhafte Vertiefung in zugehörigen Übungen.		
14. Literatur:		<ul> <li>Burkard, E.: Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation. Skript zur Vorlesung</li> <li>Jaroschek, Ch.: Spritzgießen für Praktiker. München: Carl Hanser 2008</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	332601 Vorlesung + Übung Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik; Verfahren, Prozesskette, Simulation		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 42 Stunden Selbststudium: 138 Stunden Summe: 180 Stunden		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 255 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	33261 Praxis des Spritzgießens in der Gerätetechnik, Verfahren, Prozesskette, Simulation (PL), Mündlich, 40 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation,PC
20. Angeboten von:	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 256 von 269

## 273 Ergänzungsfächer mit 3 LP

Zugeordnete Module: 32340 Dynamiksimulation in der Produktentwicklung

32380 Value Management

33280 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL

33300 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik

33310 Elektronik für Feinwerktechniker

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 257 von 269

## Modul: 32340 Dynamiksimulation in der Produktentwicklung

2. Modulkürzel:	072710075	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	Heiko Alxneit		
9. Dozenten:		Heiko Alxneit		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module Konstruktionslehre I - IV oder Grundzüge der Maschinenkonstruktion I - II bzw. Konstruktion in der Medizingerätetechnik I + II Nachweis über 4-tägigen StutCAD-Kurs "ProE Wildfire Grundlagen" oder vergleichbares Praktikum oder Studienarbeit		
12. Lernziele:		Im Modul Dynamiksimulation in	n der Produktentwicklung	
		<ul> <li>haben die Studierenden die Vorgehensweisen bei der Si kennen gelernt,</li> <li>können die Studierenden wie anwenden und die Simulatio</li> </ul>	mulation dynamischer Systeme chtige Simulationstechniken	
		Erworbene Kompetenzen: Die	Studierenden	
		<ul> <li>können den Stellenwert der Simulationstechnik in der Produktentwicklung einordnen,</li> <li>kennen die wesentlichen Grundlagen der Simulationstechnik und der Modellbildung,</li> <li>sind mit den wichtigsten Methoden der Simulationstechnik, insbesondere der Modellbildung, vertraut und können diese zielführend anwenden,</li> <li>beherrschen die Modellierung von dynamischen Systemen unter Berücksichtigung der Bewegungsfreiheitsgrade,</li> <li>können Simulationen dynamischer Systeme mit Antrieben, Federn, Dämpfern vorbereiten und durchführen,</li> <li>können virtuelle Messungen durchführen sowie Spurkurven und Bewegungshüllen erzeugen,</li> <li>können Simulationsergebnisse interpretieren, auf ihre Aussagefähigkeit überprüfen und Optimierungen vornehmen,</li> <li>können Simulationsergebnisse bewerten und Grenzen der Simulationstechniken erkennen.</li> </ul>		
13. Inhalt:		Produkte von heute sollen in immer kürzerer Entwicklungszeit mehr Funktionen auf immer kleinerem Raum beinhalten. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden an die Produkte. Dazu muss die Produktivität gesteigert werden, während das unternehmerische Risiko reduziert werden soll. Dies wird erst mittels Einsatz moderner Simulationswerkzeuge ermöglicht. Komplexe Bewegungen mit den Gesetzen der Mechanik zu		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 258 von 269

beschreiben ist wenig anschaulich und erfordert ein großes Vorstellungsvermögen. Mittels Simulation von Bewegungen kann nicht nur die Kinematik veranschaulicht werden, es können auch dynamische Effekte und ihre Auswirkungen auf die Kinematik aufgezeigt werden. Die Dynamiksimulation liefert damit die Informationen, auf denen andere Simulationswerkzeuge aufbauen (z. B. Kräfte und Momente für FEM-Simulationen). Des Weiteren lassen sich mit wenig Aufwand Parameterstudien anstellen, um Kinematiken, deren Synthese nicht möglich ist, zu optimieren. Die Lehrveranstaltung Dynamiksimulation in der Produktentwicklung spricht obige Themen an und gibt einen Einblick in die Simulation von Bewegungen und deren Auswirkungen. Anhand von Fallbeispielen unter anderem auch aus aktuellen Forschungsarbeiten lernt der Studierende die Vorgehensweise bei der Simulation kennen und wendet sie an. Des Weiteren werden Grenzen der Simulation sowie Fragestellungen bei der Auswertung der Ergebnisse aufgezeigt. Insbesondere werden folgende Inhalte behandelt: Einführung in die Simulation und Modellbildung, Vorstellung von Werkzeugen, generelle Vorgehensweise. Übung: Vorbereiten von Bauteilen und Baugruppen, Definieren von Verbindungen, Antrieben, Federund Dämpferelementen, Definieren und Ausführen von Analysen, Erzeugen von Messgrößen, Spurkurven und Bewegungshüllen, Interpretieren der Ergebnisse.

14. Literatur:	Vorlesungsbegleitende Unterlagen, PTC Pro/Engineer Wildfire mit Modul Mechanism
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	<ul> <li>323401 Vorlesung (inkl. Übungen) Dynamiksimulation in der Produktentwicklung</li> </ul>
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:	<ul><li>32341 Dynamiksimulation in der Produktentwicklung (BSL),</li><li>Sonstige, 60 Min., Gewichtung: 1</li><li>15 Minuten mündlich,</li><li>45 Minuten Test am Computer</li></ul>
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Powerpoint-Präsentation mit Animationen, online Beamer- Vorführung, Tafelanschrieb
20. Angeboten von:	Maschinenkonstruktionen und Getriebebau

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 259 von 269

## Modul: 32380 Value Management

2. Modulkürzel:	072710170	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortliche	er:	DrIng. Dietmar Traub		
9. Dozenten:		Dietmar Traub		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraus	setzungen:	Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruktionslehre z. B. durch die Module Konstruktionslehre I - IV oder Grundzüge der Maschinenkonstruktion I / II		
12. Lernziele:		Im Modul Value Management		
		<ul> <li>besitzen die Studierenden nach dem Besuch des Moduls das Wissen über die wesentlichen Grundlagen der Methode Value Management,</li> <li>überblicken die Studierenden Grundlagen für Teamarbeit, Kreativität und Motivation,</li> <li>kennen den Wert- und Kostenbegriff,</li> <li>kennen den Funktionenbegriff</li> <li>kennen die Funktionenanalyse und systemtechnische Ansätze</li> <li>kennen die Kostenanalyse,</li> <li>kennen Grundschritte und Teilschritte des VMArbeitsplanes mit den VM-Modulen im Zusammenhang,</li> <li>überblicken Einsatz von Team- und Einzelarbeit,</li> <li>kennen Arbeitsmethoden für die Grundschritte,</li> <li>bearbeiten den gruppendynamischen Prozess,</li> <li>überblicken Aufgaben des VM-Teams und des VM-Koordinators in der Unternehmensorganisation.</li> </ul>		
13. Inhalt:		VM-Module nach EN 12973 Arbeitsplan Definition Wert Ganzheitlichkeit und Systemgrenzen Funktionales Denken Funktionenanalyse, -kostenanalyse Grundlagen Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung Kostenanalyse/Kostenstruktur Kreativitätsmethoden Teamarbeit und Gruppenarbeit Bewertungs- und Auswahlmethoden Projektorganisation, -management		
14. Literatur:		Seminarunterlage Value Management Modul 1		
15. Lehrveranstaltunger	n und -formen:	323801 Vorlesung (inkl. Übungen in Gruppen) Value Managemer		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 260 von 269

17. Prüfungsnummer/n und -name:	32381 Value Management (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1
18. Grundlage für :	
19. Medienform:	Vorlesungsskript, kombinierter Einsatz von Präsentationsfolien und Videos, mit Praxisbeispielen in realen Teilen und Berichten, Durchführung von Übungen mit Aufgabenstellung und Papiervorlagen.
20. Angeboten von:	Technisches Design

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 261 von 269

### Modul: 33280 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL

2. Modulkürzel:	072510005	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester		
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivProf. DrIng. Wolfgang	Schinköthe		
9. Dozenten:		Wolfgang Schinköthe			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Zusatzmodule</li> </ul>			
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagena	Abgeschlossene Grundlagenausbildung in einem Bachelor		
12. Lernziele:		Die Studierenden haben die Fähigkeit die FEM-Programme ANSYS und MAXWELL für Simulationsaufgaben verschiedenster Art einzusetzen.			
13. Inhalt:		Einführung in die praktische Nutzung der FEMProgramme ANSYS und MAXWELL zur Berechnung von Strukturmechanik-Aufgaben, thermischen Problemen, Magnetfeldern und Antrieben (Lineardirektantriebe und piezoelektrische Antriebe). Beispielhafte Vertiefung in einer zugehörigen Übung.			
14. Literatur:		<ul> <li>Schinköthe, W., Ulmer, M., Joerges, P., Zülch, M.: Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL. Skript zur Vorlesung</li> <li>Schätzing, W.: FEM für Praktiker - Band 4: Elektrotechnik. Renningen: expertVerlag 2009</li> </ul>			
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>332801 Vorlesung und Übung Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL</li> </ul>			
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33281 Praktische FEM-Simulation mit ANSYS und MAXWELL (BSL Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:		am PC, Beamer-Präsentation,			
20. Angeboten von:		Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik			

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 262 von 269

### Modul: 33300 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik

2. Modulkürzel:	072510008	5. Moduldau	er: Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	PD DrIng. Hubert Effe	enberger	
9. Dozenten:		Hubert Effenberger		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,</li> <li>→ Zusatzmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundlagenausbildung in einem Bachelor		
12. Lernziele:		Die Studierenden kennen diskrete und integrierte, analoge und digitale Bauelemente und haben die Fähigkeiten zur praktischen Anwendung in der Feinwerktechnik.		
13. Inhalt:		Halbleiterbauelemente (diskrete und integrierte, analoge und digitale Bauelemente, Sensoren, Wandler), Dioden, Transistoren, Thyristoren, Triac, Fotoelemente, Fotodioden, Lumineszenzdioden, Optokoppler, temperaturabhängige Bauelemente, Mikroprozessortechnik.		
14. Literatur:		<ul> <li>Effenberger, H.: Umdrucke zur Vorlesung</li> <li>Tietze, U, Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik. Berlin: Springer 2002</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 333001 Vorlesung El	ektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/n und -name:		33301 Elektrische Bauelemente in der Feinwerktechnik (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1		
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation		
20. Angeboten von:		Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik		
		-		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 263 von 269

### Modul: 33310 Elektronik für Feinwerktechniker

2. Modulkürzel:	072510007	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester	
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	er:	PD DrIng. Hubert Effen	perger	
9. Dozenten:		Hubert Effenberger		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Medizingerätekonstruktion&gt; Spezialisierungsmodule</li> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 1. Semester</li> <li>→ Ergänzungsfächer mit 3 LP&gt; Feinwerktechnik&gt; Spezialisierungsmodule</li> </ul>		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Abgeschlossene Grundla	genausbildung in einem Bachelor	
12. Lernziele:		Die Studierenden kennen die Grundschaltungen der Analog- und Digitaltechnik. Sie kennen integrierte Schaltkreise in Bipolar- und MOS-Technik und haben die Fähigkeiten zur praktischen Anwendung.		
13. Inhalt:		Grundschaltungen der Analog- und Digitaltechnik, Sensoren, Anwendungsbeispiele integrierter Schaltkreise (z. B. Operationsverstärker, A/DWandler, logische Schaltungen, Speicher) in Bipolar- und MOS-Technik, Einführung in die Microcomputertechnik.		
14. Literatur:		<ul> <li>Effenberger, H.: Umdrucke zur Vorlesung</li> <li>Tietze, U, Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik. Berlin: Springer 2002</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 333101 Vorlesung Elek	tronik für Feinwerktechniker	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 21 Stunden Selbststudium: 69 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	33311 Elektronik für Fei Gewichtung: 1	nwerktechniker (BSL), Mündlich, 20 Min.,	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		Tafel, Overhead-Projektor, Beamer-Präsentation		
20. Angeboten von:		Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 264 von 269

## Modul: 47250 Praktische Übungen Medizingerätetechnik

2. Modulkürzel:	072511005		5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP		6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS:	2		7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlich	ner:	UnivPro	of. DrIng. Wolfgang	Schinköthe	
9. Dozenten:		Wolfgan	g Schinköthe		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		Optik, Po	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 3. Semester  → Medizingerätekonstruktion> Spezialisierungsmodule		
11. Empfohlene Vorau	ssetzungen:	Medizing	gerätetechnik		
12. Lernziele:		Versuch	Die Studierenden können verschiedene Geräte, Software und Versuchsanlagen der Medizintechnik praktisch nutzen. Sie beherrschen das Umsetzen theoretischer Vorlesungsinhalte in der Praxis.		
13. Inhalt:		Nähere Informationen zu den Praktischen Übungen: APMB erhalten Sie zudem unter http://www.uni-stuttgart.de/mabau/msc/msc_mach/linksunddownloads.html Das Modul umfasst die Behandlung unterschiedlicher Beispiele aus dem Gebiet der Medizingerätetechnik hinsichtlich konstruktiver, funktionaler und anwendungsspezifischer Aspekte.			
14. Literatur:		<ul><li>Kramr Inform erweit</li><li>Winter Engine</li></ul>	<ul> <li>Praktikums-Unterlagen,</li> <li>Kramme, R.: Medizintechnik - Verfahren, Systeme, Informationsverarbeitung, 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2007</li> <li>Wintermantel, E. et al.: Medizintechnik - Life Science Engineering, 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008</li> </ul>		
15. Lehrveranstaltunge	en und -formen:	• 47250	I Praktische Übunge	n (Spezialisierungsfachversuch)	
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:		Präsenzzeit: 30 Stunden Selbststudium/Nacharbeit: 60 Stunden Summe: 90 Stunden			
17. Prüfungsnummer/n und -name:		47251 Praktische Übungen Medizingerätetechnik (USL), Schriftlich Gewichtung: 1			
18. Grundlage für :					
19. Medienform:					
20. Angeboten von:		Konstruk	Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 265 von 269

## 400 Schlüsselqualifikationen fachaffin

Zugeordnete Module: 33150 Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren II

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 266 von 269

## Modul: 33150 Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren II

2. Modulkürzel:	041500015	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester	
4. SWS:	3	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlicher:		UnivProf. Dr. Michael Resch		
9. Dozenten:		Colin Glass		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		<ul> <li>M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische</li> <li>Optik, PO 961-2011, 2. Semester</li> <li>→ Schlüsselqualifikationen fachaffin</li> </ul>		
11. Empfohlene Voraussetzungen:		Grundkenntnisse des Programmierens (z.B. Matlab) Modellierung, Simulation und Optimierungsverfahren I		
12. Lernziele:		<ul> <li>Optimierung.</li> <li>Ausgehend von gegebener den Prozess der Programn Formulierung von Problems</li> <li>Die Studenten sind in der L</li> </ul>	ie Grundkonzepte der Simulation und n Modellen verstehen die Studenten nierung und Simulation bis hin zur szenarien und deren Optimierung. Lage basierend auf dem erlernten eiten Simulationen durchzuführen und en.	
13. Inhalt:		<ul> <li>Grundlagen der Simulation (Anwendungsgebiete, Methoden, Algorithmen, Programmierung)</li> <li>Grundlagen der Optimierung (Konzepte, bekannte Verfahren, Entwurf)</li> </ul>		
14. Literatur:		Wird während der Vorlesung angegeben.		
15. Lehrveranstaltungen und -formen:		<ul> <li>331502 Übung Simulation und Modellierung II</li> <li>331501 Vorlesung Simulation und Modellierung II</li> </ul>		
16. Abschätzung Arbei	itsaufwand:	Präsenzzeit: 32 Stunden Selbststudium: 58 Stunden Summe: 90 Stunden		
17. Prüfungsnummer/r	n und -name:	33151 Modellierung, Simula Schriftlich, 90 Min., G	tion und Optimierungsverfahren II (BSL Gewichtung: 1	
18. Grundlage für :				
19. Medienform:		PPT-Präsentation, Tafelansc	PPT-Präsentation, Tafelanschrieb	
20. Angeboten von:		Höchstleistungsrechnen		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 267 von 269

### Modul: 80210 Masterarbeit Maschinenbau

2. Modulkürzel: 077271097	5. Moduldauer:	Einsemestrig		
3. Leistungspunkte: 30 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester		
4. SWS: 0	7. Sprache:	Deutsch		
8. Modulverantwortlicher:	UnivProf. DrIng. Hansgeorg	UnivProf. DrIng. Hansgeorg Binz		
9. Dozenten:				
10. Zuordnung zum Curriculum in dies Studiengang:	em M.Sc. Maschinenbau Mikrotecl Optik, PO 961-2011,	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011,		
11. Empfohlene Voraussetzungen:	Mindestens 72 erworbene Leis	Mindestens 72 erworbene Leistungspunkte		
12. Lernziele:	Ingenieur-Aufgabe unter Anwe Studium vermittelten Wissens zu lösen. Durch angeleitetes w die / der Studierende eine erwe Des Weiteren stärkt sie / er die den Theorie- und Methodensch auf komplexe Probleme anwer Lösung theoretischer, konstruk Aufgaben in einem Ingenieur-Faktueller Publikationen zum üb durchgeführt und kennt die inh Die / der Studierende  • kann eine wissenschaftliche bearbeiten.  • ist in der Lage, die Ergebniss Arbeit in einem Bericht zusal kurzen Vortrages zu präsent	kann eine wissenschaftliche Aufgabenstellung selbständig		
13. Inhalt:	abzugeben. Zusätzlich muss e	rm bei der bzw. dem / der Prüfer(in) in Exemplar in elektronischer Form il der Masterarbeit ist ein Vortrag		
14. Literatur:				
15. Lehrveranstaltungen und -formen:				
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	900 h			
17. Prüfungsnummer/n und -name:				
18. Grundlage für :				
19. Medienform:				
20. Angeboten von:	Maschinenkonstruktionen und	Getriebebau		

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 268 von 269

### Modul: 80480 Studienarbeit Maschinenbau

2. Modulkürzel: 077271095	5. Moduldauer:	Einsemestrig	
3. Leistungspunkte: 12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester	
4. SWS: 0	7. Sprache:	Deutsch	
8. Modulverantwortlicher:	UnivProf. DrIng. Hansgeorg Binz		
9. Dozenten:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M.Sc. Maschinenbau Mikrotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik, PO 961-2011, 3. Semester		
11. Empfohlene Voraussetzungen:			
12. Lernziele:	Die / der Studierende hat die Fähi Durchführung einer wissenschaftli Hierzu gehören: das Erkennen und Aufgabenstellung, die Erfassung of Forschung in einem begrenzten Bund Auswertung einer Literaturreceines Versuchsprogramms, die proversuchen oder die Anwendung e Auswertung und grafische Darstel und deren Beurteilung. Mit diesen Studierende im Fachgebiet entspromodellhafte Ansätze zur Probleml planen und auszuführen. Generell Studienarbeit das Rüstzeug zur se Arbeit erworben.	chen Arbeit erworben. d die klare Formulierung der des Standes der Technik oder ereich durch die Anfertigung cherche, die Erstellung aktische Durchführung von ines Simulationsprogramms, die lung von Versuchsergebnissen Fähigkeiten besitzt die / der echende experimentelle oder ösung, um diese selbständig zu hat die /der Studierende in der	
13. Inhalt:	Inhalt: Individuelle Absprache Innerhalb der Bearbeitungsfrist (6 Monate) ist die fertige Studienarbeit in schriftlicher Form bei der bzw. dem/der Prüfer(in) abzugeben. Zusätzlich muss ein Exemplar in elektronischer Form eingereicht werden. Bestandteil der Studienarbeit ist der Besuch von mindestens 9 Seminarvorträgen (Teilnahmebestätigung auf Formblatt des Instituts) und ein eigener Vortrag von 20-30 Minuten Dauer über deren Inhalt.		
14. Literatur:			
15. Lehrveranstaltungen und -formen:	804801 Studienarbeit, Seminar des Spezialisierungsfaches		
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:	360 Stunden		
17. Prüfungsnummer/n und -name:			
18. Grundlage für :			
19. Medienform:			
20. Angeboten von:	Maschinenkonstruktionen und Get	triebebau	

Stand: 19. Oktober 2017 Seite 269 von 269